

TIME AND TEMPERATURE DISPLAY

1. นายปริญญา เวียงแก้ว รหัสประจำตัว 38013328
2. นายรัชตภาคย์ ปัตตะวงค์ รหัสประจำตัว 38013332

11. ค.ค. 2541
วัน เดือน ปี.....
เลขทะเบียน..... 038916
เลขเรียกหนังสือ... T 40156 ป 458 ม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2540

หัวข้อปริญญานิพนธ์

ชุดแสดงผลอุณหภูมิและเวลา

TIME AND TEMPERATURE DISPLAY

จัดทำโดย

นายปริญญา เวียงแก้ว รหัสประจำตัว 38013328

นายรัชตภาคย์ ปัดตะวงส์ รหัสประจำตัว 38013332

สาขาวิชา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ประดิษฐ์ วัชรพิบูลย์

ปีการศึกษา

2540

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอนุมัติให้
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

ประธานกรรมการ

()

Signature กรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

กรรมการ

()

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญานิพนธ์

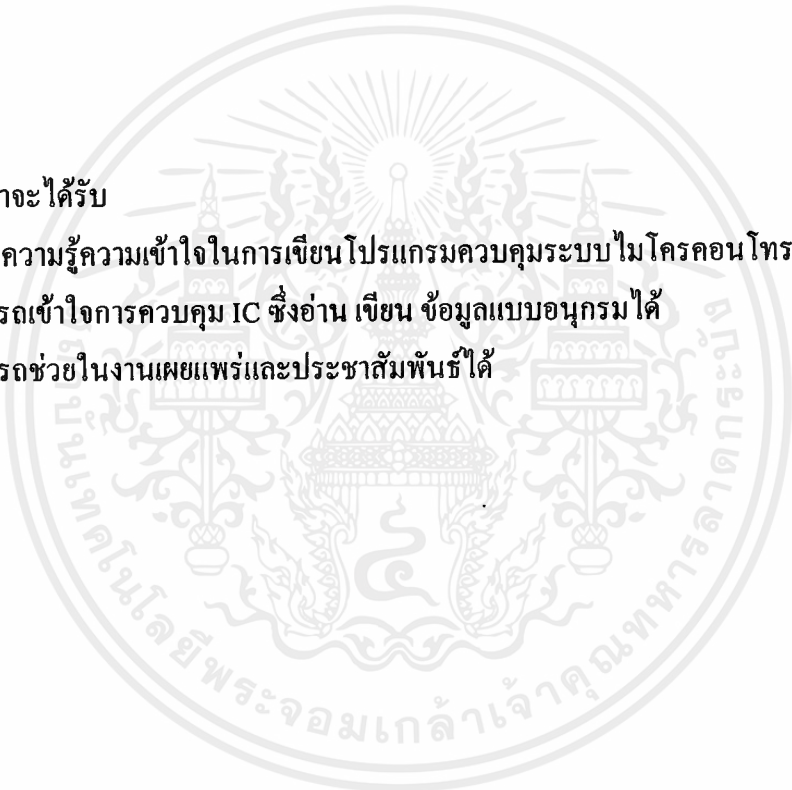
เรื่อง ชุดแสดงผลอุณหภูมิและเวลา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมในการควบคุมระบบ
2. เพื่อศึกษาการทำงานของ IC (Intergate circuit)
3. เพื่อศึกษาการออกแบบวงจรของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
2. สามารถเข้าใจการควบคุม IC ซึ่งอ่าน เขียน ข้อมูลแบบอนุกรมได้
3. สามารถช่วยในงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้



บทคัดย่อ

โครงการ ชุดแสดงผลอุณหภูมิและเวลา ซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมไอซี แบบอนุกรม เป็นการศึกษาไอซีต่างๆ ที่ใช้ประกอบในงานควบคุม โดยเน้นที่การลดขนาดวงจรแต่มีประสิทธิภาพของการทำงานสูงมากเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากปกติชุดแสดงอุณหภูมิและเวลาจำเป็นต้องใช้ระบบควบคุมที่ซับซ้อนมาก ทำให้วงจรมีขนาดใหญ่ เมื่อเรานำไอซีที่เป็นการควบคุมแบบอนุกรมมาใช้งาน ทำให้สามารถลดจำนวนของอุปกรณ์ลดลงได้มาก แม้ว่าส่วนของโปรแกรมจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่ก็เพื่อจะเป็นการพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมการใช้งานในระบบควบคุม ใ ค้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Abstract

This Temperature and Time Display Project using integrated circuit controlled by series programmed micro controller is to study the efficiencies of the integrated circuits used in control system. Traditionally the temperature and time display module requires large control system which effects to the size of the circuit itself. The series programmed micro-controller can decrease the size of the circuit and at the same time increase its' efficiency. This project enhances the programming skill for more complicated and efficient control system.



กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือในการทำโครงการ ทำให้โครงการนี้สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณท่านอาจารย์ ประดิษฐ์ วัชรพิบูลย์ เป็นอย่างสูง ในการให้คำปรึกษาชี้แนะ และติชมแก้ไข ซึ่งทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทนำ

ในการสร้างแผนแสดงเวลาและอุณหภูมิขึ้นมา เพื่อศึกษาการเขียน การพัฒนาโปรแกรม และการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมไอซีแบบอนุกรม โดยวงจรจะมีไอซีควบคุมระบบ ซึ่งมีขาในการทำงานเพียง 20 ขา และมีรอมในตัว สามารถโปรแกรมลงไปในตัวไอซีได้ 2 กิโลไบต์ มีอินพุทขาที่พุท 15 บิต สามารถโปรแกรมได้ 1,000 ครั้ง มีหน่วยความจำข้อมูลแรม 128 ไบต์ เป็นหัวใจหลักของระบบทั้งหมด และใช้ไอซี DS1620 ในการตรวจจับอุณหภูมิ สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -55 องศาเซลเซียส ถึง 125 องศาเซลเซียส รับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม 3 บิต และใช้ไอซี DS1202 เป็นฐานเวลา, วัน, เดือน, ปี โดยรับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม 3 บิต และมีวงจรแบคอัพ (Backup) ข้อมูล และวอชด็อก ใช้ไอซี MAX 691ACPE ในการควบคุมส่วนแสดงผลเป็นเซเวนเซ็กเมนต์ (SEVEN SEGMENT) และใช้ไอซี MAX 7219CNG ในการขับส่วนแสดงผลแบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex)

แผนแสดงเวลาและอุณหภูมินี้ จำเป็นต้องมีการติดต่อกับผู้ใช้ ประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชัน (Function) คือ

- ตั้งเวลา
- ตั้งวันที่ เดือน ปี
- กำหนดระยะเวลาการแสดงผล
- ปรับความสว่างของตั้งแสดงผล

(เนื่องจากแผนแสดงผลของเครื่องแสดงเวลาหรือนาฬิกานี้ มีขนาดใหญ่จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น การโชว์อุณหภูมิและเวลาตามแหล่งชุมชน ในห้องประชุม หรือในอาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 หลักการและการทำงานทั่วไป	1
- ภาคคอนโทรลบอร์ด	2
- ภาคแสดงผล	7
บทที่ 2 การพัฒนาการเขียนโปรแกรม	10
- โปรแกรมการใช้งาน	11
บทที่ 3 วิธีการใช้งาน	12
- การตั้งเวลา	48
- การตั้งวันที่	48
- การตั้งเวลาในการแสดงผล	48
- การปรับความเข้ม	49
บทที่ 4 อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	50
ภาคผนวก	
- ภาคผนวก ก รายละเอียดทางฮาร์ดแวร์	
- ภาคผนวก ข DATA SHEET	
หนังสืออ้างอิง	

บทที่ 1

หลักการและการทำงานทั่วไป

จากหลักการทั่วไปจะประกอบด้วยภาค Control และภาค Driver โดยส่วนแสดงผลจะเป็น 7 เซ็กเมนต์ ในการแสดงผล ซึ่งการแสดงผลจะมีอยู่ 3 ส่วนคือ 1. ส่วนของเวลา 2. ส่วนของอุณหภูมิ และ 3. ส่วนของวันที่ สามารถกำหนดการแสดงผลของแต่ละส่วน โดยใช้ ดิพสวิทช์ โดยการแสดง จะเรียงลำดับวนไปเรื่อยๆ โดยจะเริ่มแสดงเวลา อุณหภูมิ และวันที่ สามารถกำหนดให้อะไรแสดงผลหรือไม่แสดงผลก็ได้ โดยกำหนดที่ ดิพสวิทช์เมื่อต้องการให้แสดงตัวไหนก็ปรับที่ดิพสวิทช์ โดยมีหลักการเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้

1. ภาคคอนโทรล จะประกอบด้วย CPU เบอร์ AT89C2051 ของบริษัท ATMEL นำมาใช้แบบไมโครคอนโทรลเลอร์ชิพเดี่ยว ในการควบคุมไอซีทั้งหมด โดยใช้พอร์ทอินพุท (INPUT) และเอาต์พุท (OUTPUT) ทั้งหมด 14 บิต มีรายละเอียดของบิตต่างๆ ดังนี้
 - P1.0 ใช้เป็นอินพุทและเอาต์พุท จะเป็นการรับ-ส่งข้อมูล (DATA) ของไอซี DS1620, DS1202, MAX7219
 - P1.1 จะเป็นเอาต์พุท โดยทำหน้าที่ กำหนดเป็น High เมื่อต้องการอ่านหรือเขียนข้อมูลลงในตัวไอซี
 - P1.2 เป็นขาที่ใช้ในการกำหนดจังหวะ ในการอ่านข้อมูลของไอซี MAX7219CNG
 - P1.3 เป็นขาที่ใช้ในการกำหนดจังหวะในการอ่าน เขียนข้อมูล ไอซี DS1620
 - P1.4 เป็นขาที่ใช้ในการกำหนดจังหวะ ในการอ่าน เขียนข้อมูล ไอซี DS1202(RTC)
 - P1.5, P1.6, P1.7 ใช้ในการกำหนด Enable และ Disable ในการแสดงผลเวลา อุณหภูมิ และวันที่ ตามลำดับ
 - P3.0 ถึง P3.3 ใช้เป็นคีย์สวิทช์
 - P3.4 ใช้ในการแสดงการทำงานของระบบ
 - P3.5 ไม่ได้ใช้งาน
 - P3.6 ไม่มี
 - P3.7 ใช้ในการส่ง Pulse ให้ MAX691CPE เพื่อเป็น Watch Dog
2. ภาค Driver จะประกอบด้วย MAX7219CNG เป็นส่วนควบคุมการแสดงผล โดยจะรับข้อมูลจากสายสัญญาณ 3 เส้น และจะทำการแสดงผลออก 7-เซ็กเมนต์ (7-SEGMENT) แบบมัลติเพล็กซ์ (MULTIPLEX) ส่งข้อมูล ไปขับการ์ดแสดงผลขนาด 5"X 2.5" โดยใช้ LED กลม สีแดง ต่ออนุกรมกัน เซ็กเมนต์ละ 16 ดวง ทั้งหมด 7 เซ็กเมนต์ทุก รวม 112

ดวง เป็นจำนวน 6 ดิจิต (DIGIT) และขีดคั่นกลางอีก 2 ขีด ใช้ทรานซิสเตอร์ เบอร์ C548B (NPN TRANSISTOR) โดยใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิทช์

การทำงาน

จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

1. ภาคคอนโทรลบอร์ด (CONTROL BOARD)
2. ภาคแสดงผล ประกอบด้วย
 - 2.1 ส่วนควบคุมการแสดงผลของ 7-เซ็กเมนต์
 - 2.2 ส่วนของ 7-เซ็กเมนต์
3. ภาคแหล่งจ่ายไฟ มี 2 แหล่ง คือ
 - 3.1 แหล่งจ่ายไฟ +5V
 - 3.2 แหล่งจ่ายไฟ +34V

1. ภาคคอนโทรลบอร์ด (Control Board)

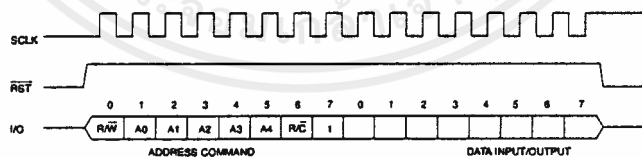
หลักการการทำงานของภาค คอนโทรลบอร์ด ประกอบด้วย

1.1 อ่านข้อมูลจาก RTC (Real Time Clock) ซึ่งให้อิซี DS1202 ของบริษัท DALLAS SEMI CONDUCTOR โดยจะทำการติดต่อกับอิซี ได้ดังนี้

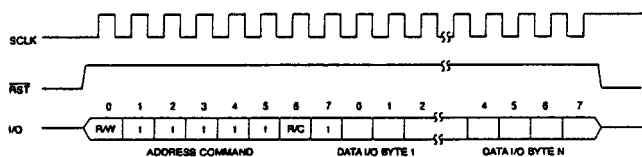
- กำหนด Address ของคำสั่ง 8 บิต
- กำหนดข้อมูลที่ต้องการเขียน 8 บิต โดยข้อมูลในการอ่านเขียน จะมีดังนี้

DATA TRANSFER SUMMARY Figure 3

SINGLE BYTE TRANSFER



BURST MODE TRANSFER



FUNCTION	BYTE N	SCLK n
CLOCK	8	72
RAM	24	200

รูป Timing diagram

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ทำการแก้ไข ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทำการ Set ขา RST ที่เป็น High เมื่อต้องการอ่านหรือเขียนข้อมูล

จากนั้น ส่งข้อมูล 1 ไบท์ และทำการส่ง Clock Pulse 1 ลูก เพื่อส่งข้อมูล 1 บิท จนครบทุกตัว ใน
 ทุกระณีเขียนข้อมูล ข้อมูลจะถูกส่งไป 16 บิท โดยเป็น ADDRESS COMMAND 8 บิท และ DATA 8
 บิท ส่วนการเขียน จะส่ง ADDRESS COMMAND 8 บิท และรับข้อมูล 8 บิท

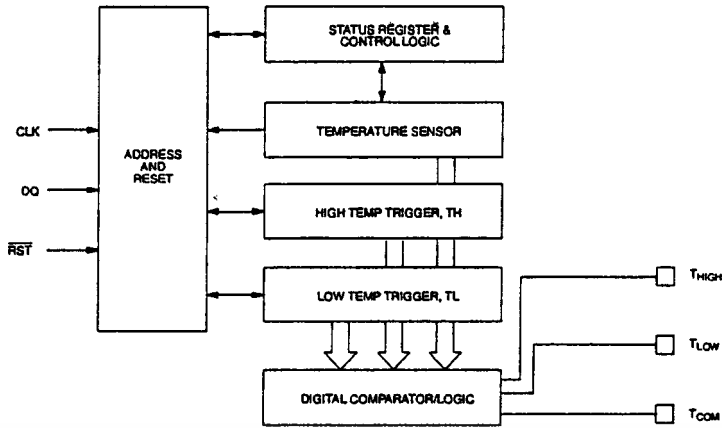
1.2 วงจรที่ต่อกับไอซี DS1202 จะประกอบด้วย CRYTAL มีความถี่ 32.768 KHZ. ต่อเข้ากับขา X1
 (ขา2)และX2(ขา3) และ C ขนาด 10 PF ที่ขา X1 และ X2 ลงกราวด์ และขา I/O (ขา6) ต่อกับ P1.0
 ขาRST (ขา5) ต่อกับ P1.1 ขา SLCK (ขา7) ตัดกับ P1.4

1.2.1 อ่านข้อมูลจากไอซี DS1620 ของบริษัท DALLAS Semi conductor

1.2.2 สามารถวัดอุณหภูมิและเวลาได้ตั้งแต่ -55 ถึง +125 องศาเซลเซียส โดยจะอ่านข้อมูล

แบบอนุกรมการใช้งานไอซี DS1620 มีหลักการใช้งานดังนี้ใช้ไอซีเบอร์ DS1620 (ตัวไอซีต้องซื้อ
 เพิ่มถ้าต้องการใช้) เป็นทั้งดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์และเทอร์โมสตัด โดยที่ภายในตัวไอซีมีเซนเซอร์
 อยู่ภายในไม่ต้องต่อภายนอก สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -55 องศาเซลเซียส ถึง -125 องศาเซ
 ลเซียส โดยมีความละเอียดที่ 0.5 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานแบบอิสระหรือจะต่อกับไมโคร
 คอนโทรลเลอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์จะใช้ P1.0 P1.1 และ P1.3 โดยการอ่านและเขียนจะใช้แบบ
 อนุกรม เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีทั้งพอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนานเพื่อเชื่อม
 คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งอาจจะเป็น โมเด็ม พรินเตอร์ เม้าส์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
 โดยทั้งพอร์ตขนานและพอร์ตอนุกรมสามารถนำมาใช้เพื่อการรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบซิงโครนัส
 ได้ ซึ่งความเร็วสูงกว่าการส่งสัญญาณอนุกรมซึ่งใช้อยู่บนพอร์ตอนุกรมมาตรฐาน RS-232 เนื่อง
 จากว่าการส่งแบบซิงโครนัสไม่จำเป็นที่จะต้องส่งบิทเริ่มต้น (Start Bit) และบิทปิดท้าย (Stop Bit)
 รวมไปกับข้อมูลในแต่ละไบต์ และไม่จำเป็นต้องมี UART คอยทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแบบ
 อนุกรมให้เป็นขนานอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะป้อนเข้าไปยังซีพียูเหมือนกับแบบอะซิงโครนัส บทความ
 นี้จะแสดงถึงวิธีการรับส่งข้อมูลอนุกรมแบบซิงโครนัส โดยใช้พอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์หรือจาก
 ขาอินพุทเอาต์พุทของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ไอซีดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์และโทโมสตัด
 เบอร์ DS1620 ของ Dallas Semiconductor ซึ่งไอซีตัวนี้จะใช้การติดต่อสื่อสารแบบอนุกรมโดยใช้
 สายเพียง 3 เส้น ภายใน DS1620 ไอซี DS1620 เป็นไอซีที่บรรจุอยู่ในตัวถังแบบ DIP 8 ขา ออก
 แบบมาเพื่อใช้สำหรับเป็นเทอร์โมมิเตอร์ หรือเป็นตัวตรวจจับอุณหภูมิแบบโปรแกรมได้ รูปที่ 1 จะ
 แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งขาและหน้าที่การทำงานของขาต่างๆ ไอซีตัวนี้สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้
 ตั้งแต่ช่วง-55 องศาเซลเซียสไปจนถึง +125 องศาเซลเซียส โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งใดๆ
 ทั้งสิ้น จาก 0 องศาเซลเซียสถึง 70 องศาเซลเซียส มีความผิดพลาดในการวัดประมาณเท่ากับ บวค
 ลบ 0.5 องศา และจะเพิ่มเป็นบวกลบ 2 องศา ที่สเกลในการวัดสูงสุด ซึ่งถือว่ายอมรับได้สำหรับ
 การใช้งานทั่วไป

DS1620 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM Figure 1



ไอซี DS1620 จะมีโหมดการทำงานอยู่สองโหมด คือแบบใช้สายเชื่อมต่อ 3 สาย (Three Wire Mode) และแบบทำงานเดี่ยวๆ (Stand Alone) สำหรับแบบ 3 สายนั้น คอมพิวเตอร์จะส่งคำสั่งเพื่อให้ ไอซีเริ่มต้นการตรวจจับและแปลงข้อมูล อ่านค่าอุณหภูมิที่ถูกจัดเก็บไว้ภายในไอซีและเขียนค่าไปยังจุดกำหนดค่าสำหรับเตือนอุณหภูมิหรือค่ากว่าที่กำหนด กำหนดโหมดการทำงาน อ่านค่าสัญญาณที่ได้จากการแปลงและสถานะการเตือน

ในโหมดเชื่อมต่อแบบ 3 สายนั้น คอมพิวเตอร์จะต้องมีขาเอาต์พุตพอร์ต 2 ขา สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับขา CLK/CONV และขา RST บนไอซี DS1620 และขาพอร์ตแบบ 2 ทิศทางอีก 1 ขา สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับขา DQ ของไอซี DS1620 โดยมีแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์ จ่ายให้กับตัวไอซีด้วย ไอซี DS1620 จะมีเอาต์พุต เป็นสัญญาณเตือนอยู่ 3 ขา คือขา THIGH จะมีสถานะเป็น HIGH เมื่อค่าอุณหภูมิที่ตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ในรีจิสเตอร์ TH ของ TLOW จะมีสถานะเป็น HIGH เมื่อค่าอุณหภูมิมิมีค่าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ในรีจิสเตอร์ TL และขา TCOM (Combination) จะมีสถานะเป็น HIGH เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าในรีจิสเตอร์ TH และจะคงสถานะไว้จนกว่าค่าอุณหภูมิจะต่ำกว่ารีจิสเตอร์ TL เราสามารถที่จะเชื่อมต่อสัญญาณเตือนเหล่านี้เข้ากับพอร์ตอินพุตเอาต์พุต หรือขาอินเตอร์รัปของคอมพิวเตอร์ได้ หรือจะใช้ขา TCOM สำหรับการเปิดสวิตเตอร์ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และปิดที่ 10 องศาเซลเซียสก็ทำได้ ในขณะที่ใช้งานในโหมด 3 สาย เราสามารถที่จะกำหนดค่าต่างๆ ให้กับ ไอซีเพื่อให้ทำงานในโหมดเดี่ยวๆได้ ในโหมดนี้จะมีข้อจำกัดอยู่มากแต่ไม่ต้องการการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำงานได้โดย จะต้องให้ขา RST และขา CLK/CONV เป็น LOW หรือป้อนให้ขา CLK/CONV เป็น LOW ในขณะที่ต้องการตรวจวัด ซึ่งทั้งสองวิธีสามารถใช้สัญญาณเตือนทั้ง 3 ขา ด้วยการแสดงผลและการควบคุมต่างๆได้ สำหรับการเขียนข้อมูลไปยัง ไอซี DS1620 ในโหมด 3 สายนั้น อันดับแรก จะต้องส่งคำสั่งขนาด 8 บิต ออกไปก่อนเพื่อบอก DS1620 ถึงชนิดของข้อมูลที่จะเขียนลงไป จะแสดงคำสั่ง 9 คำสั่งที่ใช้เพื่อควบคุม DS1620 รีจิสเตอร์ที่ใช้เป็นข้อมูลอุณหภูมินั้นจะมีขนาด 9 บิต เพื่อที่จะเก็บค่าได้ทั้งค่าที่เป็นบวกและค่าเป็นลบ

โดยจะมีความละเอียดของข้อมูลเท่ากับ 0.5 องศา สำหรับค่าอุณหภูมิที่เป็นบวกบิตที่ 8 จะเป็น 0 บิต บิตที่ 1-7 จะเป็นค่าตัวเลขจำนวนเต็มของอุณหภูมิ ส่วนบิต 0 ถ้ามีค่าเป็น 1 หมายความว่า จะต้องบวก ค่าอุณหภูมิเข้ากับเลขจำนวนเต็มอีก 0.5 องศา กรณีที่อุณหภูมิเป็นลบนั้นก็คล้ายๆกันคือ บิตที่ 8 จะเป็น 1 และค่าอุณหภูมิจะถูกจัดอยู่ในรูปของ 2 Complement (การหาค่า 2 'Complement ทำได้โดยการกลับค่าตัวเลขฐาน 2 แล้วบวกเข้าไปอีก 1) การอ่านและเขียนค่า ไปยัง DS1620 จะต้องทำตาม ขั้นตอนดังนี้คือ

1. ให้ขา RST เป็น LOW และ CLK/CONV เป็น HIGH กำหนดให้ขาพอร์ตที่ต่ออยู่กับขา GQ เป็นเอาต์พุต
2. เปลี่ยนให้ขา RST เป็น HIGH
3. เปลี่ยนให้ขา CLK/CONV เป็น LOW
4. กำหนดค่าข้อมูลสำหรับบิต 0 ให้กับขา DQ สำหรับการป้อนคำสั่งควบคุม
5. เปลี่ยนให้ขา CLK/CONV เป็น HIGH
6. ทำตามขั้นตอนที่ 3-5 สำหรับคำสั่งควบคุมบิตที่ 1-7 ที่เหลือ การเขียนค่าข้อมูล ไปยังไอซี จะต้องทำตามขั้นตอนต่อจากขั้นตอนข้างบนดังนี้คือ
 - 7w. ทำตามขั้นตอนที่ 3-5 สำหรับการเขียนข้อมูลบิต 0-7 หรือบิต 0-8 ไปยังไอซี
 - 8w. ให้ขา RST เป็น LOW อย่างน้อยที่สุด 5 มิลลิวินาที การอ่านค่าข้อมูลจาก DS1620 จะต้องทำตามขั้นตอนที่ 1-6 แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้คือ
 - 7R. เปลี่ยนขาพอร์ตที่ต่ออยู่กับขา DQ ให้เป็นอินพุตสำหรับการอ่านค่าข้อมูล
 - 8R. เปลี่ยนขา CLK/CONV ให้เป็น LOW ทำให้เป็น DQ เป็นเอาต์พุตพร้อมที่จะส่งข้อมูลให้อ่าน
 - 9R. อ่านและเก็บค่าบิต 0 จากขา DQ
 - 10R. เปลี่ยนขา CLK/CONV เป็น HIGH
 - 11R. ทำตามขั้นตอนที่ 8-10 สำหรับการอ่านค่าบิต 1-7 หรือ 1-8 ที่เหลือ
 - 12R. เปลี่ยนให้ขา RST เป็น LOW
 - 13R. เปลี่ยนขาพอร์ตที่ต่ออยู่กับขา DQ ให้เป็นเอาต์พุตอีกครั้ง

ค่าต่ำสุดของ DS1620 ได้กำหนดค่าการหน่วงเวลาดำสุดขณะทำงานในแต่ละคำสั่งเอาไว้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจมากนัก เนื่องจากเวลาที่กำหนดไว้นี้มีค่าน้อยมาก (125 นาโนวินาที หรือน้อยกว่า) แต่มีอยู่ 2 ช่วงที่จำเป็นจะต้องกำหนดค่าการหน่วงเวลาให้กับมัน นั่นคือหลังจากที่เขียนข้อมูล ไปยัง DS1620 แล้วจะต้องคงสถานะขา RST เป็น Low ไว้ไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิวินาที ช่วงเวลานี้ก็เพื่อให้ EEPROM ภายใน DS1620 มีเวลาพอที่จะเก็บข้อมูล นอกจากนี้ DS1620 ยังต้องการเวลาอีก 1 วินาทีหลังจากทำคำสั่งเริ่มต้นการแปลงข้อมูล (EEH) จึงจะสามารถทำคำสั่ง สำหรับการอ่านค่าผลลัพธ์(AAH) ได้

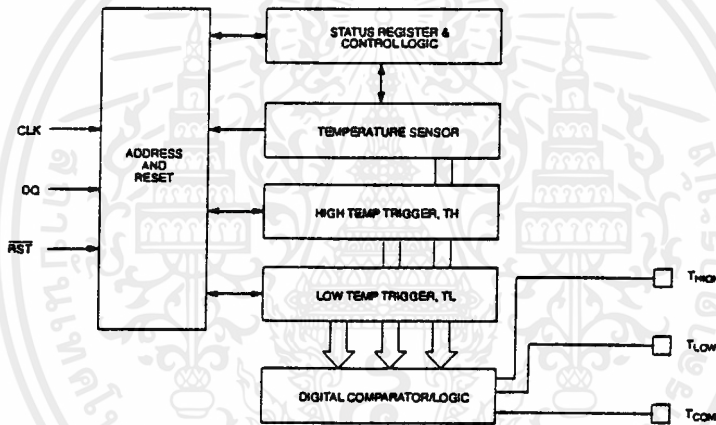
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ต่างจากชิปแบบอนุกรมบางตัว สัญญาณนาฬิกาของ DS1620 ไม่มีสัญญาณนาฬิกาต่ำสุด ดังนั้นเราสามารถใส่สัญญาณนาฬิกาเท่าไรก็ได้ตามที่เราร้องการ แต่สัญญาณนาฬิกาสูงสุดจะอยู่ที่ 4 เมกะเฮิรตซ์

การใช้งาน DS1620

มีหลายวิธีที่จะเชื่อมต่อกับไอซี DS1620 เราสามารถที่จะต่อ DS1620 เข้ากับบิตอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไอซีที่ทำหน้าที่เป็นพอร์ตอย่าง 8255 ก็ได้ เราสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้พอร์ตนานของคอมพิวเตอร์ หรือ จะโปรแกรม DS1620 ให้ทำงานเป็นเครื่องเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปโดยไม่จำเป็น ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เข้ากับมันก็ได้ การเชื่อมต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์

DS1620 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM Figure 1



การเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ถ้ามองในแง่ของฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดนั้นขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุตของมันจะเป็นแบบ 2 ทิศทางอยู่แล้วและมีคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานในระดับบิตได้ ดังนั้น เราสามารถที่สั่งให้บิตไหนทำหน้าที่เป็นอินพุตหรือทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตก็ได้ การเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นการใช้งานที่ง่ายมาก ถ้าต้องการใช้กับระบบที่มีขนาดเล็ก โดยเพียงแต่เชื่อมบิตอินพุตเอาต์พุตที่ว่างเข้ากับขา CLK/CONV ขา RST และ DQ และเชื่อมเข้ากับขา THIGH TLOW และขา TCOM ถ้าต้องการอ่านค่าจากขาเหล่านี้

ในการออกแบบวงจรถ้า DS1620 อยู่บนบอร์ดเดียวกันกับไมโครคอนโทรลเลอร์และอยู่ห่างกันไม่เกิน 1 ฟุต ก็ไม่จำเป็นต้องต่อบัฟเฟอร์หรือวงจรไดรเวอร์เพื่อขยายสัญญาณ ส่วนในกรณีที่ใช้ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 8051 ต้องจำไว้เสมอว่าจะต้องส่งค่า 1 ออกไปยังบิตที่ต้องการใช้เป็นอินพุตก่อน แล้วจึงค่อยอ่านค่าเข้ามา แต่สำหรับไมโคร

คอนโทรลเลอร์ นั้นมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางอยู่แล้ว จึงสามารถกำหนดให้แต่ละบิตเป็น อินพุทหรือ เอาท์พุทได้โดยตรง DS1620 ใช้มาตรฐานแรงดันเป็นแบบที่ทีแอล ซึ่งกำหนดให้ เอาท์พุทลอจิก HIGH มีแรงดันมากกว่า 2.4 โวลต์ขึ้นไป ไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดรวมถึงที่เป็นชนิดซิมอสก็สามารถทำงานได้ที่ระดับแรงดันแบบที่ทีแอล ดังนั้นจึงไม่เป็นปัญหาเลยเมื่อต่อ DS1620 โดยตรงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ถ้าจำเป็นต้องต่อกับขาอินพุทที่เป็นซิมอสก็สามารถพูลอัพขา DQ ด้วยตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์ม เพื่อให้แน่ใจว่าที่ลอจิก HIGH มีแรงดันอย่างน้อยที่สุดคือ 3.5 โวลต์

1.3 ชุดสำรองข้อมูลเมื่อไฟดับ และว็อดดอก (Watch Dog) ใช้ IC MAX691CPE

ในการสำรองข้อมูล และเป็น Watch Dog Timer แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน

1.3.1 การสำรองข้อมูล จะทำการต่อแบตเตอรี่ลิเทียม 3 โวลต์ ที่ขา

VBATT และแรงดัน VOUT จาก MAX691 ต่อที่ขา VCC ของ RTC(DS1202) ที่ขา VOUT ที่ระดับแรงดันปกติ 5 V จะเสมือนถูกต่อกับ VCC ภายใน MAX691 ดังนั้น เมื่อไฟดับ และระดับแรงไฟตกต่ำกว่า VBATT (จากแบตเตอรี่ลิเทียม 3 โวลต์) ที่ขา VOUT ระดับแรงไฟจะเท่ากับแรงดันจากแบตเตอรี่ลิเทียม ทำให้สามารถทำให้ข้อมูลภายใน RTC ไม่มีการสูญหาย

1.3.2 ส่วนของ Watch Dog Timer เป็นวงจรตรวจสอบการทำงานของ

ระบบไมโครว่าทำงานในสภาวะปกติหรือไม่ ถ้าระบบทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงาน วงจรส่วนนี้จะทำการส่งสัญญาณไปทำการรีเซ็ตซีพียู ให้เริ่มทำงานใหม่ การใช้งานจะต้องส่งสัญญาณไปกระตุ้นที่ขา WDI (WATCH DOG INPUT) ของ MAX691 โดยที่ขา OSCIN และ OSC SEL ของ MAX691 ไม่ได้ใช้งานปล่อยเอาไว้จะเป็นการใช้ค่าเวลาในการรับข้อมูลของ WATCH DOG 1.6 SEC เพราะฉะนั้น ซีพียู จะต้องส่งสัญญาณไปกระตุ้นขา WDI ภายใน 1.6 SEC ขา WDI จะต้องกับ PORT P3.7 จะใช้คำสั่ง CPL P3.7 ก่อนเวลา 1.6 SEC ถ้าถึงเวลา 1.6 SEC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่ขา WDI IC MAX691 จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นที่ขา Reset ของ CPU ทุกๆ 1.6 SEC จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่ขา WDI อีกครั้ง

2. ภาคแสดงผล

ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนควบคุมการแสดงผลของ 7-SEGMENT และส่วนของ 7-SEGMENT

2.1 ส่วนควบคุมการแสดงผล 7-SEGMENT (7-SEGMENT CONTROL UNIT)

จะประกอบด้วย IC MAX7219CNG การแสดงผลการทำงานของระบบไมโครคอมพิวเตอร์นับว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งการแสดงผลการทำงานของระบบไมโครคอมพิวเตอร์นับว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งการแสดงผลอาจทำได้มากมายหลายวิธี โดยอาจเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสมของงาน เช่น หลอดแสดงผล LED สีต่างๆ แฉงแสดงผลแบบตัวเลข 7 ส่วน (7-SEGMENT) จอแสดงผล LCD ลำโพง เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในระบบไมโครคอมพิวเตอร์นั้น การแสดงผลด้วยแผงแสดงผลแบบตัวเลข 7 ส่วน นับเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่กำลังเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งการแสดงผลด้วยแผงแสดงผลแบบตัวเลข 7 ส่วนนี้ หากต้องใช้การแสดงผลหลายๆหลักแล้ว การควบคุมการแสดงผลอาจมีความยุ่งยาก ทั้งทางด้าน Soft-Ware และ Hard-Ware ซึ่งวิธีการควบคุมการแสดงผลอาจทำได้หลายวิธีเช่น ใช้วิธีการ Latch ข้อมูล ซึ่งวิธีนี้ต้องใช้วงจรและอุปกรณ์ควบคุมหลายตัวและกินกำลังงานสูง หรือหากใช้การสะแกน โดยการเขียน โปรแกรมสั่งงานให้ CPU มาควบคุมการแสดงผลก็มักจะประสบปัญหาเมื่อ CPU มีความจำเป็นต้องไปทำงานอย่างอื่นเป็นเวลานานๆแล้วจะทำให้ส่วนแสดงผลหยุดทำงานหรือดับไป

จากปัญหาดังกล่าว เราจึงใช้ไอซี MAX7219 ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงผลของแผงแสดงผลแบบตัวเลข 7 ส่วน จำนวน 8 หลัก ซึ่งให้ IC MAX7219 เป็นตัวควบคุมการแสดงผล ทำให้วงจรมีขนาดเล็กและการเขียน โปรแกรมสั่งงานก็ง่ายและสะดวกมากขึ้น

คุณสมบัติ

- ทำงานที่ความเร็วสูงถึง 10 เมกะเฮิรตซ์
- สามารถควบคุมการแสดงผลของแผงแสดงผลแบบตัวเลข 7 ส่วน ชนิดคอมมอนแคโอด ได้ 8 หลักต่อบอร์ดควบคุม 1 ชุด และสามารถต่ออนุกรมกันเพื่อเพิ่มจำนวนหลักของการแสดงผลให้ได้หลายๆหลักอีกด้วย
- สามารถควบคุมความสว่างของการแสดงผลได้ 16 ระดับ ด้วย Soft-Ware
- ใช้การเชื่อมต่อแบบอนุกรม โดยใช้สัญญาณในการเชื่อมต่อเพียง 3 เส้นทำให้ประหยัดพอร์ตควบคุมได้เป็นอย่างมาก
- ใช้การสั่งงานให้แสดงผลเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นบอร์ดจะทำการควบคุมการแสดงผลของแผงแสดงผลทุกหลักเอง จนกว่าเราต้องการเปลี่ยนค่าการแสดงผลเป็นค่าใหม่ จึงจะส่งข้อมูลและคำสั่งใหม่ให้บอร์ดอีกทำให้ง่ายต่อการเขียน โปรแกรมควบคุมเพราะสามารถให้ CPU ไปทำงานอย่างอื่นได้โดยไม่ต้องกลัวว่าส่วนแสดงผลจะหยุดทำงาน
- ใช้ไฟเลี้ยงเดี่ยว +5 โวลท์ 1 ชุด
- สามารถ โปรแกรมโหมด การแสดงผลได้ 2 โหมด คือโหมดแสดงผลด้วยรหัส BCD และโหมดแสดงผลตามค่าที่กำหนดให้
- ขณะไม่มีการแสดงผลกินกำลังงานต่ำมาก เพียง 150 ไมโครแอมป์
- ขณะเปิดเครื่องครั้งแรก จอแสดงผลทุกหลักจะไม่แสดงผล (ว่าง) หมดปัญหาเรื่องการแสดงค่าที่ไม่ต้องการ
- ขนาดเล็กกระทัดรัดเพียง 1.5" x 6.5 " (4cm x 16.5cm)

- DIN เป็นขาสัญญาณอินพุต ใช้สำหรับรับข้อมูลอินพุตแบบอนุกรม โดยข้อมูลจะถูกค
โหลดเข้าไปอยู่ในชิพตรีจิสเตอร์ ขนาด 16 บิต โดยสัมพันธ์กับสัญญาณนาฬิกา ที่ส่งเข้ามาทางขา
CLK โดยข้อมูลจะเริ่มจาก D15..Do

- CLK เป็นขาสัญญาณอินพุต ใช้สำหรับรับสัญญาณนาฬิกาอินพุตจากภายนอก ซึ่งมี
อัตราความเร็วสูงสุด 10 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเมื่อสัญญาณนาฬิกาเป็นช่วงขอบขาขึ้น (Rising Edge)
สัญญาณข้อมูลจากขา DIN จะถูกเคลื่อนเข้าไปสู่ชิพตรีจิสเตอร์ภายใน เมื่อสัญญาณนาฬิกาเป็นช่วง
ขอบขาลง (Falling Edge) ข้อมูลที่อยู่ในชิพตรีจิสเตอร์ตำแหน่งสุดท้าย (D15) จะถูกเคลื่อนออกมาที่
ขาสัญญาณ DOUT

- LOAD เป็นขาสัญญาณอินพุต ใช้สำหรับควบคุมการโหลดข้อมูลที่ถูกเคลื่อนเข้ามารอไว้
ในชิพตรีจิสเตอร์เข้าไปยังหน่วยความจำของ IC MAX7219 โดยค่าในชิพตรีจิสเตอร์ทั้งหมดจะถูก
โหลดเมื่อสัญญาณนาฬิกาที่ขา LOAD เป็นขอบขาขึ้น (Rising Edge)

- DOUT เป็นขาสัญญาณเอาต์พุต ซึ่งเป็นข้อมูลแบบอนุกรมชุดเดียวกันกับ สัญญาณ DIN
โดย สัญญาณ DOUT นี้เราใช้สำหรับต่อเข้ากับสัญญาณ DIN ของบอร์ดถัดไป เมื่อต้อง
การเพิ่มจำนวนหลักแสดงผลให้มากขึ้น
ระบบวอตซ์คือ

เป็นหน้าที่การทำงานส่วนหนึ่งของไอซี MAX691 โดยช่วยให้การทำงานของระบบมีความ
แน่นอนมากขึ้น โดยอันดับแรกจะต้องเซตอัมเปอร์เพื่ออินาเบิ้ลวอตซ์คือกเสียก่อน แล้วจะต้อง
เขียน โปรแกรมเพื่อส่งสัญญาณมากระตุ้นที่ขา P1.7 ของซีพียูอย่างสม่ำเสมอ ถ้าการกระตุ้นขาดหาย
ไป MAX691 จะเข้าใจว่าซีพียูหยุดทำงาน MAX691 จะทำการรีเซตระบบโดยทันที เป็นการช่วย
ให้ระบบกลับเข้าสู่โหมดการทำงานปกติอีกครั้ง

2.2 ส่วนของ 7-SEGMENT ประกอบด้วย LED ต่ออนุกรมและให้ทรานซิสเตอร์ชนิด

NPN ในการขับแต่ละ SEGMENT

จากวงจร ใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN 3 ตัวในการขับ LED และการขับ LED จะรับ INPUT
จาก IC MAX7219CNG มาทำการควบคุมวงจร ซึ่ง IC MAX7219 ต้องการ 7-SEGMENT
แบบ COMMON CATHODE ในกรณีควบคุม

บทที่ 2

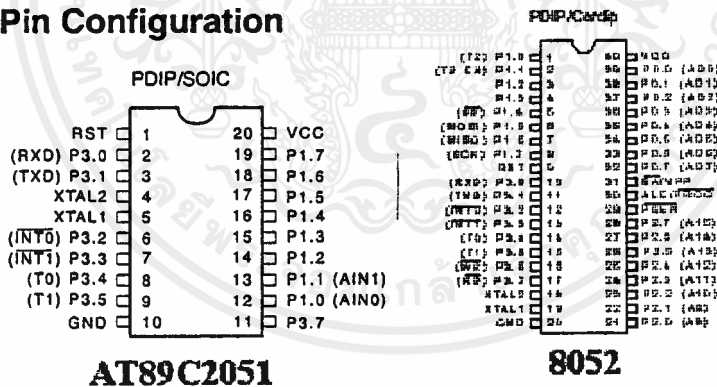
การพัฒนาการเขียนโปรแกรมและโปรแกรมการใช้งาน

การพัฒนาการเขียนโปรแกรมไอซีนั้น สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1. การพัฒนาโดยการจำลองพอร์ตต่างๆของ ไอซี AT89C2051 โดยใช้ไมโคร

คอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS51 เนื่องจาก IC AT89C2051 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูลดังกล่าว ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานขนาดเล็กมีพอร์ตใช้งานคือ Port P1 และ P3 เราจึงสามารถใช้ไอซีในตระกูล MCS51 ในการทดลอง เนื่องจาก IC AT89C2051 สามารถโปรแกรมได้ 1000 ครั้ง ในการพัฒนาโปรแกรมจะต้องใช้การเขียนและทดลองหลายครั้ง จากไม่สะดวกในการทดลองโปรแกรม จึงต้องใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ 8031,8032,8051,8052 DS5000T หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นนำมาต่อ ROM และใช้อีพ롬 อิมูเลท ในการรับ INTEL HEX FILE จาก COMPUTER มาทำการทดลอง ทำให้สามารถทดลองได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น หรือจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ DS5000T ในการทดลอง เพราะ DS5000T มีหน่วยความจำภายใน 64K bytes สามารถแบ่งหน่วยความจำเป็น ROM และ RAM ได้ สามารถโปรแกรมลงในตัวไอซีได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยะเวลา 10 ปี โดยรับข้อมูล INTEL HEX FILE จาก Port Com ของ Computer ตามมาตรฐาน RS232C

Pin Configuration



รูปภาพแสดงไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C2051 และไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS51

2. ใช้วิธีการนำไอซี ไปโปรแกรมโดยเครื่องโปรแกรมและทำการทดลอง แต่จะเป็นการไม่สะดวกเพราะจะต้องทำการถอดตัว ไอซีออกจาก SOCKET บ่อยๆอาจทำให้ไอซีได้รับความเสียหายได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการทดลองแบบที่ 1 ควรจำไว้ว่า IC AT89C2051 ทำงานแบบ Single Ship การอ้างข้อมูลจากหน่วยความจำจะต้องอ้างจากหน่วยความจำภายในเท่านั้น และใช้คำสั่ง Move a.@a+dptr ห้ามใช้ MoveX เพราะในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มีหน่วยความจำภายในขนาด 2K เท่านั้น

โปรแกรมการใช้งาน

ในโปรแกรมการใช้งาน จะประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานดังนี้ โดยจะเริ่มแรก CPU จะทำการเซตค่าเริ่มต้นต่างๆ ให้กับระบบ จากนั้นจะทำการแสดงข้อมูลต่างๆ ออก 7-SEGMENT โดยเรียงลำดับจากเวลา อุณหภูมิ และวันที่ในการแสดงตรวจสอบจาก DIP SWITCH ซึ่งใช้ในการ Enable และ Disable เวลา อุณหภูมิ และวันที่ โดยใช้พอร์ต Port P1.5, P1.6, P1.7 ในการตรวจสอบจำเป็นต้องการให้แสดงเวลา อุณหภูมิ และวันที่ ตามลำดับ และจะรอการกด Key จากผู้ใช้เพื่อใช้งาน Functions ต่างๆ ในการเซตค่าต่างๆ ของระบบ ประกอบด้วย SWITCH A B C โดย SWITCH C จะต่อกับขา P3.2 ซึ่งเป็นขา INTO เมื่อมีการกด SWITCH C จะเข้าไปในโหมดการใช้งาน Function และจะรอรับการกด SWITCH A, B, C, D อีกครั้งเพื่อเซต Function โดยเมื่อกด SWITCH C จะทำการ INTERRUPT ของ INTO โปรแกรมจะทำการทำงานที่ ADDRESS 03H โดยจะเป็นการรอรับ Key อีกครั้งเพื่อเลือก Function โดย SWITCH A จะเป็นการตั้งเวลา B จะเป็นการตั้งวันที่ C จะเป็นการปรับระยะเวลาการแสดงผล 4 ระดับ และ D จะเป็นการปรับความเข้มของ 7-SEGMENT

- Function A เมื่อเลือก Function จะเข้าสู่โหมดการตั้งเวลา โดยจะรอรับ SWITCH A, B, D โดย SWITCH A จะเข้าสู่การตั้งหลักชั่วโมง โดยจะเพิ่มค่าทีละ 1 ค่า จากเวลาที่แสดงอยู่ โดยได้จากการอ่าน RTC แล้วเก็บไว้ในหน่วยความจำและทำค่ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ SWITCH B จะเป็นการตั้งหลักนาที โดยเพิ่มค่าขึ้นเรื่อยๆ ส่วน SWITCH D จะเป็นการเซตเวลา และออกจากการ INTERRUPT เข้าสู่โหมดการทำงานปกติ

- Function B จะเป็นการตั้งวันที่ โดยจะรอรับ SWITCH A, B, C และ D โดย SWITCH A จะตั้งวัน SWITCH B จะตั้งเดือน SWITCH C จะตั้งปี โดยการกด 1 ครั้งจะเพิ่มค่า 1 ค่า และ SWITCH D จะเป็นการเซตระบบออกจากการ INTERRUPT เข้าสู่การทำงานปกติ

- Function C จะตั้งค่าหน่วยเวลาการแสดงผลต่างๆ 4 ค่า โดยจะรอรับ Key 4 KEY (A, B, C, D) โดย SWITCH A จะให้ค่าน้อยที่สุด และ SWITCH D จะให้ค่ามากที่สุด และจะนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ใน memory ภายใน เพื่อใช้ในการตั้งเวลา จากนั้นจึงออกจากระบบเข้าสู่การทำงานปกติ

- Function D จะเป็นการปรับความเข้มของ 7-SEGMENT โดยจะรอรับ Key A เพื่อปรับระดับความสว่าง ส่วน SWITCH B, C, D จะทำการเซตค่า แล้วออกจากการ INTERRUPT ในการรอรับการกด Key นั้น จะรอเวลาประมาณ 15 วินาที ถ้าไม่มีการกด Key เข้ามา โปรแกรมจะหยุดทำงาน โดยการหยุดอยู่กับที่โดยใช้คำสั่ง JMP \$ เพื่อรอรับการเซตจาก MAX691 เพื่อเข้าสู่การทำงาน โหมดปกติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในโหมดการควบคุม WATCH DOG จะทำการส่งกลับบิตที่ขา P3.7 โดยใช้คำสั่ง CPL P3.7 กดโดยใช้ INTERRUPT Timer 0

โปรแกรมการใช้งาน

```

ORG 0000H
BUNCH EQU 1FH
    JMP MAIN
    JMP INT_0
ORG 0BH
INT_TIMER0:
    MOV TL0,#00
    MOV TH0,#10           ;Load value for over flow
    CPL P3.7             ;end pluse for watch dog before 1.6 ms
    CPL P3.4             ;stand by mode status
    RETI
;-----
;Sub program for setup value for set date time
INT_0:
    CLR EA
    MOV P3,#0FFH
LOOPX: JNB P3.2,LOOPX
    CALL SETUP_SHOW
    CALL IN_KEY
    PUSH ACC
    CALL CODEB
    POP ACC
KTIME:
    CJNE A,#1,KDATE
    CALL SETTIMEX
    JMP EXITG

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

KDATE:

CJNE A,#2,KDELAY

CALL SETDATEX

JMP EXITG

KDELAY:

CJNE A,#3,KINTEN

CALL SET_DELAY

JMP EXITG

KINTEN:

CJNE A,#4,EXITW

CALL INTEN

EXITG:

CALL SETUP_WORK

EXITW:

MOV DPTR,#MAIN1

MOV SP,#09H

MOV 07H,#00

MOV 08H,DPL

MOV 09H,DPH

SETB EA

RETI

MAIN:

MOV 75H,#0FH

MAIN1:

CALL INIT_7219

CALL CODEB ;MODE BCD CODE

MOV P3,#0FFH

CLR IT0

SETB EA

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

CALL SCANL
MOV A,#1
CALL DELAY_SEC
CALL CODEB
RET

```

BEGIN:

```
CALL INIT_7219
```

START_TIME:

```

SETB P1.5
JB P1.5,READTIMEX
MOV R7,#1
JMP READ_THERMO

```

READTIMEX:

```
MOV B,39H
```

NEW_READ_TIME:

```

PUSH B
CALL INIT_7219
CALL TIME_DISPLAY ;READ TIME
CALL TIME
MOV A,#2FH
CALL DELAY_MS
POP B
DJNZ B,NEW_READ_TIME
MOV R7,#0

```

READ_THERMO:

```

SETB P1.6
JB P1.6,START_THERMO
INC R7
JMP READDATEX

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

START_THERMO:

CALL INIT_7219

MOV R6,#0FCH

MOV R7,#09H

CALL SEND_AD

MOV A,39H

SUBB A,#2FH

MOV B,A

T1X: CALL READT

PUSH B

MOV 41H,36H

MOV 42H,37H

MOV 43H,38H

MOV 44H,#0FH

MOV 45H,#0E3H ;CEL 63H

MOV 46H,#4EH

CALL SCANL

POP B

DJNZ B,T1X

MOV R7,#3

CALL INIT_7219

READDATEX:

SETB P1.7

JB P1.7,START_DATE

CJNE R7,#2,BUFT1

MOV R7,#1

JMP READTIMEX



```
START_DATE:
```

```
MOV B,39H
```

```
NEW_READ_DATE:
```

```
PUSH B
```

```
CALL INIT_7219
```

```
CALL DATE_DISPLAY ;READ TIME
```

```
CALL DATE
```

```
MOV A,#2FH
```

```
CALL DELAY_MS
```

```
POP B
```

```
DJNZ B,NEW_READ_DATE
```

```
JMP MAIN1
```

```
BUFT1:
```

```
JMP BEGIN
```

```
;SUB PROGRAM SET TIME
```

```
SETTIMEX:
```

```
CALL TIME_DISPLAY
```

```
CALL TIME
```

```
CALL IN_KEY
```

```
IN_HOUR:
```

```
CJNE A,#1,IN_MINUTE
```

```
INC 30H
```

```
MOV A,30H
```

```
PUSH ACC
```

```
ANL A,#0FH
```

```
SUBB A,#0AH
```

```
JC NOT_OVER0
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

POP ACC
ANL A,#0F0H
SWAP A
INC A
SWAP A
MOV 30H,A
JMP OVER0

```

```

NOT_OVER0:

```

```

POP ACC

```

```

OVER0:

```

```

SUBB A,#23H
JC SOK
MOV 30H,#00

```

```

SOK:

```

```

CALL WTIME
JMP SETTIMEX

```

XXXXXXXXXXXXXXXX

```

IN_MINUTE:

```

```

CJNE A,#2,SET_EXIT
INC 31H
MOV A,31H

PUSH ACC
ANL A,#0FH

SUBB A,#0AH
JC NOT_OVER

```



```
POP ACC
ANL A,#0F0H
SWAP A
INC A
SWAP A
MOV 31H,A
JMP OVER
```

NOT_OVER:

```
POP ACC
```

OVER:

```
SUBB A,#59H
JC SOK1
MOV 31H,#00
```

SOK1:

```
CALL WTIME
JMP SETTIMEX
```

SET_EXIT:

```
CJNE A,#4,SETTIMEX
RET
```

SETDATEX:

```
CALL DATE_DISPLAY
CALL DATE
CALL IN_KEY
```

IN_DAY:

```
CJNE A,#1,IN_MOUNTH
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์
 038916
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

INC 33H
MOV A,33H

PUSH ACC
ANL A,#0FH

SUBB A,#0AH
JC NOT_OVER00

```

```

POP ACC
ANL A,#0F0H
SWAP A
INC A
SWAP A
MOV 33H,A
JMP OVER00

```

```
NOT_OVER00:
```

```
POP ACC
```

```
OVER00:
```

```
SUBB A,#31H
```

```
JC SOK0
```

```
MOV 33H,#00
```

```
SOK0:
```

```
CALL WTIME
```

```
JMP SETDATEX
```

```
IN_MOUNTH:
```

```
CJNE A,#2,IN_YEAR
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

INC 34H
MOV A,34H

PUSH ACC
ANL A,#0FH

SUBB A,#0AH
JC NOT_OVERM

POP ACC
ANL A,#0F0H
SWAP A
INC A
SWAP A
MOV 34H,A
JMP OVERM

NOT_OVERM:
POP ACC

OVERM:
SUBB A,#12H
JC SOK1M
MOV 34H,#00

SOK1M:
CALL WTIME
JMP SETDATEX

IN_YEAR:
CJNE A,#3,SET_EXITD
INC 35H
MOV A,35H

```



```

PUSH ACC
ANL A,#0FH

SUBB A,#0AH
JC NOT_OVERY

POP ACC
ANL A,#0F0H
SWAP A
INC A
SWAP A
MOV 35H,A
JMP OVERY

NOT_OVERY:
POP ACC
OVERY:
SUBB A,#99H
JC SOK1Y
MOV 35H,#00
SOK1Y:
CALL WTIME
JMP SETDATEX

SET_EXITD:
RET

```

```

;SET DELAY WAIT FUNCTION

```

```

SET_DELAY:
MOV 40H,#0EH
MOV 42H,#0FH
MOV 43H,#1

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV 44H,#2
MOV 45H,#3
MOV 46H,#4
CALL SCANL
CALL CBUFFER_B
CALL IN_KEY
TDELAY1:
CJNE A,#1,TDELAY2
MOV 39H,#3FH
MOV 43H,#1
TDELAY2:
CJNE A,#2,TDELAY3
MOV 39H,#8FH
MOV 44H,#2
TDELAY3:
CJNE A,#3,TDELAY4
MOV 39H,#0AFH
MOV 45H,#3
TDELAY4:
CJNE A,#4,EXT_FUNC
MOV 39H,#0FFH
MOV 46H,#4
EXT_FUNC:
CALL SCANL
MOV A,#2
CALL DELAY_SEC
RET

```

```
INTEN:
```

```
MOV 75H,#0FH
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

INTENX:

MOV 41H,75H

MOV 42H,75H

MOV 43H,75H

MOV 44H,75H

MOV 45H,75H

MOV 46H,75H

CALL SCANL

CALL IN_KEY

CJNE A,#1,EXIT_INTEN

INC 75H

MOV A,75H

SUBB A,#10H

JC NOT_INOVER

MOV 75H,#00

NOT_INOVER:

MOV R6,75H

MOV R7,#0AH

CALL SEND_AD

JMP INTENX

EXIT_INTEN:

RET

\$INCLUDE "SUBx.ASM"

END

TMDATA EQU P1.0

TMCLCK EQU P1.3

TMRSTT EQU P1.1

RTC_DATA EQU P1.0

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
RTC_CLK EQU P1.4
```

```
RTC_RST EQU P1.1
```

```
DATA EQU P1.0
```

```
LOAD EQU P1.1
```

```
CLOCK EQU P1.2
```

```
;SUB PROGRAM
```

```
;PROGRAM DELAY TIME
```

```
;USED REGISTER A
```

```
;SUB DELAY_SEC AND DELAY_MS
```

```
;PROGRAM BY RATCHATAPAK PATTWONG. KMITL
```

```
DELAY_MS:
```

```
    PUSH ACC
```

```
    PUSH B
```

```
    MOV B,#0
```

```
DD:
```

```
    CPL P3.7
```

```
    DJNZ B,$    ;500 uS AT 12 MHZ
```

```
    DJNZ B,$    ;500 uS AT 12 MHZ
```

```
    DJNZ ACC,DD
```

```
    POP B
```

```
    POP ACC
```

```
    RET
```

```
DELAY_SEC:
```

```
    PUSH ACC
```

```
    PUSH B
```

```
    MOV B,A
```

```
DDD:
```

```
    MOV A,#250
```

```
    CALL DELAY_MS ;250 mS
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL DELAY_MS ;500 mS
CALL DELAY_MS ;750 mS
CALL DELAY_MS ;1000 mS
DJNZ B,DDD
POP B
POP ACC
RET

; PROGRAM BY RATCHATAPAK KMITL ;

; PROGRAM INITMAX 7219 AND SUB PROGRAM ;
; AND SEND ADDRESS,DATA ;
; R6 IS DATA BYTE ;
; R7 IS ADDRESS BYTE ;
-----;
=====;
; USED REGISTER A,B,R6,R7,00 ;
; SAVE REGISTER A,B,R6,R7 ;
; NOT SAVE 00 ;
-----;
-----|
DATA = P1.0 |
; LOAD = P1.1 |
; CLOCK = P1.2 |
-----|

CODEB:
MOV R6,#0
CALL SHUT
MOV R7,#09H
MOV R6,#0FFH
CALL SEND_AD

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL CBUFFER_B
CALL SCANL
MOV R6,#1
CALL SHUT
RET
CODEH: MOV R6,#0
CALL SHUT
MOV R7,#09H
MOV R6,#00H
CALL SEND_AD
CALL CBUFFER_H
CALL SCANL
MOV R6,#1
CALL SHUT
RET
SHUT: MOV R7,#0CH
CALL SEND_AD
RET
INIT_7219:
MOV R7,#0CH ;SHUTDOWN ON
MOV R6,#01H ;1=ON 0=OFF
CALL SEND_AD

MOV R7,#09H ;DECODE MODE
MOV R6,#0FFH ;DECODE CODE_B FONT
CALL SEND_AD

MOV R7,#0BH ;SCAN LIMIT

```



```

MOV R6,#05H ;SCAN TOTEL 6 DEG 1,2,3,4,5,6
CALL SEND_AD

MOV R7,#0FH
MOV R6,#00H
CALL SEND_AD ;TEST MODE OFF

MOV R7,#0AH
MOV R6,75H ;INTENSITY MAX
CALL SEND_AD
RET

-----;
;SUB PROGRAM SEND ADDRESS AND DATA TO MAX7219;
-----;
SEND_AD:
CLR P1
PUSH 00H
MOV 00H,R7
PUSH ACC
PUSH B

-----;
SETB LOAD ;SET LOAD "1" ;
MOV B,#08 ;
SENAD1: MOV A,R7 ;
RLC A ;
MOV R7,A ;
MOV DATA,C ;SEND ADDRESS BYTE 8 BIT ;
CALL MAKE_CLK ;SHIFT ;
DJNZ B,SENAD1 ;
MOV R7,00H ;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

;-----;
MOV 00H,R6 ;SEND DATA BYTE 8 BIT ;
MOV B,#08H ;
SENAD2: MOV A,R6 ;
RLC A ;
MOV R6,A ;
MOV DATA,C ;
CALL MAKE_CLK ;
DJNZ B,SENAD2 ;

```

```

;-----;
CLR LOAD ;latch bits ;
SETB LOAD ;LATCH BIT ;
CLR LOAD ; ;
MOV R6,00H ; ;

```

```

;-----;
POP B ; ;
POP ACC ; ;
POP 00H ; ;
RET ; ;

```

```

;-----;
MAKE_CLK: ; ;
SETB CLOCK ;MAKE CLOCK PLUSE 01 ; ;
CLR CLOCK ; ;
RET ; ;

```

```

;-----;
;CONVERT THERMO CODE TO TEMPTURE

```

```

DTCON: MOV R3,A
JNB ACC.0,DTCON2
RET

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
DTCON2: MOV R7,#0
```

```
    CLR C
```

```
    MOV A,R4
```

```
    RRC A
```

```
    JNC DTCON3
```

```
    MOV R7,#1
```

```
DTCON3: MOV DPL,A
```

```
    MOV DPH,#0
```

```
    CALL HTOD
```

```
    MOV A,R7
```

```
    RET
```

```
; ***** HTOD SUB *****
```

```
; HEX TO DECIMAL
```

```
; IN = DPTR
```

```
; OUT = R1,R2,R3
```

```
; REG = A,R0,R1,R2,R3,R4,R5,DPTR
```

```
HTOD: CLR A ;CLEAR OUTPUT
```

```
    MOV R1,A
```

```
    MOV R2,A
```

```
    MOV R3,A
```

```
    MOV R4,#16 ;SHIFT 16 BIT
```

```
HTOD1: MOV A,DPL
```

```
    RLC A
```

```
    MOV DPL,A
```

```
    MOV A,DPH
```

```
    RLC A
```

```
    MOV DPH,A
```

```
    MOV R5,#3 ;ADD DECIMAL
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

MOV R0,#3      ;INDEX TO R3
HTOD2: MOV A,@R0
      ADDC A,ACC
      DA A
      MOV @R0,A
      DEC R0
      DJNZ R5,HTOD2
      DJNZ R4,HTOD1
      RET

```

```
RTC_WRITE_CH:
```

```

CLR RTC_CLK    ;low CLK line
CALL DELAY
SETB RTC_RST   ;high RST line
CALL DELAY
MOV A,R2       ;write COMMAND byte
CALL RTC_WRITE_8BIT
MOV A,R3       ;and DATA byte
CALL RTC_WRITE_8BIT
CLR RTC_RST    ;low RST line
CALL DELAY
RET

```

```
; Transfer 8-bits data to DS1202
```

```
; IN: A = data
```

```
RTC_WRITE_8BIT:
```

```
MOV R4,#08H    ;8 bits to transfer
```

```
WR8BIT1:
```

```

RRC A
MOV RTC_DATA,C

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

SETB  RTC_CLK    ;Rising edge clock
CALL  DELAY
CLR   RTC_CLK
CALL  DELAY
DJNZ  R4,WR8BIT1
RET
;
; Perform READ Command and read parameter byte from DS1202 RTC
; IN: R2 = COMMAND
; OUT: R3 = DATA
;
RTC_READ_CH:
    CLR  RTC_CLK    ;low clk line
    CALL DELAY
    SETB RTC_RST    ;high RST line
    CALL DELAY
    MOV  A,R2       ;write COMMAND byte
    CALL RTC_WRITE_8BIT
;
    MOV  R4,#8      ;then read DATA byte
    CLR  A
RD_CH1: CLR  RTC_CLK
    CALL DELAY
    MOV  C,RTC_DATA
    RRC  A
    SETB RTC_CLK
    CALL DELAY
    DJNZ R4,RD_CH1
    MOV  R3,A
;
    CLR  RTC_RST    ;low RST line
    CALL DELAY

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
RET
```

```
DELAY:
```

```
    NOP    ;delay
```

```
    RET
```

```
TIME_DISPLAY:
```

```
    MOV R2,#81H    ;read time from rtc
```

```
    CALL RTC_READ_CH    ;READ SECOUND
```

```
    MOV 32H,R3
```

```
    MOV R2,#83H
```

```
    CALL RTC_READ_CH    ;read minute
```

```
    MOV 31H,R3
```

```
    MOV R2,#85H    ;read sec
```

```
    CALL RTC_READ_CH
```

```
    MOV 30H,R3
```

```
    MOV A,30H
```

```
    RET
```

```
DATE_DISPLAY:
```

```
    MOV R2,#87H
```

```
    CALL RTC_READ_CH    ;DATE
```

```
    MOV 33H,R3
```

```
    MOV R2,#89H
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
CALL RTC_READ_CH ;MOUNTH
```

```
MOV 34H,R3
```

```
MOV R2,#8DH
```

```
CALL RTC_READ_CH ;YEAR
```

```
MOV 35H,R3
```

```
RET
```

```
***** DTWR,DTWR8,DTWR16 SUB *****
```

```
WRITE COMMAND,DATA TO DS1620
```

```
IN = R2 COMMAND
```

```
R3,R4 DATA
```

```
REG = A,R2,R3,R4,R5,R6
```

```
DTWR: CLR TMCLCK ;CLK=0
```

```
CALL DTDEL
```

```
SETB TMRSTT ;RST=1
```

```
CALL DTDEL
```

```
MOV A,R2 ;COMMAND
```

```
CALL DTWRS
```

```
CLR TMRSTT ;RST=0
```

```
CALL DTDEL
```

```
RET
```

```
DTWR8: CLR TMCLCK ;CLK=0
```

```
CALL DTDEL
```

```
SETB TMRSTT ;RST=1
```

```
CALL DTDEL
```

```
MOV A,R2 ;COMMAND
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL DTWRS
MOV A,R3      ;DATA
CALL DTWRS
CLR TMRSTT   ;RST=0
CALL DTDEL
CALL DTDELE
RET

```

```
DTWRS: MOV R5,#8      ;WRITE COMMAND/DATA
```

```
DTWRS1: RRC A
```

```
MOV TMDATA,C
```

```
NOP
```

```
SETB TMCLCK  ;RISING EDGE CLOCK
```

```
CALL DTDEL
```

```
CLR TMCLCK
```

```
CALL DTDEL
```

```
DJNZ R5,DTWRS1
```

```
RET
```

```
DTDEL: MOV R6,#4      ;DELAY
```

```
DJNZ R6,$
```

```
RET
```

```
DTDELE: MOV R5,#40H   ;END DELAY (FOR EEPROM)
```

```
DTDELE1: MOV R6,#0
```

```
DJNZ R6,$
```

```
DJNZ R5,DTDELE1
```

```
RET
```

```
;***** DTRD8,DTRD16 SUB *****
```

```
; WRITE COMMAND , READ DATA TO/FROM DS1620
```

```
; IN = R2  COMMAND
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
; OUT = R3,R4 DATA (9 BIT)
```

```
; REG = A,R2,R3,R4,R5,R6
```

```
DTRD8: CLR TMCLCK ;CLK=0
```

```
CALL DTDEL
```

```
SETB TMRSTT ;RST=1
```

```
CALL DTDEL
```

```
MOV A,R2 ;COMMAND
```

```
CALL DTWRS
```

```
CALL DTRDS
```

```
MOV R3,A
```

```
CLR TMRSTT ;RST=0
```

```
CALL DTDEL
```

```
RET
```

```
DTRD16: CLR TMCLCK ;CLK=0
```

```
CALL DTDEL
```

```
SETB TMRSTT ;RST=1
```

```
CALL DTDEL
```

```
MOV A,R2 ;COMMAND
```

```
CALL DTWRS
```

```
CALL DTRDS
```

```
MOV R4,A
```

```
CALL DTRDS
```

```
ANL A,#00000001B
```

```
MOV R3,A
```

```
CLR TMRSTT ;RST=0
```

```
CALL DTDEL
```

```
RET
```

```
DTRDS: MOV R5,#8 ;READ DATA SUB
```

```
CLR A
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
DTRDS1: CLR  TMCLCK
```

```
CALL DTDEL
```

```
MOV  C,TMDATA
```

```
RRC  A
```

```
SETB TMCLCK
```

```
CALL DTDEL
```

```
DJNZ R5,DTRDS1
```

```
RET
```

```
BUF_TO_DISBUFF:
```

```
;PROGRAM SET BIT MSB LSB TO DISPLAY BUFFER
```

```
;IN R0=HEX BUFFER
```

```
;R1 DIRECT BUFFER
```

```
PUSH 00
```

```
PUSH 01
```

```
PUSH ACC
```

```
PUSH B
```

```
MOV B,#6
```

```
FEC:  MOV A,@R0
```

```
PUSH ACC
```

```
SWAP A
```

```
ANL A,#0FH
```

```
MOV @R1,A
```

```
POP ACC
```

```
ANL A,#0FH
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

INC R1
MOV @R1,A
INC R0
INC R1
DJNZ B,FEC

```

```

POP B
POP ACC
POP 01H
POP 00H
RET

```

```

CBUFFER_B: ;clear buffer code bcd

```

```

PUSH 00
PUSH 01
MOV R0,#40H
MOV R1,#24

```

```

C1: MOV @R0,#0FH

```

```

INC R0
DJNZ R1,C1
POP 01
POP 00
RET

```

```

CBUFFER_H: ;clear buffer code hex

```

```

PUSH 00
PUSH 01
MOV R0,#40H
MOV R1,#24

```

```

CH1: MOV @R0,#00H

```

```

INC R0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

DJNZ R1,CH1
POP 01
POP 00
RET

```

```

;PROGRAM CLEAR DISPLAY SHIFT LEFT

```

```

CLEARL:

```

```

MOV B,#6
LXOL: MOV R0,#42H
MOV R1,#41H
MOV R3,#6
LXOL2: MOV A,@R0
CPL INT1
MOV @R1,A
INC R0
INC R1
DJNZ R3,LXOL2
CALL SCANL
MOV A,#01FH
CALL DELAY_MS
DJNZ B,LXOL
RET

```

```

;PROGRAM CLEAR DISPLAY SHIFT RIGHT

```

```

CLEARR:

```

```

MOV B,#6
LOR: MOV R0,#45H
MOV R1,#46H
MOV R3,#6
LOR2: MOV A,@R0

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CPL INT1
MOV @R1,A
DEC R0
DEC R1
DJNZ R3,LOR2
CALL SCANL
MOV A,#01FH
CALL DELAY_MS
DJNZ B,LOR
RET

```

;NUMBER OF SHIFT LEFT => R2

SCAN_SHL:

```

MOV R1,#47H
SX:  PUSH 01
MOV R0,#41H
MOV B,#6
S1:  MOV A,@R1
CPL INT1
MOV @R0,A
INC R0
INC R1
DJNZ B,S1
CALL SCANL
MOV A,#02FH
CALL DELAY_MS
POP 01
INC R1
DJNZ R2,SX
RET

```

TABLE:

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DB 7EH,30H,6DH,79H,33H,5BH,5FH,70H,7FH,7BH

READT:

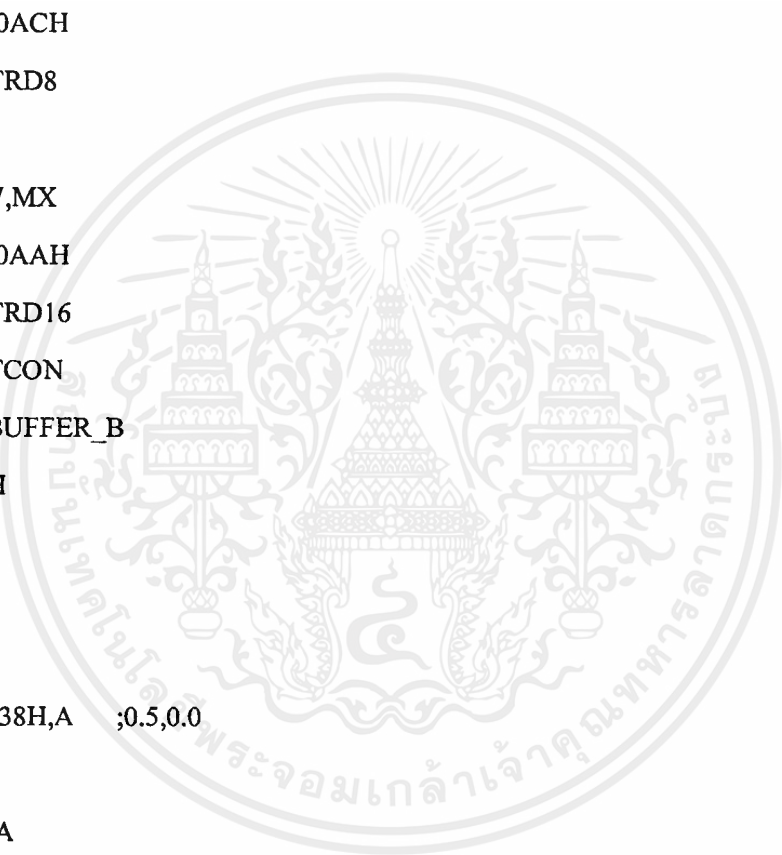
```
CLR TMRSTT
MOV R2,#0CH
MOV R3,#00000011B
MOV R2,#0EEH
LCALL DTWR
```

MX:

```
MOV R2,#0ACH
LCALL DTRD8
MOV A,R3
JNB ACC.7,MX
MOV R2,#0AAH
LCALL DTRD16
LCALL DTCON
LCALL CBUFFER_B
ORL A,00H
JZ ZEROX

MOV A,#5
ZEROX: MOV 38H,A ;0.5,0.0
```

```
MOV 50H,A
MOV A,R3
PUSH ACC
ANL A,#0FH
SETB ACC.7
MOV 37H,A ;LSB TEMP
MOV 4FH,A
POP ACC
SWAP A
ANL A,#0FH
```



```
MOV 36H,A ;MSB TEMP
```

```
MOV 4EH,A
```

```
MOV R2,#7
```

```
RET
```

```
TIME:
```

```
CALL TIME_DISPLAY
```

```
MOV R0,#30H ;read time from memory
```

```
MOV R1,#41H ;xx:xx:xx to x x x x x x
```

```
LCALL BUF_TO_DISBUFF
```

```
MOV A,#80H
```

```
ORL 42H,A
```

```
ORL 44H,A ;add point
```

```
CALL SCANL ;scan display at direct memory
```

```
RET
```

```
DATE:
```

```
CALL DATE_DISPLAY
```

```
MOV R0,#33H ;read DATE from memory
```

```
MOV R1,#41H ;xx:xx:xx to x x x x x x
```

```
LCALL BUF_TO_DISBUFF
```

```
MOV A,#80H
```

```
ORL 42H,A
```

```
ORL 44H,A ;add point
```

```
CALL SCANL ;scan display at direct memory
```

```
RET
```

```
SWA1:
```

```
MOV R0,3AH
```

```
MOV 3BH,@R0
```

```
MOV @R0,#0FH
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

INC R0
MOV 3EH,@R0
MOV @R0,#0FH
CALL SCANL
MOV A,#3FH
CALL DELAY_MS
CPL INT1
MOV @R0,3EH
DEC R0
MOV @R0,3BH
LCALL SCANL
MOV A,#3FH
CALL DELAY_MS

RET

SCANL: PUSH 00H ;SCAN DISPLAY FROM MEMORY 41 ==> 47
        PUSH B
        MOV B,#6
        MOV R7,#06H
        MOV R0,#41H

SCANLX:
        MOV 06H,@R0
        LCALL SEND_AD
        DEC R7
        INC R0
        DJNZ B,SCANLX
        POP B
        POP 00H
        RET

```

WTIME:

MOV R2,#8EH

MOV R3,#00H

CALL RTC_WRITE_CH

MOV R2,#80H

MOV R3,#00

CALL RTC_WRITE_CH

MOV R2,#82H

MOV R3,31H ;MIN

CALL RTC_WRITE_CH

MOV R2,#84H ;HOUR

MOV R3,30H

CALL RTC_WRITE_CH

MOV R2,#86H ;DATE

MOV R3,33H

CALL RTC_WRITE_CH

MOV R2,#88H ;MOUNTH

MOV R3,34H

CALL RTC_WRITE_CH

MOV R2,#8CH ;YEAR

MOV R3,35H

CALL RTC_WRITE_CH

MOV R2,#8EH

MOV R3,#80H

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

CALL RTC_WRITE_CH
RET

STD: CALL CBUFFER_B
MOV R1,#4DH
CALL BUF_TO_DISBUFF
MOV A,#80H
ORL 4EH,A
ORL 50H,A
MOV R2,#7
CALL SCAN_SHL
RET

SNOP:
MOV B,#0FFH
FGH: PUSH B
MOV A,33H
CJNE A,#5FH,CT
CALL DATE_DISPLAY
JMP CD
CT: CALL TIME_DISPLAY
CD: CALL TIME
MOV A,#1FH
CALL DELAY_MS
POP B
DJNZ B,FGH
MOV 40H,#0FH
CALL CLEARR
RET

```

```

IN_KEY:

```

```

MOV P3,#0FFH

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
MOV R5,#0CH
```

```
CHKWM:
```

```
MOV B,#0FFH
```

```
CHECK_WAIT:
```

```
MOV R7,#0FFH
```

```
CHKWX: DJNZ R7,KEY1
```

```
DJNZ B,CHECK_WAIT
```

```
DJNZ R5,CHKWM
```

```
MOV A,#0
```

```
JMP $
```

```
KEY1:
```

```
CPL P3.7 ;FOR INTERRUPT
```

```
MOV A,#1
```

```
JB P3.0,KEY2
```

```
JMP SETKEY1
```

```
KEY2:
```

```
MOV A,#2
```

```
JB P3.1,KEY3
```

```
JMP SETKEY2
```

```
KEY3:
```

```
MOV A,#3
```

```
JB P3.2,KEY4
```

```
JMP SETKEY3
```

```
KEY4:
```

```
MOV A,#4
```

```
JB P3.3,CHKWX
```

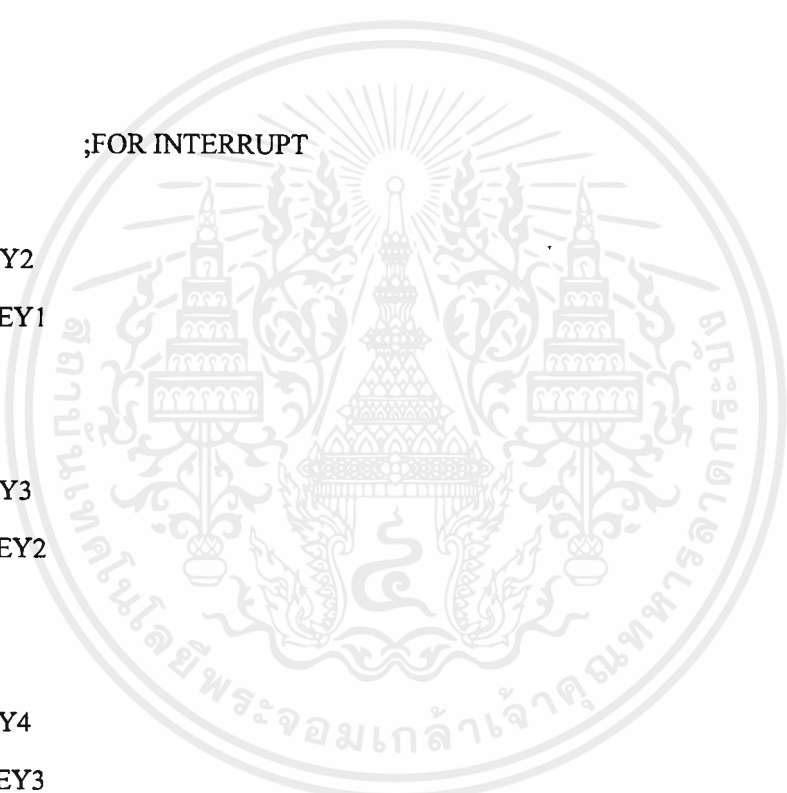
```
JMP SETKEY4
```

```
SETKEY1:
```

```
PUSH ACC
```

```
CPL P3.7
```

```
MOV A,#BUNCH
```



CALL DELAY_MS

POP ACC

JNB P3.0,SETKEY1

JMP EXIT_KEY

SETKEY2:

PUSH ACC

CPL P3.7

MOV A,#BUNCH

CALL DELAY_MS

POP ACC

JNB P3.1,SETKEY2

JMP EXIT_KEY

SETKEY3:

PUSH ACC

MOV A,#BUNCH

CALL DELAY_MS

POP ACC

CPL P3.7

JNB P3.2,SETKEY3

JMP EXIT_KEY

SETKEY4:

PUSH ACC

MOV A,#BUNCH

CALL DELAY_MS

POP ACC

CPL P3.7

JNB P3.3,SETKEY4

EXIT_KEY:

RET



บทที่ 3 วิธีการใช้งาน

หมายเลข	รายละเอียด	สี
1	SWITCH RESET	สีแดง
2	SWITCH D	สีเขียว
3	SWITCH C	สีขาว
4	SWITCH B	สีเขียว
5	SWITCH A	สีขาว
6	DIP SWITCH 4 ช่อง	
7	IC DS1620 (วัดอุณหภูมิ)	

เมื่อทำการเสียบปลั๊ก ระบบจะเริ่มทำงาน โดยแสดงเวลา อุณหภูมิ และวันที่ ตามลำดับ สามารถตั้ง ENABLE และ DISABLE ได้โดยทำการเลื่อน DIP SWITCH เมื่อเลื่อนไปที่ ON จะเป็นการ DISABLE การแสดงผล โดย หมายเลข 4 จะเป็นเวลา หมายเลข 3 จะเป็นอุณหภูมิ หมายเลข 2 จะเป็นวันที่

การตั้งเวลา

ทำได้โดยการกด SWITCH C ที่ 7-SEGMENT จะแสดงข้อความ SETUP จากนั้นจะรอรับ SWITCH A, B และ D โดย A จะทำการเพิ่มค่าเวลา ชั่วโมง และ B จะเป็นการเพิ่มค่านาที และ D จะเป็นการเซตเวลาและเข้าสู่การทำงานวนแสดงปกติ

การตั้งวันที่

ทำได้โดยการกด SWITCH C จะมีข้อความขึ้นว่า SET UP ที่ 7-SEGMENT จากนั้นให้กด A, B, C หรือ D โดยที่ SWITCH A ตั้งวันที่ B ตั้งเดือน และ C ตั้งปี ค.ศ. ส่วน D เป็นการเซต วัน เดือน ปี ที่แสดงบนหน้าจอ 7-SEGMENT จากนั้นจะมีข้อความที่ 7-SEGMENT ว่า SET เป็นการสิ้นสุดการตั้งวันที่

การตั้งเวลาในการแสดงผล

เมื่อกด SWITCH C จะมีข้อความคำว่า SET UP ที่ 7-SEGMENT จากนั้นจะให้กด SWITCH A, B, C, D เมื่อระดับการแสดงผล โดย A จะน้อยที่สุด และ D จะมากที่สุด เมื่อกดแล้วจะ

ทำการ เซตเวลาในการแสดงผล และจะมีข้อความว่า SET บนหน้าจอ เป็นการสิ้นสุดการตั้งระยะเวลาในการแสดงผลและเข้าสู่โหมดทำงานปกติ

การปรับความเข้ม

เมื่อกด SWITCH C จะมีข้อความบน 7-SEGMENT ว่า SET UP จากนั้นให้กด SWITCH A เพื่อปรับความเข้ม และ SWITCH B, C, D เพื่อ SET ความเข้มของ 7-SEGMENT จากนั้นเข้าสู่โหมดทำงานปกติ



บทที่ 4

บทสรุป อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

จากการทำโครงการชุดแสดงผลอุณหภูมิและเวลา มีอุปสรรคในการทำงานอยู่บ้างพอสมควร ซึ่งสามารถจะแก้ไขและปรับปรุงไปได้ด้วยดี ซึ่งปัญหาต่างๆ สามารถกล่าวได้ ดังต่อไปนี้

1. ปัญหาเนื่องจาก IC MAX7218CNG ซึ่งใช้ควบคุม 7-SEGMENT แบบ Multiplex มีการสแกนด้วยความถี่สูง ทำให้เกิดความถี่รบกวน CPU AT89C2051 ทำให้ข้อมูลที่ส่งไปผิดพลาด แก้ไขปัญหาโดยการให้ ขา C 10 UF 16 V อิเล็กโทรไลต์ คร่อมที่ขา VCC และ GND ของ MAX7219CNG จึงสามารถใช้งานได้
2. ปัญหาเนื่องจากการใช้สัญญาณ INTERRUPT 2 สัญญาณ จึงต้องมีการกำหนดลำดับความสำคัญของ INTO มากกว่า IC ทำให้เวลารอคอยการกดคีย์สวิตช์ ไม่มีสัญญาณส่งเข้าไปให้ขา WDI ของ MAX691 จึงต้องแทรกคำสั่ง CPL P3.7 เข้าที่ Function การรับค่าจาก Key Switch

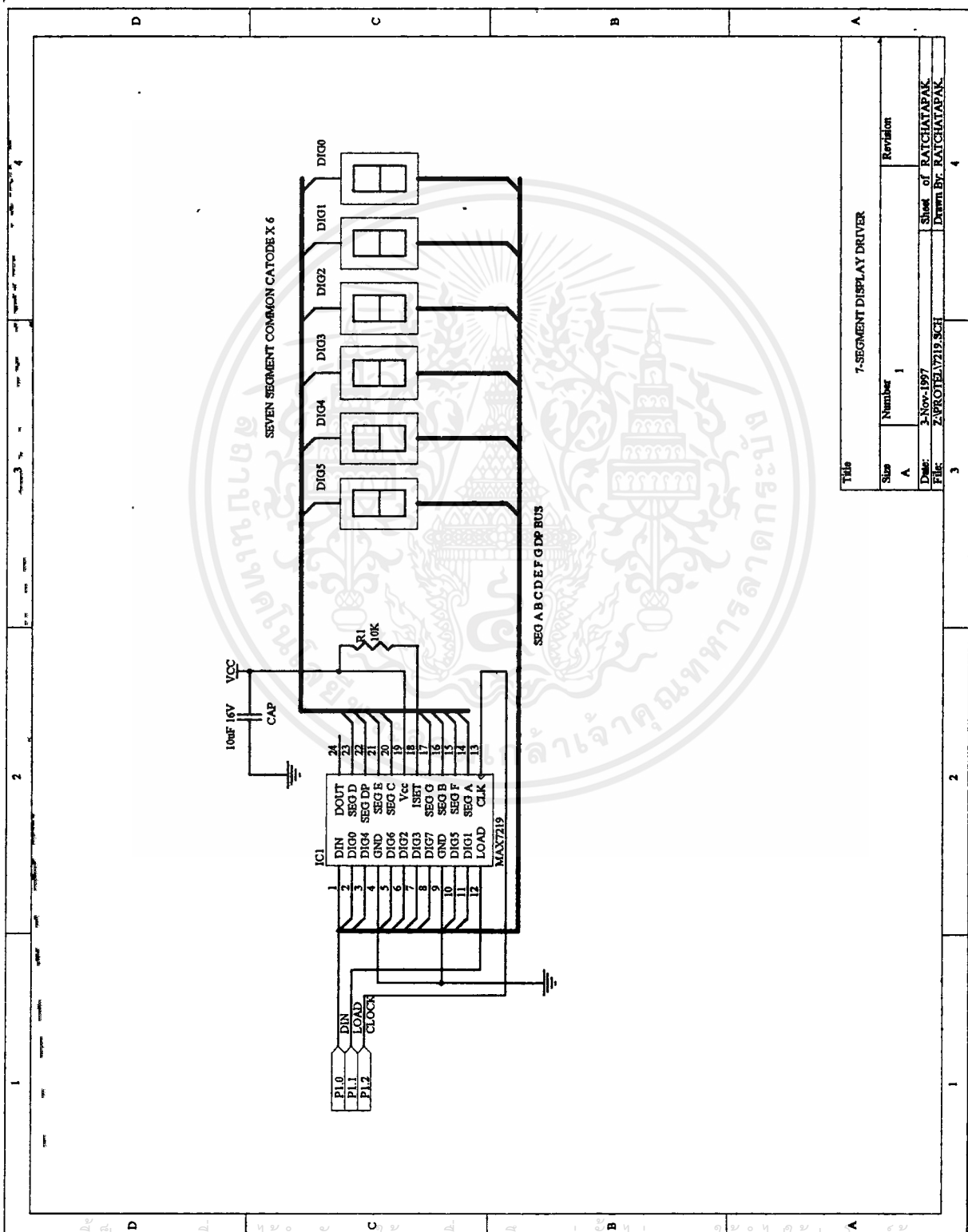
บทสรุป จากการทำโครงการ ชุดแสดงผลอุณหภูมิและเวลา จากการทำงานและทดลอง ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมและออกแบบการใช้งานไอซี ที่อ่าน เขียนข้อมูลแบบอนุกรมได้เป็นอย่างดี ส่วนอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้น ก็สามารถแก้ไขไปได้ด้วยดี ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากการทำโครงการ คือ ได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในทรัพยากรที่จำกัด เนื่องจากมีหน่วยความจำ ROM เพียง 2 k Bytes และการใช้งาน ไอซี ซึ่งอ่านเขียนแบบอนุกรม

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

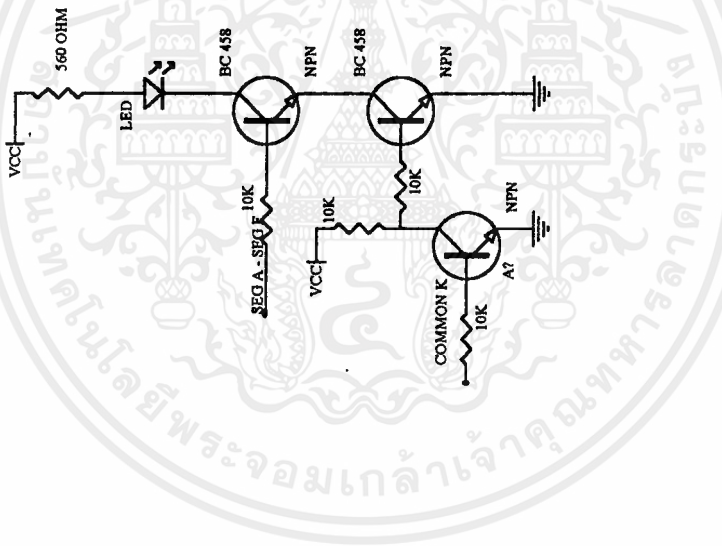


ภาคผนวก ก
รายละเอียดทางฮาร์ดแวร์

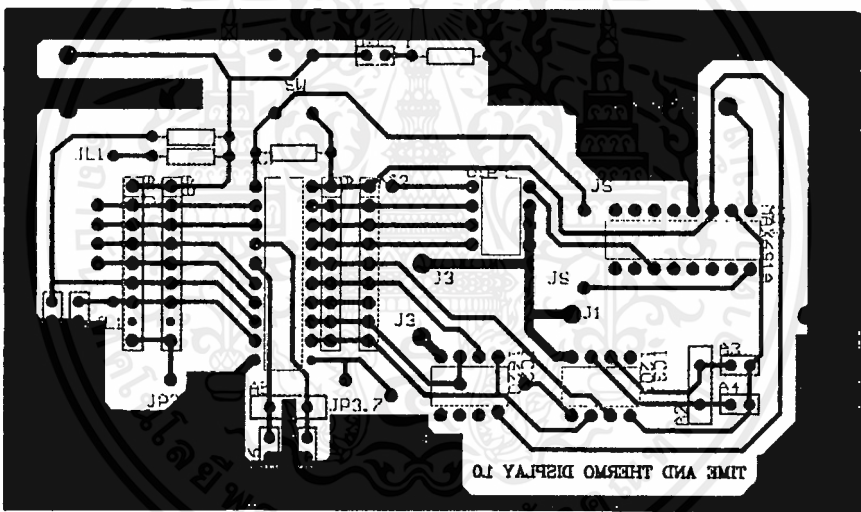
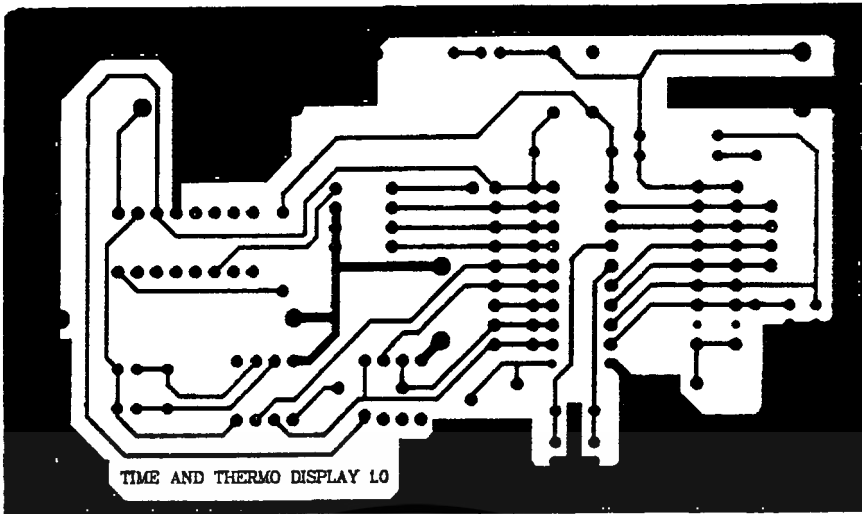
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



Title			7-SEGMENT DISPLAY DRIVER		
Size	Number	Revision			
A	1				
Date:	3-Nov-1997	Sheet of	RATCHATAPAK		
File:	Z-PROTBA/219.SCH	Drawn By:	RATCHATAPAK		
			3	4	

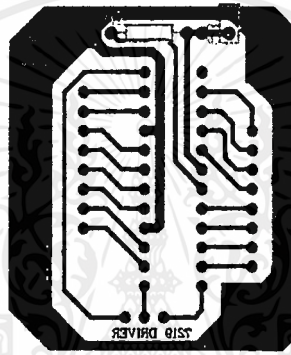
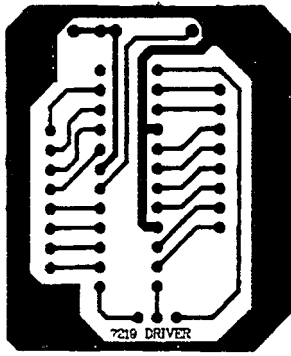


Title		Revision	
Size	Number		
A4			
Date:	3-Nov-1997	Sheet of	
File:	Z-PROTELED_DRV1.SCH	Drawn By:	
		4	



ภาพแสดงลายปริ้นท์ ของวงจร Time and Temperature Display

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพแสดงลายปริ้นท์ ของวงจรถูก 7219 Driver



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DALLAS

SEMICONDUCTOR

DS1202, DS1202S

Serial Timekeeping Chip

FEATURES

- Real time clock counts seconds, minutes, hours, date of the month, month, day of the week, and year with leap year compensation valid up to 2100
- 24 x 8 RAM for scratchpad data storage
- Serial I/O for minimum pin count
- 2.0–5.5 volt full operation
- Uses less than 300 nA at 2 volts
- Single-byte or multiple-byte (burst mode) data transfer for read or write of clock or RAM data
- 8-pin DIP or optional 16-pin SOIC for surface mount
- Simple 3-wire interface
- TTL-compatible ($V_{CC} = 5V$)
- Optional industrial temperature range $-40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$ (IND)

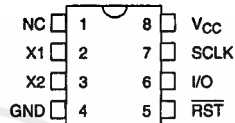
ORDERING INFORMATION

DS1202	8-pin DIP
DS1202S	16-pin SOIC
DS1202S-8	8-pin SOIC
DS1202N	8-pin DIP (IND)
DS1202SN	16-pin SOIC (IND)
DS1202SN-8	8-pin SOIC (IND)

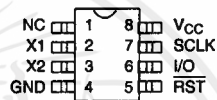
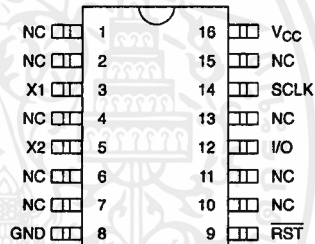
DESCRIPTION

The DS1202 Serial Timekeeping Chip contains a real time clock/calendar and 24 bytes of static RAM. It communicates with a microprocessor via a simple serial interface. The real time clock/calendar provides seconds, minutes, hours, day, date, month, and year information. The end of the month date is automatically adjusted for months with less than 31 days, including corrections for leap year. The clock operates in either the 24-hour or 12-hour format with an AM/PM indicator. Interfacing the

PIN ASSIGNMENT



8-PIN DIP

8-PIN SOIC
(208 mil)

16-PIN SOIC

PIN DESCRIPTION

NC	– No Connection
X1, X2	– 32.768 KHz Crystal Input
GND	– Ground
\overline{RST}	– Reset
I/O	– Data Input/Output
SCLK	– Serial Clock
V_{CC}	– Power Supply Pin

DS1202 with a microprocessor is simplified by using synchronous serial communication. Only three wires are required to communicate with the clock/RAM: (1) \overline{RST} (Reset), (2) I/O (Data line), and (3) SCLK (Serial clock). Data can be transferred to and from the clock/RAM one byte at a time or in a burst of up to 24 bytes. The DS1202 is designed to operate on very low power and retain data and clock information on less than 1 microwatt.

OPERATION

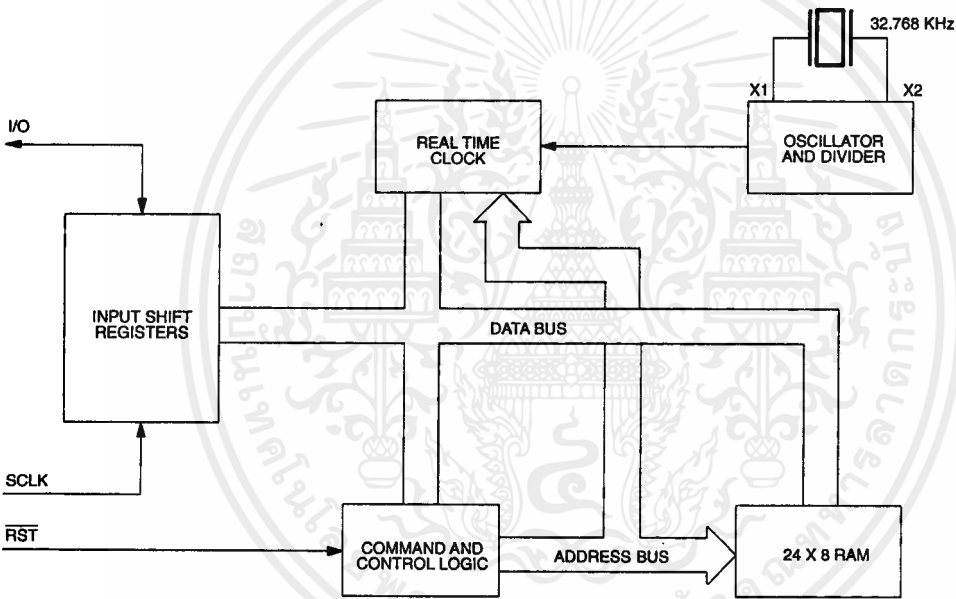
The main elements of the Serial Timekeeper are shown in Figure 1: shift register, control logic, oscillator, real time clock, and RAM. To initiate any transfer of data, \overline{RST} is taken high and eight bits are loaded into the shift register providing both address and command information. Data is serially input on the rising edge of the SCLK. The first eight bits specify which of 32 bytes will be accessed, whether a read or write cycle will take place, and whether a byte or burst mode transfer is to occur. After the first eight clock cycles have occurred which load the command word into the shift register, additional clocks will output data for a read or input data for a write.

The number of clock pulses equals eight plus eight for byte mode or eight plus up to 192 for burst mode.

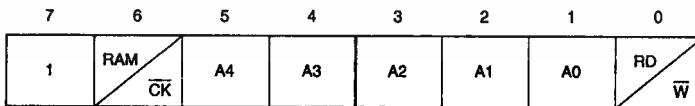
COMMAND BYTE

The command byte is shown in Figure 2. Each data transfer is initiated by a command byte. The MSB (Bit 7) must be a logic 1. If it is zero, further action will be terminated. Bit 6 specifies clock/calendar data if logic 0 or RAM data if logic 1. Bits one through five specify the designated registers to be input or output, and the LSB (Bit 0) specifies a write operation (input) if logic 0 or read operation (output) if logic 1. The command byte is always input starting with the LSB (bit 0).

DS1202 BLOCK DIAGRAM Figure 1



ADDRESS/COMMAND BYTE Figure 2



RESET AND CLOCK CONTROL

All data transfers are initiated by driving the $\overline{\text{RST}}$ input high. The $\overline{\text{RST}}$ input serves two functions. First, $\overline{\text{RST}}$ turns on the control logic which allows access to the shift register for the address/command sequence. Second, the $\overline{\text{RST}}$ signal provides a method of terminating either single byte or multiple byte data transfer. A clock cycle is a sequence of a falling edge followed by a rising edge. For data inputs, data must be valid during the rising edge of the clock and data bits are output on the falling edge of clock. All data transfer terminates if the $\overline{\text{RST}}$ input is low and the I/O pin goes to a high impedance state. Data transfer is illustrated in Figure 3.

DATA INPUT

Following the eight SCLK cycles that input a write command byte, a data byte is input on the rising edge of the next eight SCLK cycles. Additional SCLK cycles are ignored should they inadvertently occur. Data is input starting with bit 0. Due to the inherent nature of the logic state machine, writing times containing an absolute value of "59" seconds should be avoided.

DATA OUTPUT

Following the eight SCLK cycles that input a read command byte, a data byte is output on the falling edge of the next eight SCLK cycles. Note that the first data bit to be transmitted occurs on the first falling edge after the last bit of the command byte is written. Additional SCLK cycles retransmit the data bytes should they inadvertently occur so long as $\overline{\text{RST}}$ remains high. This operation permits continuous burst mode read capability. Data is output starting with bit 0.

BURST MODE

Burst mode may be specified for either the clock/calendar or the RAM registers by addressing location 31 decimal (address/command bits one through five = logical one). As before, bit six specified clock or RAM and bit 0 specifies read or write. There is no data storage capacity at locations 8 through 31 in the Clock/Calendar Registers or locations 24 through 31 in the RAM registers. When writing to the clock registers in the burst mode, the first eight registers must be written in order for the data to be transferred.

However, when writing to RAM in burst mode it is not necessary to write all 24 bytes for the data to transfer.

Each byte that is written will be transferred to RAM regardless of whether all 24 bytes are written or not.

CLOCK/CALENDAR

The clock/calendar is contained in eight write/read registers as shown in Figure 4. Data contained in the clock/calendar registers is in binary coded decimal format (BCD).

CLOCK HALT FLAG

Bit 7 of the seconds register is defined as the clock halt flag. When this bit is set to logic 1, the clock oscillator is stopped and the DS1202 is placed into a low-power standby mode with a current drain of not more than 100 nanoamps. When this bit is written to logic 0, the clock will start.

AM-PM/12-24 MODE

Bit 7 of the hours register is defined as the 12- or 24-hour mode select bit. When high, the 12-hour mode is selected. In the 12-hour mode, bit 5 is the AM/PM bit with logic high being PM. In the 24-hour mode, bit 5 is the second 10 hour bit (20-23 hours).

WRITE PROTECT BIT

Bit 7 of the control register is the write protect bit. The first seven bits (bits 0-6) are forced to zero and will always read a zero when read. Before any write operation to the clock or RAM, bit 7 must be zero. When high, the write protect bit prevents a write operation to any other register.

CLOCK/CALENDAR BURST MODE

The clock/calendar command byte specifies burst mode operation. In this mode the eight clock/calendar registers can be consecutively read or written (see Figure 4) starting with bit 0 of address 0.

RAM

The static RAM is 24 x 8 bytes addressed consecutively in the RAM address space.

RAM BURST MODE

The RAM command byte specifies burst mode operation. In this mode, the 24 RAM registers can be consecutively read or written (see Figure 4) starting with bit 0 of address 0.

REGISTER SUMMARY

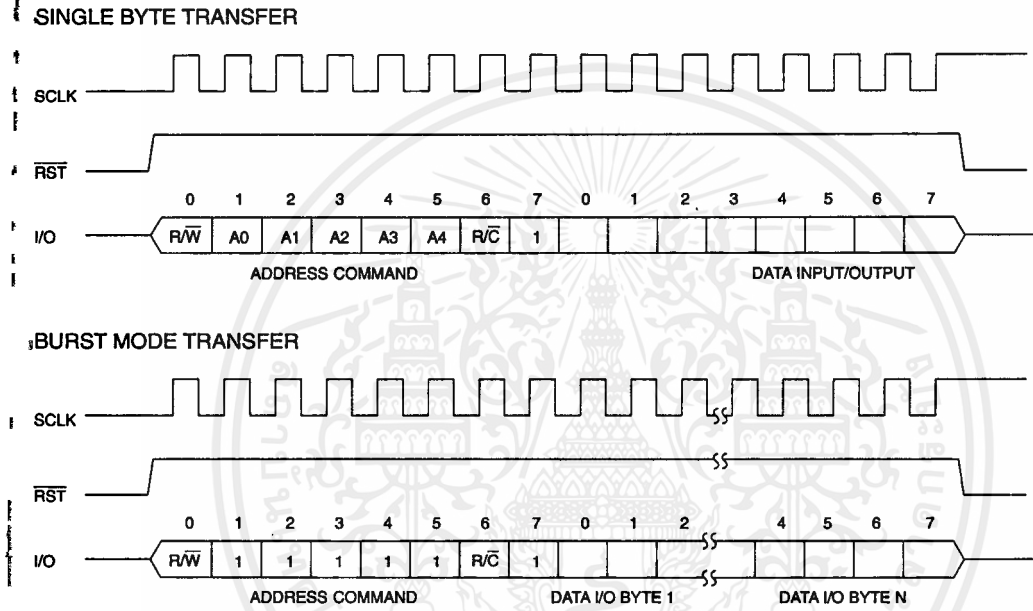
A register data format summary is shown in Figure 4.

CRYSTAL SELECTION

A 32.768 KHz crystal, can be directly connected to the DS1202 via pins 2 and 3 (X1, X2). The crystal selected for use should have a specified load capacitance (CL) of 6 pF. The crystal is connected directly to the X1 and X2

pins. There is no need for external capacitors or resistors. Note: X1 and X2 are very high impedance nodes. It is recommended that they and the crystal be guarded with ground and that high frequency signals be kept away from the crystal area. For more information on crystal selection and crystal layout considerations, please consult Application Note 58, "Crystal Considerations with Dallas Real Time Clocks".

DATA TRANSFER SUMMARY Figure 3

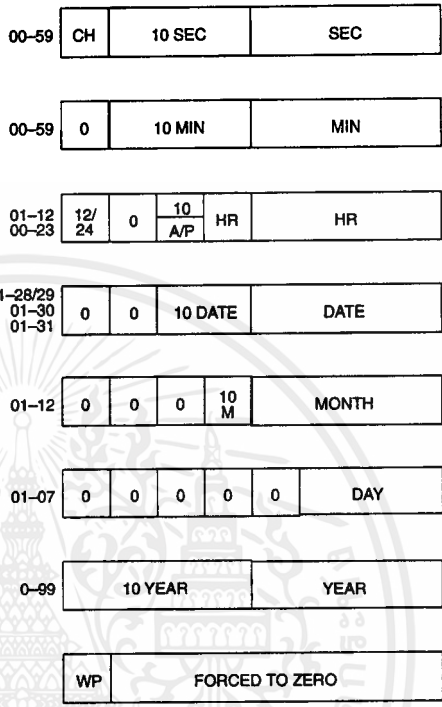
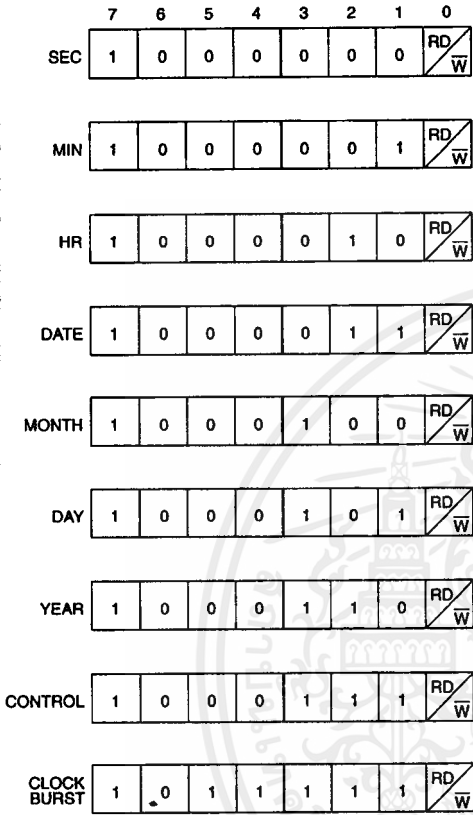


FUNCTION	BYTE N	SCLK n
CLOCK	8	72
RAM	24	200

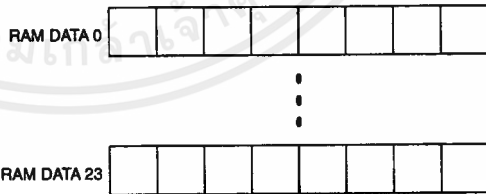
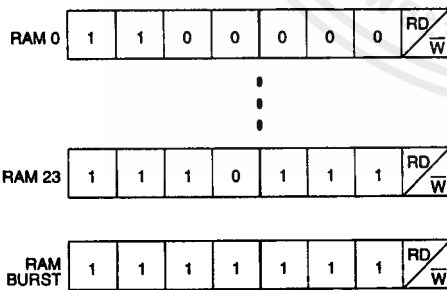
REGISTER ADDRESS/DEFINITION Figure 4

**REGISTER ADDRESS
A. CLOCK**

REGISTER DEFINITION



B. RAM



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS*

Voltage on Any Pin Relative to Ground
 Operating Temperature
 Storage Temperature
 Soldering Temperature

-0.3V to +7.0V
 0°C to 70°C
 -55°C to +125°C
 260°C for 10 seconds

* This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operation sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods of time may affect reliability.

RECOMMENDED DC OPERATING CONDITIONS

(0°C to 70°C)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Supply Voltage	V_{CC}	2.0		5.5	V	1
Logic 1 Input	V_{IH}	2.0		$V_{CC}+0.3$	V	1
Logic 0 Input	V_{IL}	$V_{CC}=2.0V$	-0.3	+0.3	V	1
		$V_{CC}=5V$	-0.3	+0.8		

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS(0°C to 70°C; $V_{CC} = 2.0$ to 5.5V*)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Input Leakage	I_{LI}			+500	μA	6
I/O Leakage	I_{LO}			+500	μA	6
Logic 1 Output	V_{OH}	$V_{CC}=2V$	1.6		V	2
		$V_{CC}=5V$	2.4			
Logic 0 Output	V_{OL}	$V_{CC}=2V$		0.4	V	3
		$V_{CC}=5V$		0.4		
Active Supply Current	I_{CC}	$V_{CC}=2V$		0.4	mA	5
		$V_{CC}=5V$		1.2		
Timekeeping Current	I_{CC1}	$V_{CC}=2V$		0.3	μA	4
		$V_{CC}=5V$		1		
Leakage Current	I_{CC2}	$V_{CC}=2V$		100	nA	10
		$V_{CC}=5V$		100		

*Unless otherwise noted.

CAPACITANCE $(t_A = 25^\circ C)$

PARAMETER	SYMBOL	CONDITION	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Input Capacitance	C_I		5		pF	
I/O Capacitance	$C_{I/O}$		10		pF	
Crystal Capacitance	C_X		6		pF	

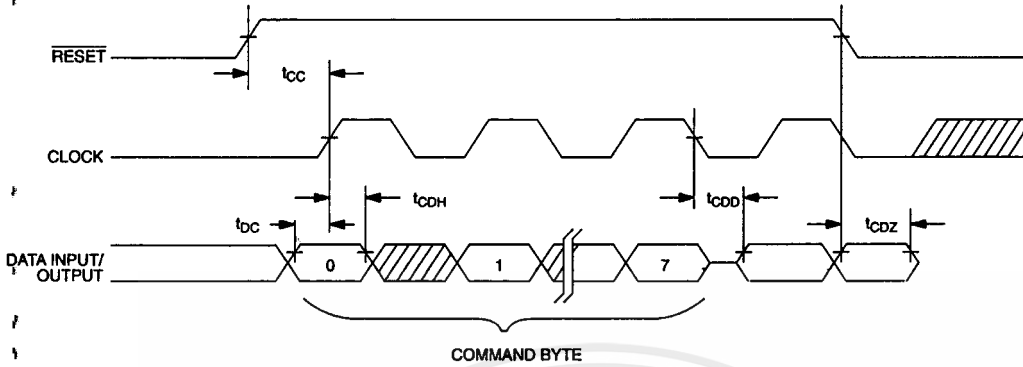
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS(0°C to 70°C; $V_{CC} = 2.0$ to $5.5V^*$)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Data to CLK Setup	t_{DC}	$V_{CC}=2V$	200			ns 7
		$V_{CC}=5V$	50			
CLK to Data Hold	t_{CDH}	$V_{CC}=2V$	280			ns 7
		$V_{CC}=5V$	70			
CLK to Data Delay	t_{CDD}	$V_{CC}=2V$		800	ns	7, 8, 9
		$V_{CC}=5V$		200		
CLK Low Time	t_{CL}	$V_{CC}=2V$	1000		ns	7
		$V_{CC}=5V$	250			
CLK High Time	t_{CH}	$V_{CC}=2V$	1000		ns	7, 12
		$V_{CC}=5V$	250			
CLK Frequency	f_{CLK}	$V_{CC}=2V$		0.5	MHz	7, 12
		$V_{CC}=5V$	DC	2.0		
CLK Rise and Fall	t_R, t_F	$V_{CC}=2V$		2000	ns	
		$V_{CC}=5V$		500		
\overline{RST} to CLK Setup	t_{CC}	$V_{CC}=2V$	4		μs	7
		$V_{CC}=5V$	1			
CLK to \overline{RST} Hold	t_{CCH}	$V_{CC}=2V$	1000		ns	7
		$V_{CC}=5V$	250			
\overline{RST} Inactive Time	t_{CWH}	$V_{CC}=2V$	4		μs	7
		$V_{CC}=5V$	1			
\overline{RST} to I/O High Z	t_{CDZ}	$V_{CC}=2V$		280	ns	7
		$V_{CC}=5V$		70		

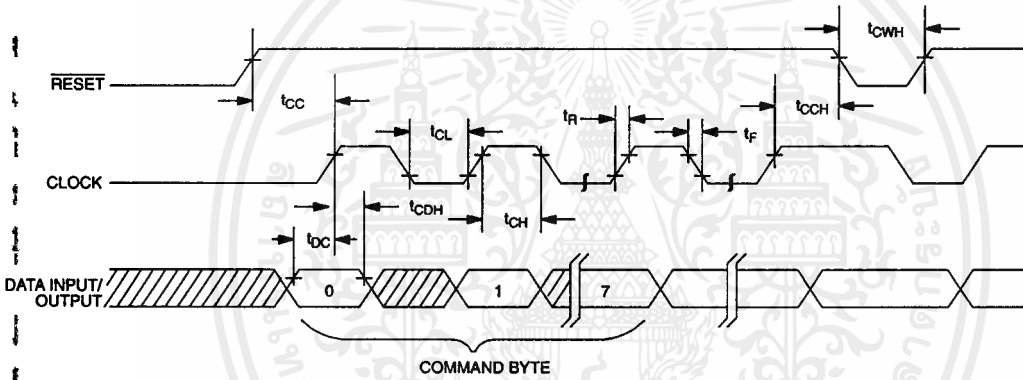
*Unless otherwise noted.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

TIMING DIAGRAM: READ DATA TRANSFER Figure 5



TIMING DIAGRAM: WRITE DATA TRANSFER Figure 6

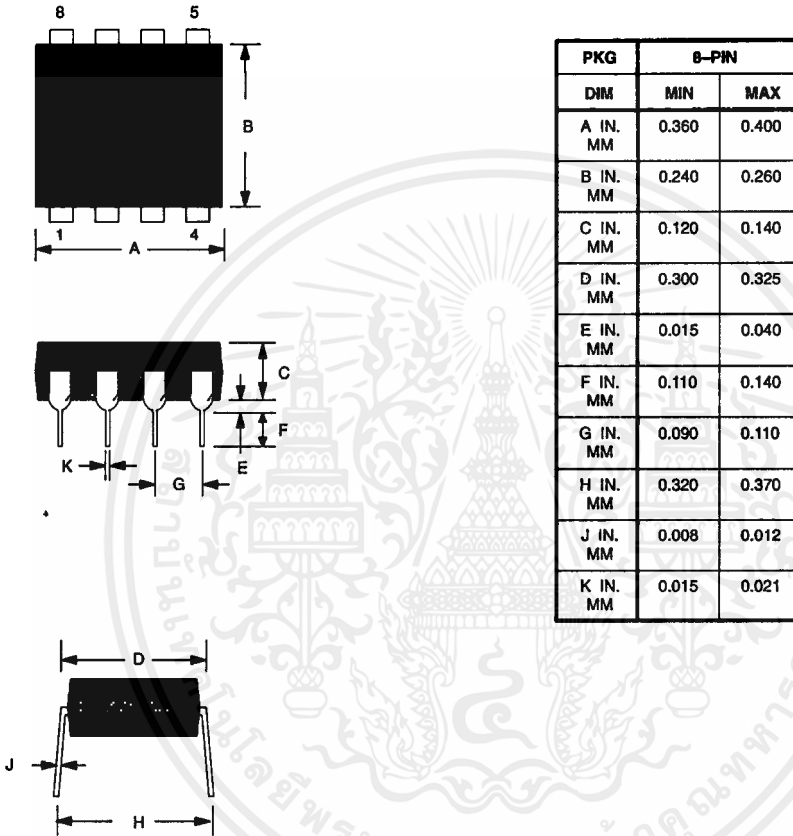


NOTES:

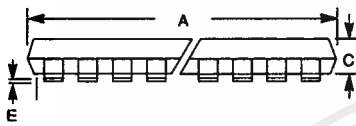
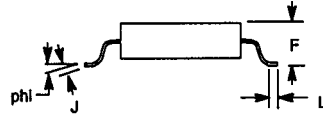
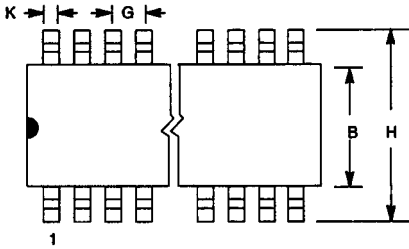
1. All voltages are referenced to ground.
2. Logic one voltages are specified at a source current of 1 mA at $V_{CC}=5V$ and 0.4 mA at $V_{CC}=2V$, $V_{OH}=V_{CC}$ for capacitive loads.
3. Logic zero voltages are specified at a sink current of 4 mA at $V_{CC}=5V$ and 1.5 mA at $V_{CC}=2V$.
4. t_{CC1} is specified with I/O open, \overline{RST} set to a logic 0, and clock halt flag=0 (oscillator enabled).
5. t_{CC} is specified with the I/O pin open, \overline{RST} high, SCLK=2 MHz at $V_{CC}=5V$; SCLK=500 KHz, $V_{CC}=2V$ and clock halt flag=0 (oscillator enabled).
6. \overline{RST} , SCLK, and I/O all have 40k Ω pull-down resistors to ground.
7. Measured at $V_{IH}=2.0V$ or $V_{IL}=0.8V$ and 10 ms maximum rise and fall time.
8. Measured at $V_{OH}=2.4V$ or $V_{OL}=0.4V$.
9. Load capacitance = 50 pF.

10. I_{CC2} is specified with \overline{RST} , I/O, and SCLK open: The clock halt flag must be set to logic one (oscillator disabled).
11. At power-up, \overline{RST} must be at a logic 0 until $V_{CC} \geq 2$ volts. Also, SCLK must be at a logic 0 when \overline{RST} is driven to a logic one state.
12. If t_{CH} exceeds 100 ms with \overline{RST} in a logic one state, then I_{CC} may briefly exceed I_{CC} specification.

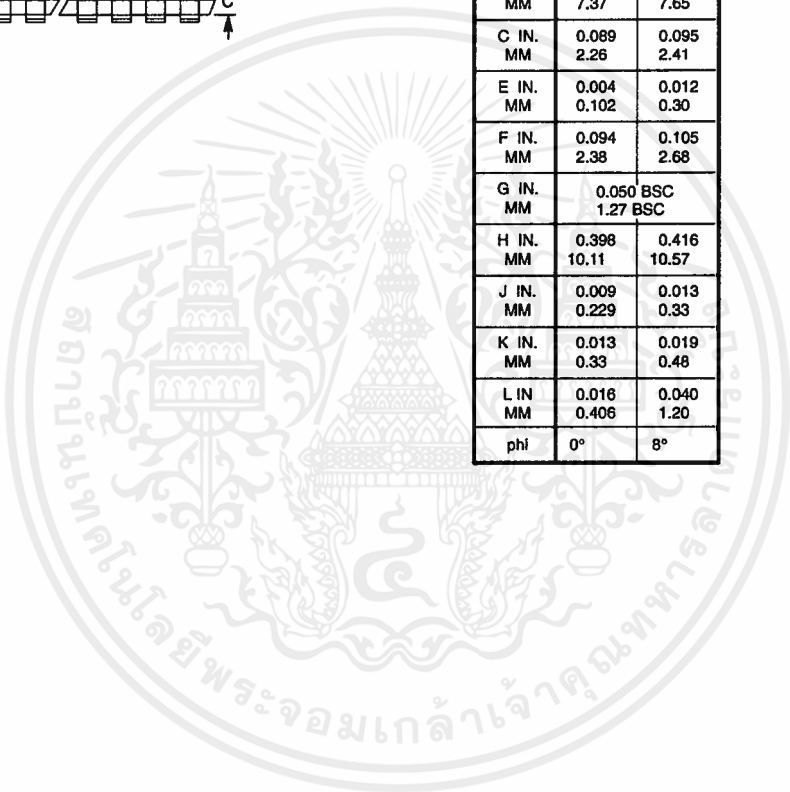
DS1202 SERIAL TIMEKEEPER 8-PIN DIP



DS1202S SERIAL TIMEKEEPER 16-PIN SOIC

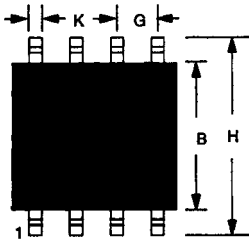


PKG	16-PIN	
DIM	MIN	MAX
A IN. MM	0.500 12.70	0.511 12.99
B IN. MM	0.290 7.37	0.300 7.65
C IN. MM	0.089 2.26	0.095 2.41
E IN. MM	0.004 0.102	0.012 0.30
F IN. MM	0.094 2.38	0.105 2.68
G IN. MM	0.050 BSC 1.27 BSC	
H IN. MM	0.398 10.11	0.416 10.57
J IN. MM	0.009 0.229	0.013 0.33
K IN. MM	0.013 0.33	0.019 0.48
L IN. MM	0.016 0.406	0.040 1.20
phi	0°	8°



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DS1202S8 8-PIN SOIC 200 MIL



PKG	8-PIN	
	MIN	MAX
A IN.	0.203	0.213
MM	5.16	5.41
B IN.	0.203	0.213
MM	5.16	5.41
C IN.	0.070	0.074
MM	1.78	1.88
E IN.	0.004	0.010
MM	0.102	0.390
F IN.	0.074	0.84
MM	1.88	2.13
G IN.	0.050 BSC	
MM	1.27 BSC	
H IN.	0.302	0.318
MM	7.67	8.07
J IN.	0.006	0.010
MM	0.152	0.254
K IN.	0.013	0.020
MM	0.33	0.508
L IN.	0.19	0.030
MM	4.83	0.762



Microprocessor Supervisory Circuits

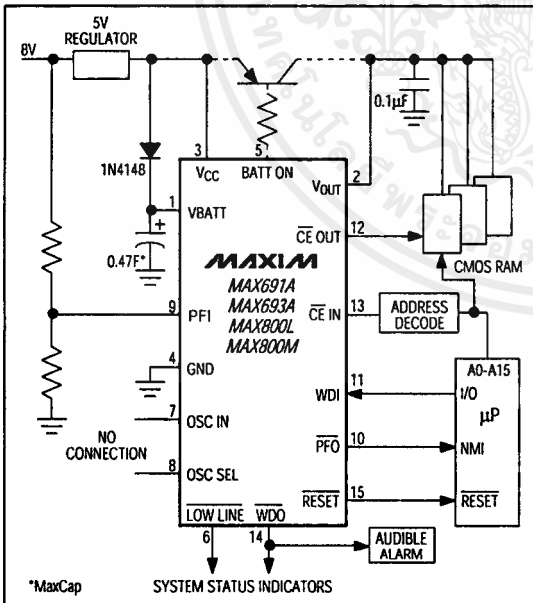
General Description

The MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M microprocessor (μ P) supervisory circuits are pin-compatible upgrades to the MAX691, MAX693, and MAX695. They improve performance with 30 μ A supply current, 200ms typ reset active delay on power-up, and 6ns chip-enable propagation delay. Features include write protection of CMOS RAM or EEPROM, separate watchdog outputs, backup-battery switchover, and a $\overline{\text{RESET}}$ output that is valid with V_{CC} down to 1V. The MAX691A/MAX800L have a 4.65V typical reset-threshold voltage, and the MAX693A/MAX800M's reset threshold is 4.4V typical. The MAX800L/MAX800M guarantee power-fail accuracies to $\pm 2\%$.

Applications

- Computers
- Controllers
- Intelligent Instruments
- Automotive Systems
- Critical μ P Power Monitoring

Typical Operating Circuit



*MaxCap

SYSTEM STATUS INDICATORS

TM SuperCap is a registered trademark of Baknor Industries. TM MaxCap is a registered trademark of The Carborundum Corp.



Maxim Integrated Products 1

Call toll free 1-800-998-8800 for free samples or literature.

Features

- ◆ 200ms Power-OK/Reset Timeout Period
- ◆ 1 μ A Standby Current, 30 μ A Operating Current
- ◆ On-Board Gating of Chip-Enable Signals, 10ns Max Delay
- ◆ MaxCapTM or SuperCapTM Compatible
- ◆ Guaranteed $\overline{\text{RESET}}$ Assertion to $V_{CC} = 1V$
- ◆ Voltage Monitor for Power-Fail or Low-Battery Warning
- ◆ Power-Fail Accuracy Guaranteed to $\pm 2\%$ (MAX800L/M)
- ◆ Available in 16-Pin Narrow SO and Plastic DIP Packages

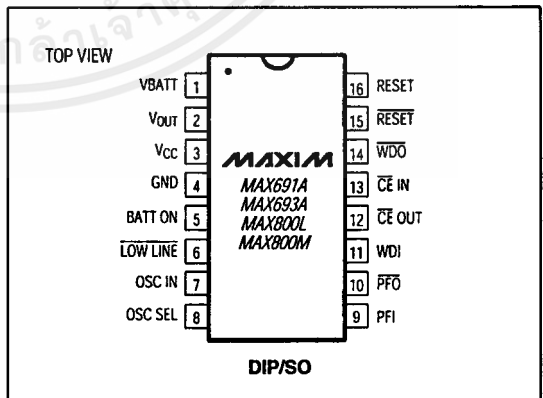
Ordering Information

PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE
MAX691ACPE	0°C to +70°C	16 Plastic DIP
MAX691ACSE	0°C to +70°C	16 Narrow SO
MAX691ACWE	0°C to +70°C	16 Wide SO
MAX691AC/D	0°C to +70°C	Dice*
MAX691AEPE	-40°C to +85°C	16 Plastic SO
MAX691AESE	-40°C to +85°C	16 Narrow SO
MAX691AEWE	-40°C to +85°C	16 Wide SO
MAX691AEJE	-40°C to +85°C	16 CERDIP
MAX691AMJE	-55°C to +125°C	16 CERDIP

Ordering Information continued on last page.

* Dice are specified at $T_A = +25^\circ\text{C}$.

Pin Configuration



MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Microprocessor Supervisory Circuits

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Terminal Voltage (with respect to GND)

V _{CC}	-0.3V to +6V
VBATT	-0.3V to +6V
All Other Inputs	-0.3V to (V _{OUT} + 0.3V)
Input Current	
V _{CC} Peak	1.0A
V _{CC} Continuous	250mA
VBATT Peak	250mA
VBATT Continuous	25mA
GND, BATT ON	100mA
All Other Outputs	25mA

Continuous Power Dissipation (T_A = +70°C)

Plastic DIP (derate 10.53mW/°C above +70°C)	842mW
Narrow SO (derate 8.70mW/°C above +70°C)	696mW
Wide SO (derate 9.52mW/°C above +70°C)	762mW
CERDIP (derate 10.00mW/°C above +70°C)	800mW

Operating Temperature Ranges

MAX69_AC_/MAX800_C_	0°C to +70°C
MAX69_AE_/MAX800_E_	-40°C to +85°C
MAX69_AMJE	-55°C to +125°C
Storage Temperature Range	-65°C to +160°C
Lead Temperature (soldering, 10sec)	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(MAX691A, MAX800L: V_{CC} = 4.75V to 5.5V, MAX693A, MAX800M: V_{CC} = 4.5V to 5.5V, VBATT = 2.8V, T_A = T_{MIN} to T_{MAX}, unless otherwise noted.)

PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
Operating Voltage Range, V _{CC} , VBATT (Note 1)			0		5.5	V
V _{OUT} Output	V _{CC} = 4.5V	I _{OUT} = 25mA	V _{CC} - 0.05	V _{CC} - 0.02		V
		I _{OUT} = 250mA	MAX69_AC/AE, MAX800_C/E	V _{CC} - 0.3	V _{CC} - 0.2	
			MAX69_AM	V _{CC} - 0.40		
V _{CC} -to-V _{OUT} On-Resistance	V _{CC} = 4.5V	MAX69_AC/AE, MAX800_C/E		0.8	1.2	Ω
		MAX69_AM		0.8	1.6	
V _{OUT} in Battery-Backup Mode	VBATT = 4.5V, I _{OUT} = 20mA				VBATT - 0.3	V
	VBATT = 2.8V, I _{OUT} = 10mA				VBATT - 0.25	
	VBATT = 2.0V, I _{OUT} = 5mA				VBATT - 0.15	
VBATT-to-V _{OUT} On-Resistance	VBATT = 4.5V				15	Ω
	VBATT = 2.8V				25	
	VBATT = 2.0V				30	
Supply Current in Normal Operating Mode (Excludes I _{OUT})	V _{CC} > VBATT - 1V			30	100	μA
Supply Current in Battery-Backup Mode (Excludes I _{OUT}) (Note 2)	V _{CC} < VBATT - 1.2V VBATT = 2.8V	T _A = +25°C		0.04	1	μA
		T _A = T _{MIN} + T _{MIN}			5	
VBATT Standby Current (Note 3)	VBATT + 0.2V ≤ V _{CC}	T _A = +25°C	-0.1		0.02	μA
		T _A = T _{MIN} + T _{MIN}	-1.0		0.02	
Battery Switchover Threshold	Power-up			VBATT + 0.3		V
	Power-down			VBATT - 0.3		
Battery Switchover Hysteresis				60		mV
BATT ON Output Low Voltage	I _{SINK} = 3.2mA			0.1	0.4	V
	I _{SINK} = 25mA			0.7	1.5	
BATT ON Output Short-Circuit Current	Sink current			60		mA
	Source current		1	15	100	μA

Microprocessor Supervisory Circuits

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

(MAX691A, MAX800L: $V_{CC} = 4.75V$ to $5.5V$, MAX693A, MAX800M: $V_{CC} = 4.5V$ to $5.5V$, $V_{BATT} = 2.8V$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted.)

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
RESET AND WATCHDOG TIMER					
Reset Threshold Voltage	MAX691A, MAX800L	4.50	4.65	4.75	V
	MAX693A, MAX800M	4.25	4.40	4.50	
	MAX800L, $T_A = +25^\circ C$, V_{CC} falling	4.55		4.70	
	MAX800M, $T_A = +25^\circ C$, V_{CC} falling	4.30		4.45	
Reset Threshold Hysteresis			15		mV
V_{CC} to RESET Delay	Power-down		80		μs
LOWLINE-to-RESET Delay			800		ns
Reset Active Timeout Period, Internal Oscillator	Power-up	140	200	280	ms
Reset Active Timeout Period, External Clock (Note 4)	Power-up		2048		Clock Cycles
Watchdog Timeout Period, Internal Oscillator	Long period	1.0	1.6	2.25	sec
	Short Period	70	100	140	ms
Watchdog Timeout Period, External Clock (Note 4)	Long Period		4096		Clock Cycles
	Short Period		1024		
Minimum Watchdog Input Pulse Width	$V_{IL} = 0.8V$, $V_{IH} = 0.75 \times V_{CC}$	100			ns
RESET Output Voltage	$I_{SINK} = 50\mu A$, $V_{CC} = 1V$, $V_{BATT} = 0V$, V_{CC} falling		0.004	0.3	V
	$I_{SINK} = 3.2mA$, $V_{CC} = 4.25V$		0.1	0.4	
	$I_{SOURCE} = 1.6mA$, $V_{CC} = 5V$	3.5			
RESET Output Short-Circuit Current	Output source current		7	20	mA
RESET Output Voltage Low (Note 5)	$I_{SINK} = 3.2mA$	0.1	0.4		V
LOW LINE Output Voltage	$I_{SINK} = 3.2mA$, $V_{CC} = 4.25V$			0.4	V
	$I_{SOURCE} = 1\mu A$, $V_{CC} = 5V$	3.5			
LOW LINE Output Short-Circuit Current	Output source current	1	15	100	μA
WDO Output Voltage	$I_{SINK} = 3.2mA$			0.4	V
	$I_{SOURCE} = 500\mu A$, $V_{CC} = 5V$	3.5			
WDO Output Short-Circuit Current	Output source current		3	10	mA
WDI Threshold Voltage (Note 6)	V_{IH}	$0.75 \times V_{CC}$			V
	V_{IL}			0.8	
WDI Input Current	$WDI = 0V$	-50	-10		μA
	$WDI = V_{OUT}$		20	50	

MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M

Microprocessor Supervisory Circuits

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

(MAX691A, MAX800L: $V_{CC} = 4.75V$ to $5.5V$, MAX693A, MAX800M: $V_{CC} = 4.5V$ to $5.5V$, $V_{BATT} = 2.8V$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted.)

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
POWER-FAIL COMPARATOR					
PFI Input Threshold	MAX69_AC/AE/AM, $V_{CC} = 5V$	1.2	1.25	1.3	V
	MAX800_C/E, $V_{CC} = 5V$	1.225	1.25	1.275	
PFI Leakage Current			± 0.01	± 25	nA
PFO Output Voltage	$I_{SINK} = 3.2mA$			0.4	V
	$I_{SOURCE} = 1\mu A$, $V_{CC} = 5V$	3.5			
PFO Output Short-Circuit Current	Output source current	1	15	100	μA
PFI-to-PFO Delay	$V_{IN} = -20mV$, $V_{OD} = 15mV$		25		μs
	$V_{IN} = 20mV$, $V_{OD} = 15mV$		60		
CHIP-ENABLE GATING					
CE IN Leakage Current	Disable mode		± 0.005	± 1	μA
CE IN-to-CE OUT Resistance (Note 7)	Enable mode		75	150	Ω
CE OUT Short-Circuit Current (Reset Active)	Disable mode, $\overline{CE} OUT = 0V$	0.1	0.75	2.0	mA
CE IN-to-CE OUT Propagation Delay (Note 8)	50Ω source impedance driver, $C_{LOAD} = 50pF$		6	10	ns
CE OUT Output Voltage High (Reset Active)	$V_{CC} = 5V$, $I_{OUT} = -100\mu A$	3.5			V
	$V_{CC} = 0V$, $V_{BATT} = 2.8V$, $I_{OUT} = 1\mu A$	2.7			
RESET-to-CE OUT Delay	Power-down		12		μs
INTERNAL OSCILLATOR					
OSC IN Leakage Current	OSC SEL = 0V		0.10	± 5	μA
OSC IN Input Pull-Up Current	OSC SEL = V_{OUT} or floating, OSC IN = 0V		10	100	μA
OSC SEL Input Pull-Up Current	OSC SEL = 0V		10	100	μA
OSC IN Frequency Range	OSC SEL = 0V		50		kHz
OSC IN External Oscillator Threshold Voltage	V_{IH}	$V_{OUT} - 0.4$	$V_{OUT} - 0.6$		V
	V_{IL}		3.65	2.00	
OSC IN Frequency with External Capacitor	OSC SEL = 0V, $C_{OSC} = 47pF$		100		kHz

Note 1: Either V_{CC} or V_{BATT} can go to 0V, if the other is greater than 2.0V.

Note 2: The supply current drawn by the MAX691A/MAX800L/MAX800M from the battery excluding I_{OUT} typically goes to $10\mu A$ when $(V_{BATT} - 1V) < V_{CC} < V_{BATT}$. In most applications, this is a brief period as V_{CC} falls through this region.

Note 3: "+" = battery-discharging current, "-" = battery-charging current.

Note 4: Although presented as typical values, the number of clock cycles for the reset and watchdog timeout periods are fixed and do not vary with process or temperature.

Note 5: RESET is an open-drain output and sinks current only.

Note 6: WDI is internally connected to a voltage divider between V_{OUT} and GND. If unconnected, WDI is driven to 1.6V (typ), disabling the watchdog function.

Note 7: The chip-enable resistance is tested with $V_{CC} = 4.75V$ for the MAX691A/MAX800L and $V_{CC} = 4.5V$ for the MAX693A/MAX800M. $\overline{CE} IN = \overline{CE} OUT = V_{CC} / 2$.

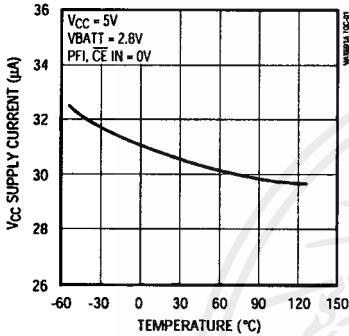
Note 8: The chip-enable propagation delay is measured from the 50% point at $\overline{CE} IN$ to the 50% point at $\overline{CE} OUT$.

Microprocessor Supervisory Circuits

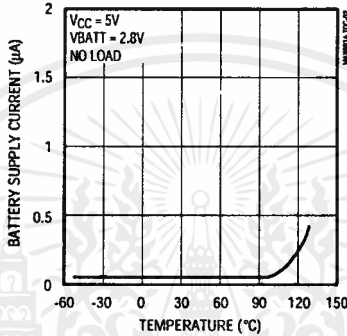
Typical Operating Characteristics

($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted.)

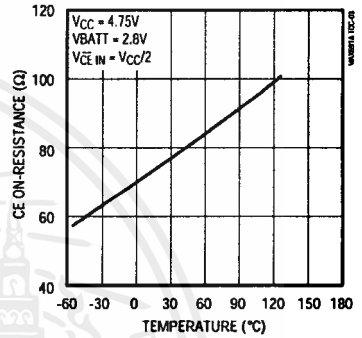
V_{CC} SUPPLY CURRENT vs. TEMPERATURE (NORMAL OPERATING MODE)



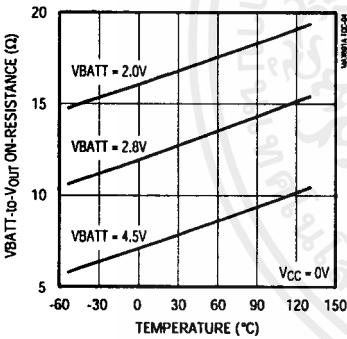
BATTERY SUPPLY CURRENT vs. TEMPERATURE (BATTERY-BACKUP MODE)



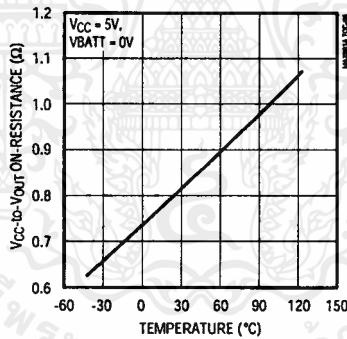
CHIP-ENABLE ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE



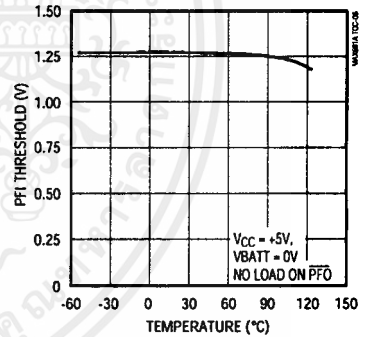
VBATT to V_{OUT} ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE



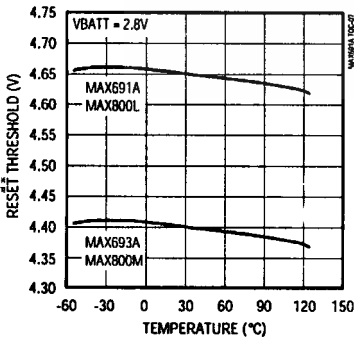
V_{CC} to V_{OUT} ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE



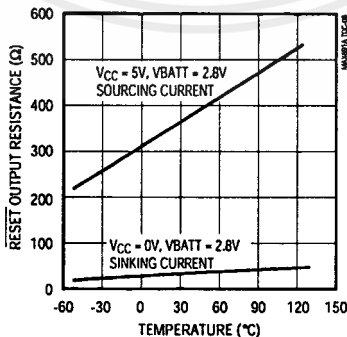
PFI THRESHOLD vs. TEMPERATURE



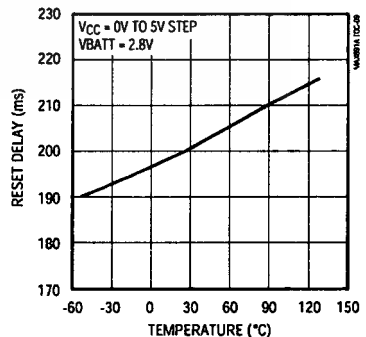
RESET THRESHOLD vs. TEMPERATURE



RESET OUTPUT RESISTANCE vs. TEMPERATURE



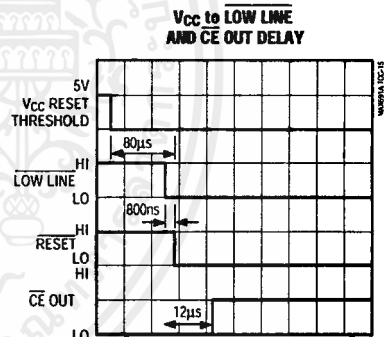
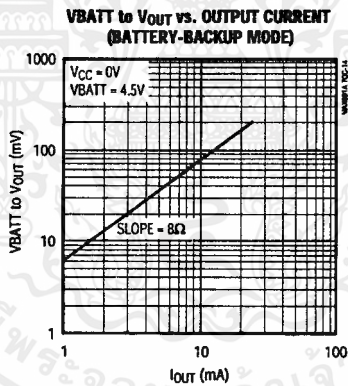
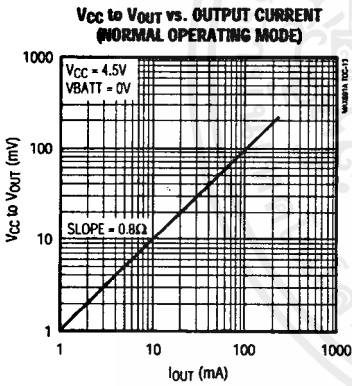
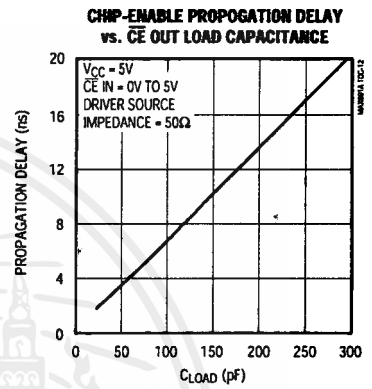
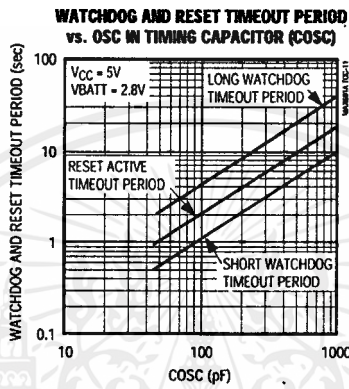
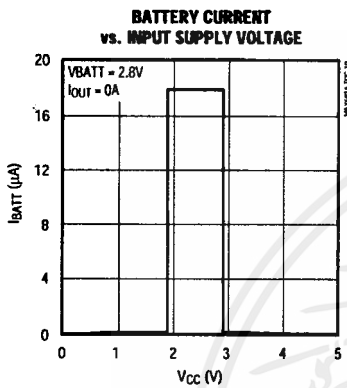
RESET DELAY vs. TEMPERATURE



Microprocessor Supervisory Circuits

Typical Operating Characteristics (continued)

($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted.)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Microprocessor Supervisory Circuits

Pin Description

PIN	NAME	FUNCTION
1	VBATT	Battery-Backup Input. Connect to external battery or capacitor and charging circuit. If backup battery is not used, connect to GND.
2	VOUT	Output Supply Voltage. When V_{CC} is greater than VBATT and above the reset threshold, VOUT connects to V_{CC} . When V_{CC} falls below VBATT and is below the reset threshold, VOUT connects to VBATT. Connect a 0.1 μ F capacitor from VOUT to GND. Connect VOUT to V_{CC} if no backup battery is used.
3	VCC	Input Supply Voltage, 5V input.
4	GND	Ground. 0V reference for all signals.
5	BATT ON	Battery On Output. When VOUT switches to VBATT, BATT ON goes high. When VOUT switches to V_{CC} , BATT ON goes low. Connect the base of a PNP through a current-limiting resistor to BATT ON for VOUT current requirements greater than 250mA.
6	LOW LINE	LOW LINE output goes low when V_{CC} falls below the reset threshold. It returns high as soon as V_{CC} rises above the reset threshold.
7	OSC IN	External Oscillator Input. When OSC SEL is unconnected or driven high, a 10 μ A pull-up connects from VOUT to OSC IN, the internal oscillator sets the reset and watchdog timeout periods, and OSC IN selects between fast and slow watchdog timeout periods. When OSC SEL is driven low, the reset and watchdog timeout periods may be set either by a capacitor from OSC IN to ground or by an external clock at OSC IN (see Figure 3.)
8	OSC SEL	Oscillator Select. When OSC SEL is unconnected or driven high, the internal oscillator sets the reset delay and watchdog timeout period. When OSC SEL is low, the external oscillator input (OSC IN) is enabled (see Table 1). OSC SEL has a 10 μ A internal pull-up.
9	PFI	Power-Fail Input. This is the noninverting input to the power-fail comparator. When PFI is less than 1.25V, PFO goes low. When PFI is not used, connect PFI to GND or VOUT.
10	PFO	Power-Fail Output. This is the output of the power-fail comparator. PFO goes low when PFI is less than 1.25V. This is an uncommitted comparator, and has no effect on any other internal circuitry.
11	WDI	Watchdog Input. WDI is a three-level input. If WDI remains either high or low for longer than the watchdog timeout period, WDO goes low and reset is asserted for the reset timeout period. WDO remains low until the next transition at WDI. Leaving WDI unconnected disables the watchdog function. WDI connects to an internal voltage divider between VOUT and GND, which sets it to mid-supply when left unconnected.
12	CE OUT	Chip-Enable Output. CE OUT goes low only when CE IN is low and V_{CC} is above the reset threshold. If CE IN is low when reset is asserted, CE OUT will stay low for 15 μ s or until CE IN goes high, whichever occurs first.
13	CE IN	Chip-Enable Input. The input to chip-enable gating circuit. If CE IN is not used, connect CE IN to GND or VOUT.
14	WDO	Watchdog Output. If WDI remains high or low longer than the watchdog timeout period, WDO goes low and reset is asserted for the reset timeout period. WDO returns high on the next transition at WDI. WDO remains high if WDI is unconnected.
15	RESET	RESET Output goes low whenever V_{CC} falls below the reset threshold. RESET will remain low typically for 200ms after V_{CC} crosses the reset threshold on power-up.
16	RESET	RESET is an active-high output. It is open drain, and the inverse of RESET.

Detailed Description

RESET and RESET Outputs

The MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M's RESET and RESET outputs ensure that the μ P (with reset inputs asserted either high or low) powers up in a known state, and prevents code-execution errors during power-down or brownout conditions.

The RESET output is active low, and typically sinks 3.2mA at 0.1V saturation voltage in its active state. When deasserted, RESET sources 1.6mA at typically $V_{OUT} - 0.5V$. RESET output is open drain, active high, and typically sinks 3.2mA with a saturation voltage of 0.1V. When no backup battery is used, RESET output is

guaranteed to be valid down to $V_{CC} = 1V$, and an external 10k Ω pull-down resistor on RESET insures that it will be valid with V_{CC} down to GND (Figure 1). As V_{CC} goes below 1V, the gate drive to the RESET output switch reduces accordingly, increasing the $r_{DS(ON)}$ and the saturation voltage. The 10k Ω pull-down resistor insures the parallel combination of switch plus resistor is around 10k Ω and the output saturation voltage is below 0.4V while sinking 40 μ A. When using a 10k Ω external pull-down resistor, the high state for RESET output with $V_{CC} = 4.75V$ will be 4.5V typical. For battery voltages $\geq 2V$ connected to VBATT, RESET and RESET remain valid for V_{CC} from 0V to 5.5V.

MAXIM

Microprocessor Supervisory Circuits

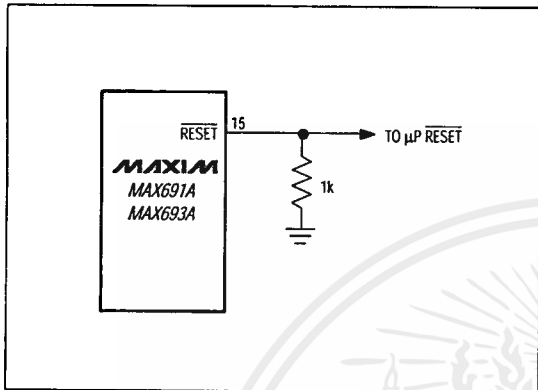


Figure 1. Adding an external pull-down resistor ensures $\overline{\text{RESET}}$ is valid with V_{CC} down to GND.

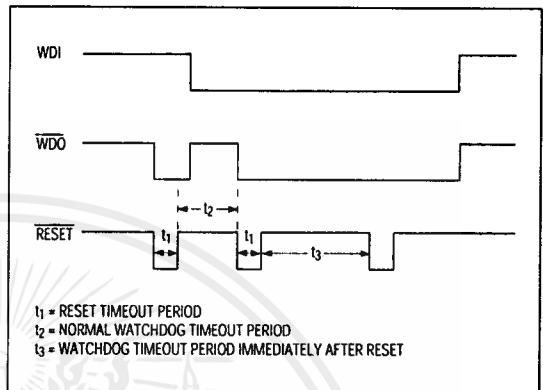


Figure 2. Watchdog Timeout Period and Reset Active Time

$\overline{\text{RESET}}$ and $\overline{\text{RESET}}$ are asserted when V_{CC} falls below the reset threshold (4.65V for the MAX691A/MAX800L, 4.4V for the MAX693A/MAX800M) and remain asserted for 200ms typ after V_{CC} rises above the reset threshold on power-up (Figure 5). The devices' battery-switchover comparator does not affect reset assertion. However, both reset outputs are asserted in battery-backup mode since V_{CC} must be below the reset threshold to enter this mode.

Watchdog Function

The watchdog monitors μP activity via the Watchdog Input (WDI). If the μP becomes inactive, $\overline{\text{RESET}}$ and $\overline{\text{RESET}}$ are asserted. To use the watchdog function, connect WDI to a bus line or μP I/O line. If WDI remains high or low for longer than the watchdog timeout period (1.6sec nominal), $\overline{\text{WDO}}$, $\overline{\text{RESET}}$, and $\overline{\text{RESET}}$ are asserted (see *RESET and RESET Outputs* section, and the *Watchdog Output* discussion on this page).

Watchdog Input

A change of state (high to low, low to high, or a minimum 100ns pulse) at the Watchdog Input (WDI) during the watchdog period resets the watchdog timer. The watchdog default timeout is 1.6sec.

To disable the watchdog function, leave WDI floating. An internal resistor network (100k Ω equivalent impedance at WDI) biases WDI to approximately 1.6V. Internal comparators detect this level and disable the watchdog timer. When V_{CC} is below the reset threshold, the watchdog function is disabled and WDI is disconnected from its internal resistor network, thus becoming high impedance.

Watchdog Output

The Watchdog Output ($\overline{\text{WDO}}$) remains high if there is a transition or pulse at WDI during the watchdog timeout period. The watchdog function is disabled and $\overline{\text{WDO}}$ is a logic high when V_{CC} is below the reset threshold, battery-backup mode is enabled, or WDI is an open circuit. In watchdog mode, if no transition occurs at WDI during the watchdog timeout period, $\overline{\text{RESET}}$ and $\overline{\text{RESET}}$ are asserted for the reset timeout period (200ms typical). $\overline{\text{WDO}}$ goes low and remains low until the next transition at WDI (Figure 2). If WDI is held high or low indefinitely, $\overline{\text{RESET}}$ and $\overline{\text{RESET}}$ will generate 200ms pulses every 1.6sec. $\overline{\text{WDO}}$ has a 2 x TTL output characteristic.

Selecting an Alternative Watchdog and Reset Timeout Period

The OSC SEL and OSC IN inputs control the watchdog and reset timeout periods. Floating OSC SEL and OSC IN or tying them both to V_{OUT} selects the nominal 1.6sec watchdog timeout period and 200ms reset timeout period. Connecting OSC IN to GND and floating or connecting OSC SEL to V_{OUT} selects the 100ms normal watchdog timeout delay and 1.6sec delay immediately after reset. The reset timeout delay remains 200ms (Figure 2). Select alternative timeout periods by connecting OSC SEL to GND and connecting a capacitor between OSC IN and GND, or by externally driving OSC IN (Table 1 and Figure 3). OSC IN is internally connected to a $\pm 100\text{nA}$ (typ) current source that charges and discharges the timing capacitor to create the oscillator frequency, which sets the reset and watchdog timeout periods (see *Connecting a Timing Capacitor at OSC IN* in the *Applications Information* section).

Microprocessor Supervisory Circuits

MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M

Table 1. Reset Pulse Width and Watchdog Timeout Selections

OSC SEL	OSC IN	Watchdog Timeout Period		Reset Timeout Period
		Normal	Immediately After Reset	
Low	External Clock Input	1024 clks	4096 clks	2048 clks
Low	External Capacitor	(600/47pF x C)ms	(2.4/47pF x C)sec	(1200/47pF x C)ms
Floating	Low	100ms	1.6sec	200ms
Floating	Floating	1.6sec	1.6sec	200ms

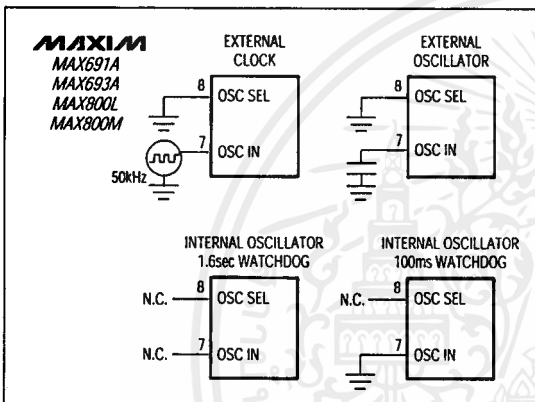


Figure 3. Oscillator Circuits

Chip-Enable Signal Gating

The MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M provide internal gating of chip-enable (CE) signals to prevent erroneous data from being written to CMOS RAM in the event of a power failure. During normal operation, the CE gate is enabled and passes all CE transitions. When reset is asserted, this path becomes disabled, preventing erroneous data from corrupting the CMOS RAM. All these parts use a series transmission gate from \overline{CE} IN to \overline{CE} OUT (Figure 4).

The 10ns max CE propagation delay from \overline{CE} IN to \overline{CE} OUT enables the parts to be used with most μ Ps.

Chip-Enable Input

The Chip-Enable Input (\overline{CE} IN) is high impedance (disabled mode) while RESET and \overline{RESET} are asserted.

During a power-down sequence where V_{CC} falls below the reset threshold or a watchdog fault, \overline{CE} IN assumes a high-impedance state when the voltage at \overline{CE} IN goes high or 15 μ s after reset is asserted, whichever occurs first (Figure 5).

During a power-up sequence, \overline{CE} IN remains high impedance, regardless of \overline{CE} IN activity, until reset is deasserted following the reset timeout period.

In the high-impedance mode, the leakage currents into this terminal are $\pm 1\mu$ A max over temperature. In the low-impedance mode, the impedance of \overline{CE} IN appears as a 75 Ω resistor in series with the load at \overline{CE} OUT.

The propagation delay through the CE transmission gate depends on both the source impedance of the drive to \overline{CE} IN and the capacitive loading on the Chip-Enable Output (\overline{CE} OUT) (see Chip-Enable Propagation Delay vs. \overline{CE} OUT Load Capacitance in the *Typical Operating Characteristics*). The CE propagation delay is production tested from the 50% point of \overline{CE} IN to the 50% point of \overline{CE} OUT using a 50 Ω driver and 50pF of load capacitance (Figure 6). For minimum propagation delay, minimize the capacitive load at \overline{CE} OUT, and use a low output-impedance driver.

Chip-Enable Output

In the enabled mode, the impedance of \overline{CE} OUT is equivalent to 75 Ω in series with the source driving \overline{CE} IN. In the disabled mode, the 75 Ω transmission gate is off and \overline{CE} OUT is actively pulled to V_{OUT} . This source turns off when the transmission gate is enabled.

LOW LINE Output

LOW LINE is the buffered output of the reset threshold comparator. LOW LINE typically sinks 3.2mA at 0.1V. For normal operation (V_{CC} above the LOW LINE threshold), LOW LINE is pulled to V_{OUT} .

Power-Fail Comparator

The power-fail comparator is an uncommitted comparator that has no effect on the other functions of the IC. Common uses include low-battery indication (Figure 7), and early power-fail warning (see *Typical Operating Circuit*).

Power-Fail Input

PFI is the input to the power-fail comparator. PFI has a guaranteed input leakage of ± 25 nA max over temperature. The typical comparator delay is 25 μ s from V_{IL} to V_{OL} (power failing), and 60 μ s from V_{IH} to V_{OH} (power being restored). If unused, connect this input to ground.

Microprocessor Supervisory Circuits

MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M

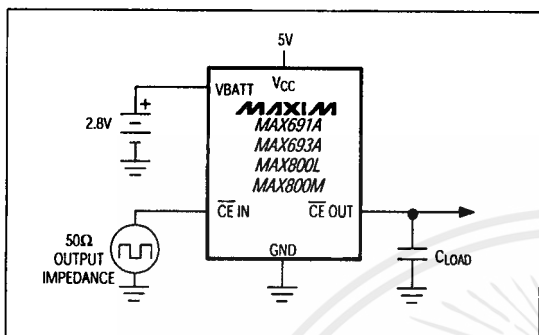


Figure 6. CE Propagation Delay Test Circuit

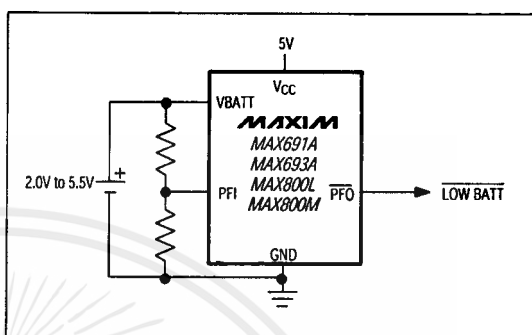


Figure 7. Low-Battery Indicator

Table 2. Input and Output Status in Battery-Backup Mode

PIN	NAME	STATUS
1	VBATT	Supply Current is 1 μ A max.
2	VOUT	VOUT is connected to VBATT through an internal PMOS switch.
3	VCC	Battery switchover comparator monitors VCC for active switchover.
4	GND	GND 0V, 0V reference for all signals.
5	BATT ON	Logic high. The open-circuit output is equal to VOUT.
6	LOWLINE	Logic Low*
7	OSC IN	OSC IN is ignored.
8	OSC SEL	OSC SEL is ignored.
9	PFI	The power-fail comparator remains active in the battery-backup mode for VCC \geq VBATT - 1.2V typ.
10	PFO	The power-fail comparator remains active in the battery-backup mode for VCC \geq VBATT - 1.2V typ. Below this voltage, PFO is forced low.
11	WDI	Watchdog is ignored.
12	CE OUT	Logic high. The open-circuit voltage is equal to VOUT.
13	CE IN	High Impedance.
14	WDO	Logic high. The open-circuit voltage is equal to VOUT.
15	RESET	Logic low*
16	RESET	High Impedance*

* VCC must be below the reset threshold to enter battery-backup mode.

Power-Fail Output

The Power-Fail Output (PFO) goes low when PFI goes below 1.25V. It typically sinks 3.2mA with a saturation voltage of 0.1V. With PFI above 1.25V, PFO is actively pulled to VOUT.

Battery-Backup Mode

Two conditions are required to switch to battery-backup mode: 1) VCC must be below the reset threshold, and 2) VCC must be below VBATT. Table 2 lists the status of the inputs and outputs in battery-backup mode.

Battery On Output

The Battery On (BATT ON) output indicates the status of the internal VCC/battery-switchover comparator, which controls the internal VCC and VBATT switches. For VCC greater than VBATT (ignoring the small hysteresis effect), BATT ON typically sinks 3.2mA at 0.1V saturation voltage. In battery-backup mode, this terminal sources approximately 10 μ A from VOUT. Use BATT ON to indicate battery-switchover status or to supply base drive to an external pass transistor for higher-current applications (see *Typical Operating Circuit*).

Input Supply Voltage

The Input Supply Voltage (VCC) should be a regulated 5V. VCC connects to VOUT via a parallel diode and a large PMOS switch. The switch carries the entire current load for currents less than 250mA. The parallel diode carries any current in excess of 250mA. Both the switch and the diode have impedances less than 1 Ω each. The maximum continuous current is 250mA, but power-on transients may reach a maximum of 1A.

Microprocessor Supervisory Circuits

Backup-Battery Input

The Backup-Battery Input (VBATT) is similar to the V_{CC} input except the PMOS switch and parallel diode are much smaller. Accordingly, the on-resistances of the diode and the switch are each approximately 10Ω . Continuous current should be limited to 25mA and peak currents (only during power-up) limited to 250mA. The reverse leakage of this input is less than $1\mu A$ over temperature and supply voltage (Figure 8).

Output Supply Voltage

The Output Supply Voltage (V_{OUT}) pin is internally connected to the substrate of the IC and supplies current to the external system and internal circuitry. All open-circuit outputs will, for example, assume the V_{OUT} voltage in their high states rather than the V_{CC} voltage. At the maximum source current of 250mA, V_{OUT} will typically be 200mV below V_{CC} . Decouple this terminal with a $0.1\mu F$ capacitor.

Applications Information

The MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M are not short-circuit protected. Shorting V_{OUT} to ground, other than power-up transients such as charging a decoupling capacitor, destroys the device.

All open-circuit outputs swing between V_{OUT} and GND rather than V_{CC} and GND.

If long leads connect to the chip inputs, insure that these leads are free from ringing and other conditions that would forward bias the chip's protection diodes.

There are three distinct modes of operation:

- 1) Normal operating mode with all circuitry powered up. Typical supply current from V_{CC} is $35\mu A$ while only leakage currents flow from the battery.
- 2) Battery-backup mode where V_{CC} is typically within 0.7V below VBATT. All circuitry is powered up and the supply current from the battery is typically less than $60\mu A$.
- 3) Battery-backup mode where V_{CC} is less than VBATT by at least 0.7V. VBATT supply current is $1\mu A$ max.

Using SuperCaps or MaxCaps with the MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M

VBATT has the same operating voltage range as V_{CC} , and the battery switchover threshold voltages are typically $\pm 30mV$ centered at VBATT, allowing use of a SuperCap and a simple charging circuit as a backup source (Figure 9).

If V_{CC} is above the reset threshold and VBATT is 0.5V above V_{CC} , current flows to V_{OUT} and V_{CC} from VBATT until the voltage at VBATT is less than 0.5V above V_{CC} . For example, with a SuperCap connected to VBATT and through a diode to V_{CC} , if V_{CC} quickly changes from 5.4V to 4.9V, the capacitor discharges through V_{OUT} and V_{CC} until VBATT reaches 5.1V typ. Leakage current through the SuperCap charging diode and the internal power diode eventually discharges the SuperCap to V_{CC} . Also, if V_{CC} and VBATT start from 0.1V above the reset threshold and power is lost at V_{CC} , the SuperCap on VBATT discharges through V_{CC} until VBATT reaches the reset threshold; then the battery-backup mode is initiated and the current through V_{CC} goes to zero.

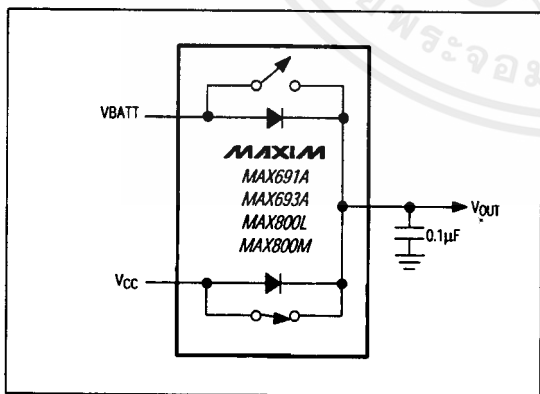


Figure 8. V_{CC} and VBATT to V_{OUT} Switch

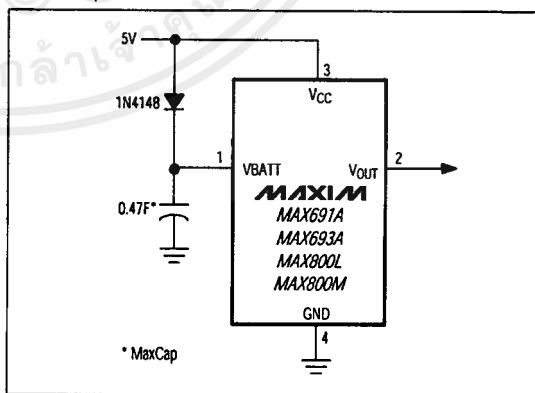


Figure 9. SuperCap or MaxCap on VBATT

Microprocessor Supervisory Circuits

MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M

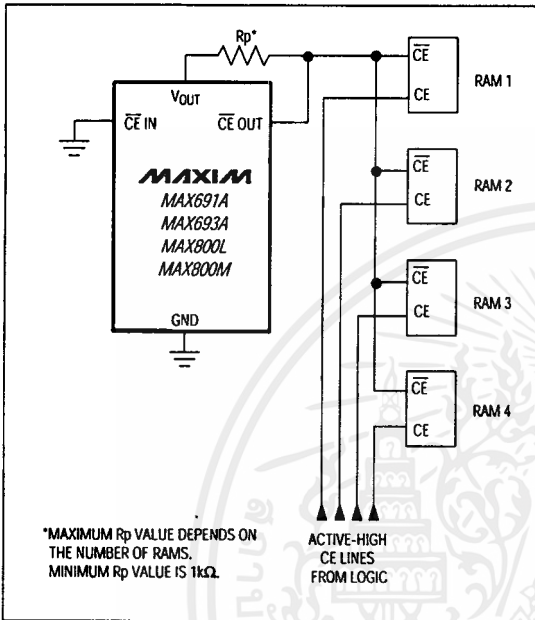


Figure 10. Alternate CE Gating

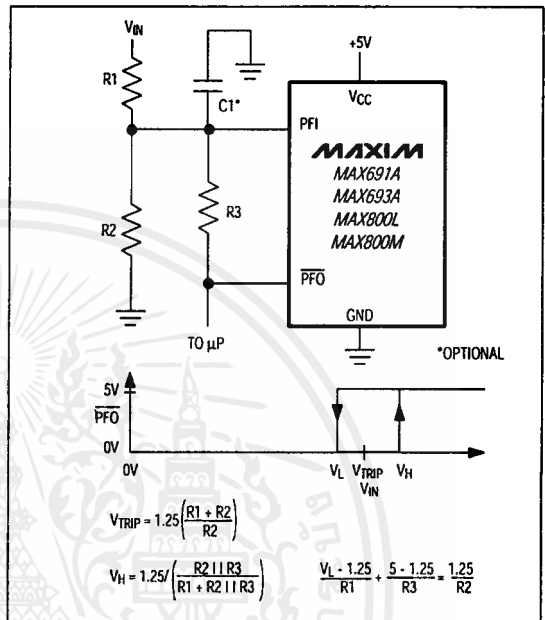


Figure 11. Adding Hysteresis to the Power-Fail Comparator

Using Separate Power Supplies for VBATT and VCC

If using separate power supplies for VCC and VBATT, VBATT must be less than 0.3V above VCC when VCC is above the reset threshold. As described in the previous section, if VBATT exceeds this limit and power is lost at VCC, current flows continuously from VBATT to VCC via the VBATT-to-VOUT diode and the VOUT-to-VCC switch until the circuit is broken (Figure 8).

Alternative Chip-Enable Gating

Using memory devices with both CE and CE inputs allows the CE loop to be bypassed. To do this, connect CE IN to ground, pull-up CE OUT to VOUT, and connect CE OUT to the CE input of each memory device (Figure 10). The CE input of each part then connects directly to the chip-select logic, which does not have to be gated.

Adding Hysteresis to the Power-Fail Comparator

Hysteresis adds a noise margin to the power-fail comparator and prevents repeated triggering of PFO when VIN is near the power-fail comparator trip point. Figure 11 shows how to add hysteresis to the power-fail com-

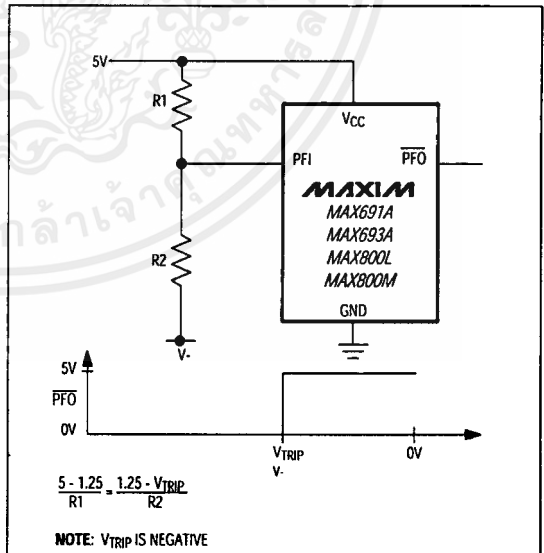


Figure 12. Monitoring a Negative Voltage

Microprocessor Supervisory Circuits

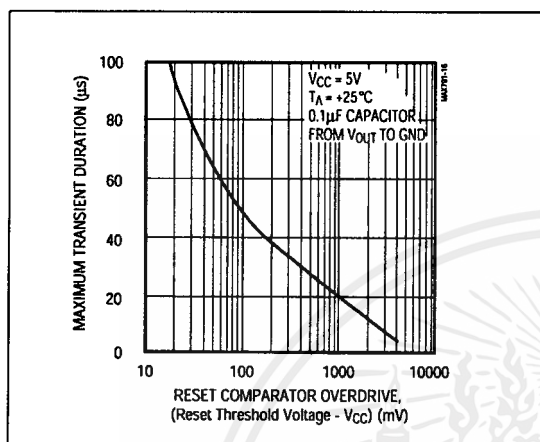


Figure 13. Maximum Transient Duration without Causing a Reset Pulse vs. Reset Comparator Overdrive

parator. Select the ratio of R1 and R2 such that PFI sees 1.25V when V_{IN} falls to the desired trip point (V_{TRIP}). Resistor R3 adds hysteresis. It will typically be an order of magnitude greater than R1 or R2. The current through R1 and R2 should be at least 1µA to ensure that the 25nA (max) PFI input current does not shift the trip point. R3 should be larger than 10kΩ to prevent it from loading down the PFO pin. Capacitor C1 adds additional noise rejection.

Monitoring a Negative Voltage

The power-fail comparator can be used to monitor a negative supply voltage using Figure 12's circuit. When the negative supply is valid, PFO is low. When the negative supply voltage drops, PFO goes high. This circuit's accuracy is affected by the PFI threshold tolerance, the V_{CC} voltage, and resistors R1 and R2.

Backup-Battery Replacement

The backup battery may be disconnected while V_{CC} is above the reset threshold. No precautions are necessary to avoid spurious reset pulses.

Negative-Going V_{CC} Transients

While issuing resets to the µP during power-up, power-down, and brownout conditions, these supervisors are relatively immune to short-duration, negative-going V_{CC} transients (glitches). It is usually undesirable to reset the µP when V_{CC} experiences only small glitches.

Figure 7 shows maximum transient duration vs. reset-comparator overdrive, for which reset pulses are **not** generated. The graph was produced using negative-going V_{CC} pulses, starting at 5V and ending below the reset threshold by the magnitude indicated (reset comparator overdrive). The graph shows the maximum pulse width a negative-going V_{CC} transient may typically have without causing a reset pulse to be issued. As the amplitude of the transient increases (i.e., goes farther below the reset threshold), the maximum allowable pulse width decreases. Typically, a V_{CC} transient that goes 100mV below the reset threshold and lasts for 40µs or less will not cause a reset pulse to be issued.

A 100nF bypass capacitor mounted close to the V_{CC} pin provides additional transient immunity.

Connecting a Timing Capacitor at OSC IN

When OSC SEL is connected to ground, OSC IN disconnects from its internal 10µA (typ) pull-up and is internally connected to a ±100nA current source. When a capacitor is connected from OSC IN to ground (to select alternative reset and watchdog timeout periods), the current source charges and discharges the timing capacitor to create the oscillator that controls the reset and watchdog timeout period. To prevent timing errors or oscillator start-up problems, minimize external current leakage sources at this pin, and locate the capacitor as close to OSC IN as possible. The sum of PC-board leakage + OSC capacitor leakage must be small compared to ±100nA.

Microprocessor Supervisory Circuits

Maximum V_{CC} Fall Time

The V_{CC} fall time is limited by the propagation delay of the battery switchover comparator and should not exceed 0.03V/μs. A standard rule of thumb for filter capacitance on most regulators is on the order of 100μF per amp of current. When the power supply is shut off or the main battery is disconnected, the associated initial V_{CC} fall rate is just the inverse or 1A/100μF = 0.01V/μs. The V_{CC} fall rate decreases with time as V_{CC} falls exponentially, which more than satisfies the maximum fall-time requirement.

Watchdog Software Considerations

A way to help the watchdog timer keep a closer watch on software execution involves setting and resetting the watchdog input at different points in the program, rather than "pulsing" the watchdog input high-low-high or low-high-low. This technique avoids a "stuck" loop where the watchdog timer continues to be reset within the loop, keeping the watchdog from timing out. Figure 14 shows an example flow diagram where the I/O driving the watchdog input is set high at the beginning of the program, set low at the beginning of every subroutine or loop, then set high again when the program returns to the beginning. If the program should "hang" in any subroutine, the I/O is continually set low and the watchdog timer is allowed to time out, causing a reset or interrupt to be issued.

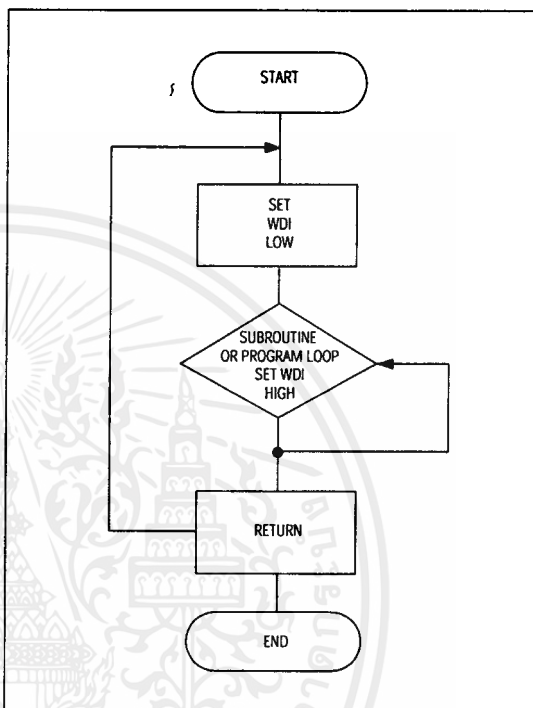


Figure 14. Watchdog Flow Diagram

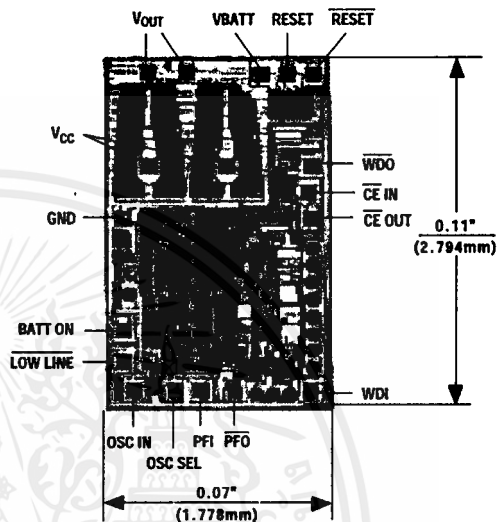
Microprocessor Supervisory Circuits

Ordering Information (continued)

PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE
MAX693ACPE	0°C to +70°C	16 Plastic DIP
MAX693ACSE	0°C to +70°C	16 Narrow SO
MAX693ACWE	0°C to +70°C	16 Wide SO
MAX693AC/D	0°C to +70°C	Dice*
MAX693AEPE	-40°C to +85°C	16 Plastic SO
MAX693AESE	-40°C to +85°C	16 Narrow SO
MAX693AEWE	-40°C to +85°C	16 Wide SO
MAX693AEJE	-40°C to +85°C	16 CERDIP
MAX693AMJE	-55°C to +125°C	16 CERDIP
MAX800LCPE	0°C to +70°C	16 Plastic DIP
MAX800LCSE	0°C to +70°C	16 Narrow SO
MAX800LEPE	-40°C to +85°C	16 Plastic DIP
MAX800LESE	-40°C to +85°C	16 Narrow SO
MAX800MCPE	0°C to +70°C	16 Plastic DIP
MAX800MCSE	0°C to +70°C	16 Narrow SO
MAX800MEPE	-40°C to +85°C	16 Plastic DIP
MAX800MESE	-40°C to +85°C	16 Narrow SO

* Dice are specified at $T_A = +25^\circ\text{C}$. DC parameters only.

Chip Topography



TRANSISTOR COUNT: 729
SUBSTRATE CONNECTED TO VOUT

Package Information

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.053	0.069	1.35	1.75
A1	0.004	0.010	0.10	0.25
B	0.014	0.019	0.35	0.49
C	0.007	0.010	0.19	0.25
E	0.150	0.157	3.80	4.00
e	0.050		1.27	
H	0.228	0.244	5.80	6.20
L	0.016	0.050	0.40	1.27

**Narrow SO
SMALL-OUTLINE
PACKAGE
(0.150 in.)**

DIM	PINS	INCHES		MILLIMETERS	
		MIN	MAX	MIN	MAX
D	8	0.189	0.197	4.80	5.00
D	14	0.337	0.344	8.55	8.75
D	16	0.386	0.394	9.80	10.00

21-0041A

Maxim cannot assume responsibility for use of any circuitry other than circuitry entirely embodied in a Maxim product. No circuit patent licenses are implied. Maxim reserves the right to change the circuitry and specifications without notice at any time.

16 Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 (408) 737-7600

© 1995 Maxim Integrated Products

Printed USA

MAXIM is a registered trademark of Maxim Integrated Products.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Features

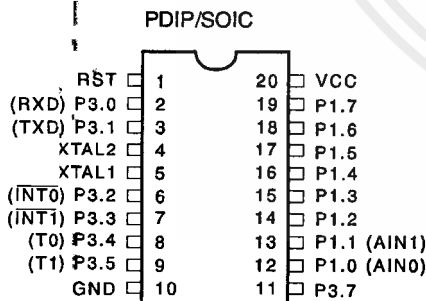
- Compatible with MCS-51™ Products
- 2 Kbytes of Reprogrammable Flash Memory
Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles
- 2.7 V to 6 V Operating Range
- Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz
- Two-Level Program Memory Lock
- 128 x 8-Bit Internal RAM
- 15 Programmable I/O Lines
- Two 16-Bit Timer/Counters
- Six Interrupt Sources
- Programmable Serial UART Channel
- Direct LED Drive Outputs
- On-Chip Analog Comparator
- Low Power Idle and Power Down Modes

Description

The AT89C2051 is a low-voltage, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 2 Kbytes of Flash programmable and erasable read only memory (PEROM). The device is manufactured using Atmel's high density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry standard MCS-51™ instruction set and pinout. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89C2051 is a powerful microcomputer which provides a highly flexible and cost effective solution to many embedded control applications.

The AT89C2051 provides the following standard features: 2 Kbytes of Flash, 128 bytes of RAM, 15 I/O lines, two 16-bit timer/counters, a five vector two-level interrupt architecture, a full duplex serial port, a precision analog comparator, on-chip oscillator and clock circuitry. In addition, the AT89C2051 is designed with static logic for operation down to zero frequency and supports two software selectable power saving modes. The Idle Mode stops the CPU while allowing the RAM, timer/counters, serial port and interrupt system to continue functioning. The Power Down Mode saves the RAM contents but freezes the oscillator disabling all other chip functions until the next hardware reset.

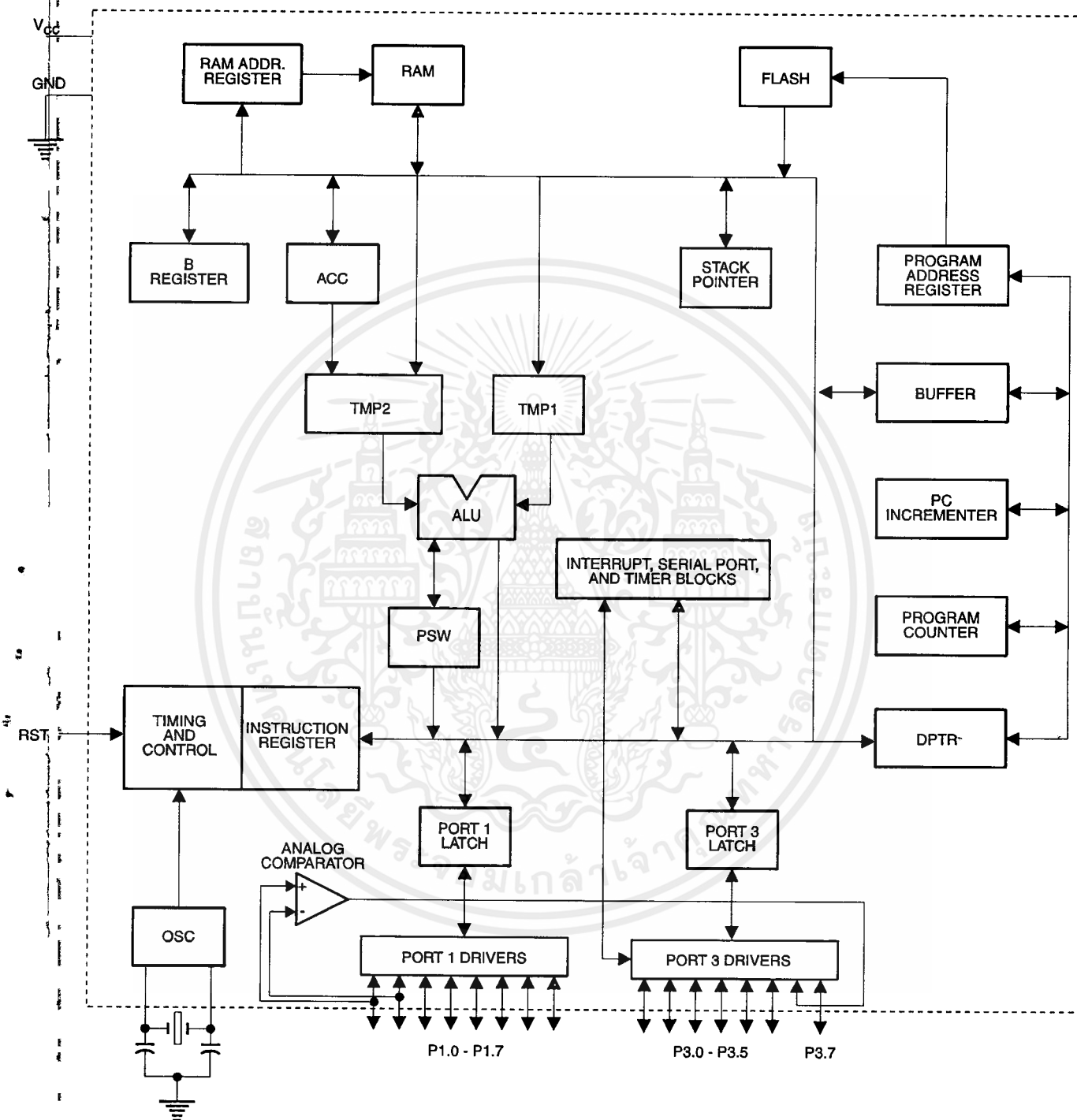
Pin Configuration



8-Bit Microcontroller with 2 Kbytes Flash



Block Diagram



AT89C2051

Pin Description

V_{CC}
Supply voltage.

GND
Ground.

Port 1
Port 1 is an 8-bit bidirectional I/O port. Port pins P1.2 to P1.7 provide internal pullups. P1.0 and P1.1 require external pullups. P1.0 and P1.1 also serve as the positive input (AIN0) and the negative input (AIN1), respectively, of the on-chip precision analog comparator. The Port 1 output buffers can sink 20 mA and can drive LED displays directly. When 1s are written to Port 1 pins, they can be used as inputs. When pins P1.2 to P1.7 are used as inputs and are externally pulled low, they will source current (I_{IL}) because of the internal pullups.

Port 1 also receives code data during Flash programming and program verification.

Port 3
Port 3 pins P3.0 to P3.5, P3.7 are seven bidirectional I/O pins with internal pullups. P3.6 is hard-wired as an input to the output of the on-chip comparator and is not accessible as a general purpose I/O pin. The Port 3 output buffers can sink 20 mA. When 1s are written to Port 3 pins they are pulled high by the internal pullups and can be used as inputs. As inputs, Port 3 pins that are externally being pulled low will source current (I_{IL}) because of the pullups.

Port 3 also serves the functions of various special features of the AT89C2051 as listed below:

Port Pin	Alternate Functions
P3.0	RXD (serial input port)
P3.1	TXD (serial output port)
P3.2	INT0 (external interrupt 0)
P3.3	INT1 (external interrupt 1)
P3.4	T0 (timer 0 external input)
P3.5	T1 (timer 1 external input)

Port 3 also receives some control signals for Flash programming and programming verification.

RST
Reset input. All I/O pins are reset to 1s as soon as RST goes high. Holding the RST pin high for two machine cycles while the oscillator is running resets the device.

Each machine cycle takes 12 oscillator or clock cycles.

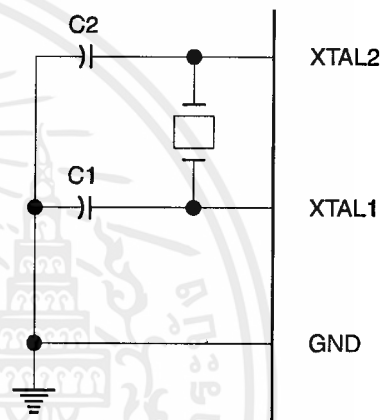
XTAL1
Input to the inverting oscillator amplifier and input to the internal clock operating circuit.

XTAL2
Output from the inverting oscillator amplifier.

Oscillator Characteristics

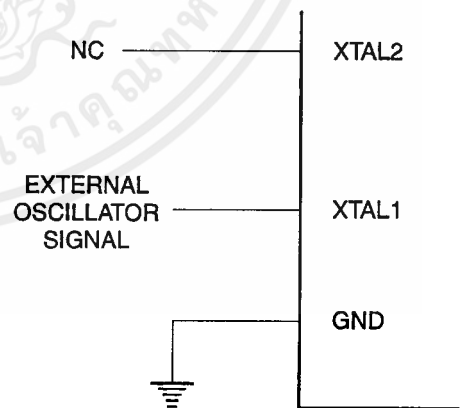
XTAL1 and XTAL2 are the input and output, respectively, of an inverting amplifier which can be configured for use as an on-chip oscillator, as shown in Figure 1. Either a quartz crystal or ceramic resonator may be used. To drive the device from an external clock source, XTAL2 should be left unconnected while XTAL1 is driven as shown in Figure 2. There are no requirements on the duty cycle of the external clock signal, since the input to the internal clocking circuitry is through a divide-by-two flip-flop, but minimum and maximum voltage high and low time specifications must be observed.

Figure 1. Oscillator Connections



Notes: C1, C2 = 30 pF ± 10 pF for Crystals
= 40 pF ± 10 pF for Ceramic Resonators

Figure 2. External Clock Drive Configuration





Special Function Registers

A map of the on-chip memory area called the Special Function Register (SFR) space is shown in the table below.

Note that not all of the addresses are occupied, and unoccupied addresses may not be implemented on the chip. Read accesses to these addresses will in general return

random data, and write accesses will have an indeterminate effect.

User software should not write 1s to these unlisted locations, since they may be used in future products to invoke new features. In that case, the reset or inactive values of the new bits will always be 0.

Table 1. AT89C2051 SFR Map and Reset Values

0F8H								0FFH
0F0H	B 00000000							0F7H
0E8H								0EFH
0E0H	ACC 00000000							0E7H
0D8H								0DFH
0D0H	PSW 00000000							0D7H
0C8H								0CFH
0C0H								0C7H
0B8H	IP XXX00000							0BFH
0B0H	P3 11111111							0B7H
0A8H	IE 0XX00000							0AFH
0A0H								0A7H
98H	SCON 00000000	SBUF XXXXXXXX						9FH
90H	P1 11111111							97H
88H	TCON 00000000	TMOD 00000000	TL0 00000000	TL1 00000000	TH0 00000000	TH1 00000000		8FH
80H		SP 00000111	DPL 00000000	DPH 00000000			PCON 0XXX0000	87H

Restrictions on Certain Instructions

The AT89C2051 is an economical and cost-effective member of Atmel's growing family of microcontrollers. It contains 2 Kbytes of flash program memory. It is fully compatible with the MCS-51 architecture, and can be programmed using the MCS-51 instruction set. However, there are a few considerations one must keep in mind when utilizing certain instructions to program this device.

All the instructions related to jumping or branching should be restricted such that the destination address falls within the physical program memory space of the device, which is 2K for the AT89C2051. This should be the responsibility of the software programmer. For example, LJMP 7E0H would be a valid instruction for the AT89C2051 (with 2K of memory), whereas LJMP 900H would not.

1. Branching instructions:

LCALL, LJMP, ACALL, AJMP, SJMP, JMP @A+DPTR

These unconditional branching instructions will execute correctly as long as the programmer keeps in mind that the destination branching address must fall within the physical boundaries of the program memory size (locations 00H to 7FFH for the 89C2051). Violating the physical space limits may cause unknown program behavior.

CJNE [...], DJNZ [...], JB, JNB, JC, JNC, JBC, JZ, JNZ
With these conditional branching instructions the same rule above applies. Again, violating the memory boundaries may cause erratic execution.

For applications involving interrupts the normal interrupt service routine address locations of the 80C51 family architecture have been preserved.

2. MOVX-related instructions, Data Memory:

The AT89C2051 contains 128 bytes of internal data memory. Thus, in the AT89C2051 the stack depth is limited to 128 bytes, the amount of available RAM. External DATA memory access is not supported in this device, nor is external PROGRAM memory execution. Therefore, no MOVX [...] instructions should be included in the program.

A typical 80C51 assembler will still assemble instructions, even if they are written in violation of the restrictions mentioned above. It is the responsibility of the controller user to know the physical features and limitations of the device being used and adjust the instructions used correspondingly.

Program Memory Lock Bits

On the chip are two lock bits which can be left unprogrammed (U) or can be programmed (P) to obtain the additional features listed in the table below:

Lock Bit Protection Modes⁽¹⁾

Program Lock Bits	Protection Type		
	LB1	LB2	
1	U	U	No program lock features.
2	P	U	Further programming of the Flash is disabled.
3	P	P	Same as mode 2, also verify is disabled.

Note: 1. The Lock Bits can only be erased with the Chip Erase operation

Idle Mode

In idle mode, the CPU puts itself to sleep while all the on-chip peripherals remain active. The mode is invoked by software. The content of the on-chip RAM and all the special functions registers remain unchanged during this mode. The idle mode can be terminated by any enabled interrupt or by a hardware reset.

P1.0 and P1.1 should be set to '0' if no external pullups are used, or set to '1' if external pullups are used.

It should be noted that when idle is terminated by a hardware reset, the device normally resumes program execution, from where it left off, up to two machine cycles before the internal reset algorithm takes control. On-chip hardware inhibits access to internal RAM in this event, but access to the port pins is not inhibited. To eliminate the possibility of an unexpected write to a port pin when Idle is terminated by reset, the instruction following the one that invokes Idle should not be one that writes to a port pin or to external memory.

Power Down Mode

In the power down mode the oscillator is stopped, and the instruction that invokes power down is the last instruction executed. The on-chip RAM and Special Function Registers retain their values until the power down mode is terminated. The only exit from power down is a hardware reset. Reset redefines the SFRs but does not change the on-chip RAM. The reset should not be activated before VCC is restored to its normal operating level and must be held active long enough to allow the oscillator to restart and stabilize.

P1.0 and P1.1 should be set to '0' if no external pullups are used, or set to '1' if external pullups are used.

Programming The Flash

The AT89C2051 is shipped with the 2 Kbytes of on-chip PEROM code memory array in the erased state (i.e., contents = FFH) and ready to be programmed. The code memory array is programmed one byte at a time. *Once the array is programmed, to re-program any non-blank byte, the entire memory array needs to be erased electrically.*

Internal Address Counter: The AT89C2051 contains an internal PEROM address counter which is always reset to 000H on the rising edge of RST and is advanced by applying a positive going pulse to pin XTAL1.

Programming Algorithm: To program the AT89C2051, the following sequence is recommended.

1. Power-up sequence:
Apply power between VCC and GND pins
Set RST and XTAL1 to GND
With all other pins floating, wait for greater than 10 milliseconds
2. Set pin RST to 'H'
Set pin P3.2 to 'H'
3. Apply the appropriate combination of 'H' or 'L' logic levels to pins P3.3, P3.4, P3.5, P3.7 to select one of the programming operations shown in the PEROM Programming Modes table.

To Program and Verify the Array:

4. Apply data for Code byte at location 000H to P1.0 to P1.7.
5. Raise RST to 12V to enable programming.
6. Pulse P3.2 once to program a byte in the PEROM array or the lock bits. The byte-write cycle is self-timed and typically takes 1.2 ms.
7. To verify the programmed data, lower RST from 12V to logic 'H' level and set pins P3.3 to P3.7 to the appropriate levels. Output data can be read at the port P1 pins.
8. To program a byte at the next address location, pulse XTAL1 pin once to advance the internal address counter. Apply new data to the port P1 pins.
9. Repeat steps 5 through 8, changing data and advancing the address counter for the entire 2 Kbytes array or until the end of the object file is reached.
10. Power-off sequence:
set XTAL1 to 'L'
set RST to 'L'
Float all other I/O pins
Turn Vcc power off

Data Polling: The AT89C2051 features Data Polling to indicate the end of a write cycle. During a write cycle, an attempted read of the last byte written will result in the complement of the written data on P1.7. Once the write cycle has been completed, true data is valid on all outputs, and the next cycle may begin. Data Polling may begin any time after a write cycle has been initiated.

Ready/Busy: The Progress of byte programming can also be monitored by the RDY/BSY output signal. Pin P3.1 is pulled low after P3.2 goes High during programming to indicate BUSY. P3.1 is pulled High again when programming is done to indicate READY.

Program Verify: If lock bits LB1 and LB2 have not been programmed code data can be read back via the data lines for verification:

1. Reset the internal address counter to 000H by bringing RST from 'L' to 'H'.
2. Apply the appropriate control signals for Read Code data and read the output data at the port P1 pins.
3. Pulse pin XTAL1 once to advance the internal address counter.
4. Read the next code data byte at the port P1 pins.
5. Repeat steps 3 and 4 until the entire array is read.

The lock bits cannot be verified directly. Verification of the lock bits is achieved by observing that their features are enabled.

Chip Erase: The entire PEROM array (2 Kbytes) and the two Lock Bits are erased electrically by using the proper combination of control signals and by holding P3.2 low for 10 ms. The code array is written with all "1"s in the Chip Erase operation and must be executed before any non-blank memory byte can be re-programmed.

Reading the Signature Bytes: The signature bytes are read by the same procedure as a normal verification of locations 000H, 001H, and 002H, except that P3.5 and P3.7 must be pulled to a logic low. The values returned are as follows.

- (000H) = 1EH indicates manufactured by Atmel
- (001H) = 21H indicates 89C2051

Programming Interface

Every code byte in the Flash array can be written and the entire array can be erased by using the appropriate combination of control signals. The write operation cycle is self-timed and once initiated, will automatically time itself to completion.

All major programming vendors offer worldwide support for the Atmel microcontroller series. Please contact your local programming vendor for the appropriate software revision.

Flash Programming Modes

Mode	RST	P3.2/ PROG	P3.3	P3.4	P3.5	P3.7
Write Code Data ^(1,3)	12V	$\overline{\text{L}} / \overline{\text{L}}$	L	H	H	H
Read Code Data ⁽¹⁾	H	H	L	L	H	H
Write Lock	12V	Bit - 1	$\overline{\text{L}}$	H	H	H
		Bit - 2	$\overline{\text{L}} / \overline{\text{L}}$	H	H	L
Chip Erase	12V	$\overline{\text{L}} / \overline{\text{L}}$ ⁽²⁾	H	L	L	L
Read Signature Byte	H	H	L	L	L	L

Notes: 1. The internal PEROM address counter is reset to 000H on the rising edge of RST and is advanced by a positive pulse at XTAL1 pin.

2. Chip Erase requires a 10 ms $\overline{\text{PROG}}$ pulse.

3. P3.1 is pulled Low during programming to indicate RDY/BSY.



Figure 3. Programming the Flash Memory

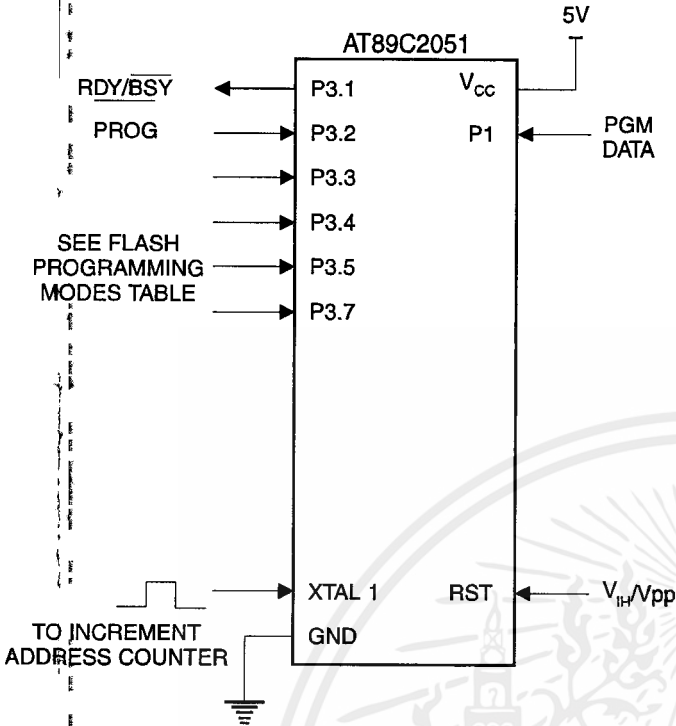
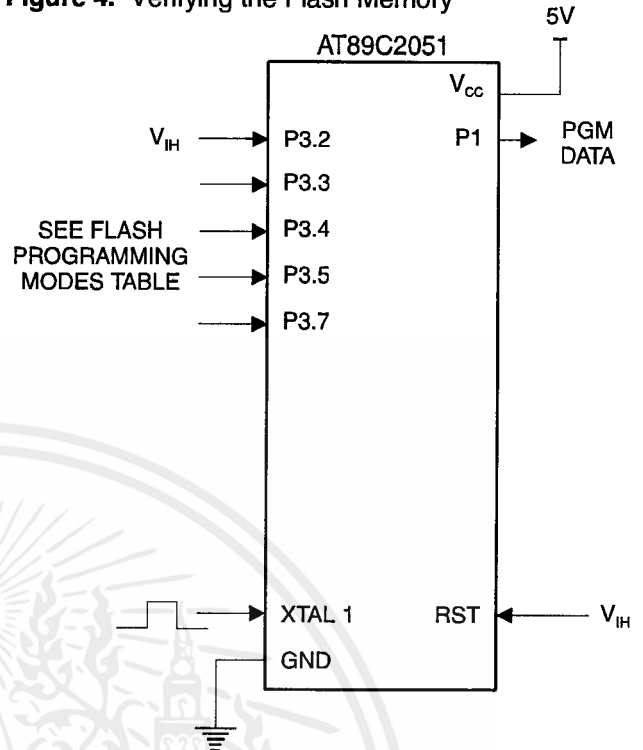


Figure 4. Verifying the Flash Memory



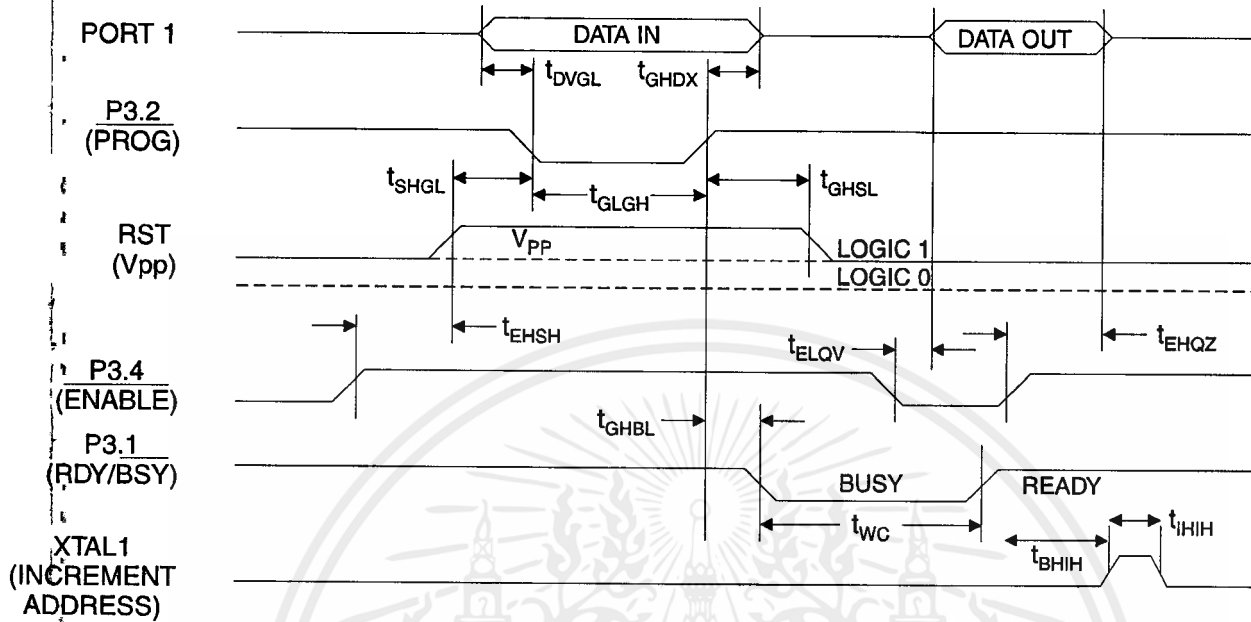
Flash Programming and Verification Characteristics

$T_A = 21^\circ\text{C to } 27^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 5.0 \pm 10\%$

Symbol	Parameter	Min	Max	Units
V_{PP}	Programming Enable Voltage	11.5	12.5	V
I_{PP}	Programming Enable Current		250	μA
t_{DVGL}	Data Setup to $\overline{\text{PROG}}$ Low	1.0		μs
t_{GHDX}	Data Hold After $\overline{\text{PROG}}$	1.0		μs
t_{EHS}	P3.4 (ENABLE) High to V_{PP}	1.0		μs
t_{SHGL}	V_{PP} Setup to $\overline{\text{PROG}}$ Low	10		μs
t_{GHS}	V_{PP} Hold After $\overline{\text{PROG}}$	10		μs
t_{GLGH}	$\overline{\text{PROG}}$ Width	1	110	μs
t_{ELQV}	ENABLE Low to Data Valid		1.0	μs
t_{EHQZ}	Data Float After ENABLE	0	1.0	μs
t_{GHBL}	$\overline{\text{PROG}}$ High to $\overline{\text{BUSY}}$ Low		50	ns
t_{WC}	Byte Write Cycle Time		2.0	ms
t_{BHH}	$\overline{\text{RDY/BSY}}$ to Increment Clock Delay	1.0		μs
t_{IHL}	Increment Clock High	200		ns

Note: 1. Only used in 12-volt programming mode.

Flash Programming and Verification Waveforms



Absolute Maximum Ratings*

Operating Temperature.....	-55°C to +125°C
Storage Temperature.....	-65°C to +150°C
Voltage on Any Pin with Respect to Ground	-1.0 V to +7.0 V
Maximum Operating Voltage	6.6 V
DC Output Current.....	25.0 mA

*NOTICE: Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.



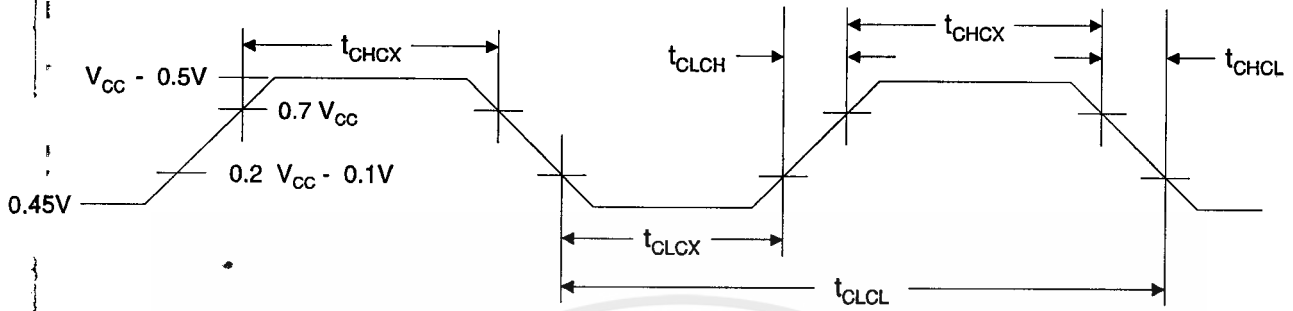
D.C. Characteristics

$T_A = -40^{\circ}\text{C}$ to 85°C , $V_{CC} = 2.7\text{ V}$ to 6.0 V (unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Condition	Min	Max	Units
V_{IL}	Input Low Voltage		-0.5	$0.2 V_{CC} - 0.1$	V
V_{IH}	Input High Voltage	(Except XTAL1, RST)	$0.2 V_{CC} + 0.9$	$V_{CC} + 0.5$	V
V_{IH1}	Input High Voltage	(XTAL1, RST)	$0.7 V_{CC}$	$V_{CC} + 0.5$	V
V_{OL}	Output Low Voltage ⁽¹⁾ (Ports 1, 3)	$I_{OL} = 20\text{ mA}$, $V_{CC} = 5\text{ V}$ $I_{OL} = 10\text{ mA}$, $V_{CC} = 2.7\text{ V}$		0.5	V
V_{OH}	Output High Voltage (Ports 1, 3)	$I_{OH} = -80\text{ }\mu\text{A}$, $V_{CC} = 5\text{ V} \pm 10\%$	2.4		V
		$I_{OH} = -30\text{ }\mu\text{A}$	$0.75 V_{CC}$		V
		$I_{OH} = -12\text{ }\mu\text{A}$	$0.9 V_{CC}$		V
I_{IL}	Logical 0 Input Current (Ports 1, 2, 3)	$V_{IN} = 0.45\text{ V}$		-50	μA
I_{TL}	Logical 1 to 0 Transition Current (Ports 1, 2, 3)	$V_{IN} = 2\text{ V}$		-750	μA
I_{LI}	Input Leakage Current (Port P1.0, P1.1)	$0 < V_{IN} < V_{CC}$		± 10	μA
V_{OS}	Comparator Input Offset Voltage	$V_{CC} = 5\text{ V}$		20	mV
V_{CM}	Comparator Input Common Mode Voltage		0	V_{CC}	V
RRST	Reset Pulldown Resistor		50	300	$\text{K}\Omega$
C_{IO}	Pin Capacitance	Test Freq. = 1 MHz, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$		10	pF
I_{CC}	Power Supply Current	Active Mode, 12 MHz, $V_{CC} = 6\text{ V}/3\text{ V}$		15/5.5	mA
		Idle Mode, 12 MHz, $V_{CC} = 6\text{ V}/3\text{ V}$ P1.0 & P1.1 = 0V or V_{CC}		5/1	mA
	Power Down Mode ⁽²⁾	$V_{CC} = 6\text{ V}$ P1.0 & P1.1 = 0V or V_{CC}		100	μA
		$V_{CC} = 3\text{ V}$ P1.0 & P1.1 = 0V or V_{CC}		20	μA

- Notes:
- Under steady state (non-transient) conditions, I_{OL} must be externally limited as follows:
Maximum I_{OL} per port pin: 20 mA
Maximum total I_{OL} for all output pins: 80 mA
If I_{OL} exceeds the test condition, V_{OL} may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test conditions.
 - Minimum V_{CC} for Power Down is 2 V.

External Clock Drive Waveforms



External Clock Drive

Symbol	Parameter	$V_{CC} = 2.7 V \text{ to } 6.0 V$		$V_{CC} = 4.0 V \text{ to } 6.0 V$		Units
		Min	Max	Min	Max	
$1/t_{CLCL}$	Oscillator Frequency	0	12	0	24	MHz
t_{CLCL}	Clock Period	83.3		41.6		ns
t_{CHCX}	High Time	30		15		ns
t_{CLCX}	Low Time	30		15		ns
t_{CLCH}	Rise Time		20		20	ns
t_{CHCL}	Fall Time		20		20	ns



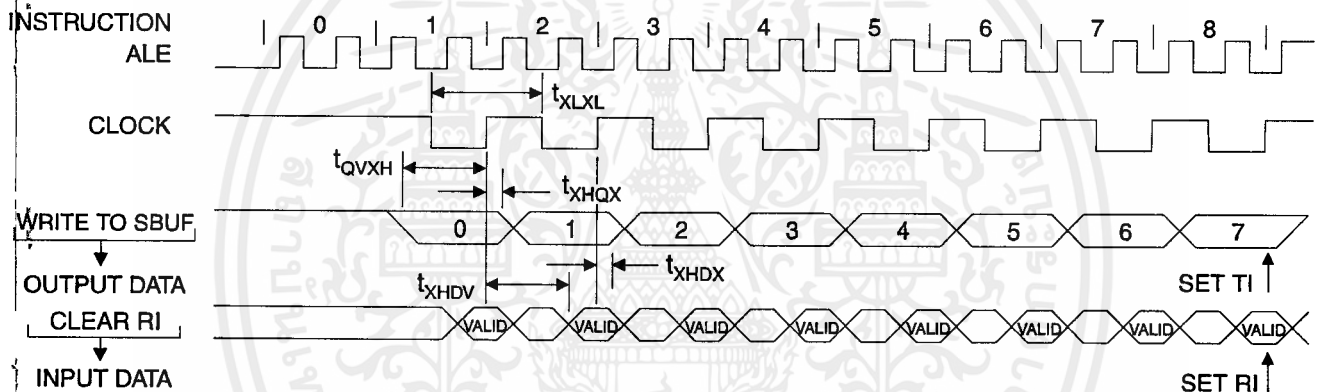


Serial Port Timing: Shift Register Mode Test Conditions

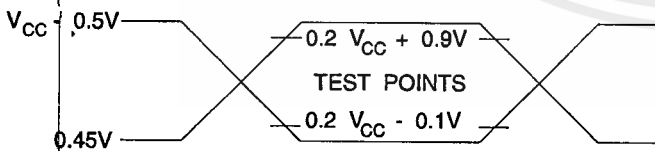
($V_{CC} = 5.0 \text{ V} \pm 20\%$; Load Capacitance = 80 pF)

Symbol	Parameter	12 MHz Osc		Variable Oscillator		Units
		Min	Max	Min	Max	
t_{XLXL}	Serial Port Clock Cycle Time	1.0		$12t_{CLCL}$		μs
t_{QVXH}	Output Data Setup to Clock Rising Edge	700		$10t_{CLCL}-133$		ns
t_{XHGX}	Output Data Hold After Clock Rising Edge	50		$2t_{CLCL}-33$		ns
t_{XHDX}	Input Data Hold After Clock Rising Edge	0		0		ns
t_{XHDV}	Clock Rising Edge to Input Data Valid		700		$10t_{CLCL}-133$	ns

Shift Register Mode Timing Waveforms

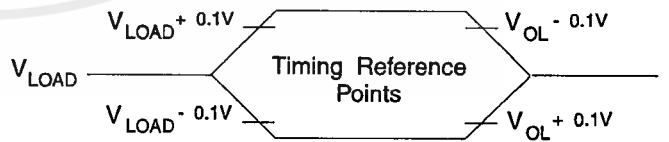


AC Testing Input/Output Waveforms ⁽¹⁾



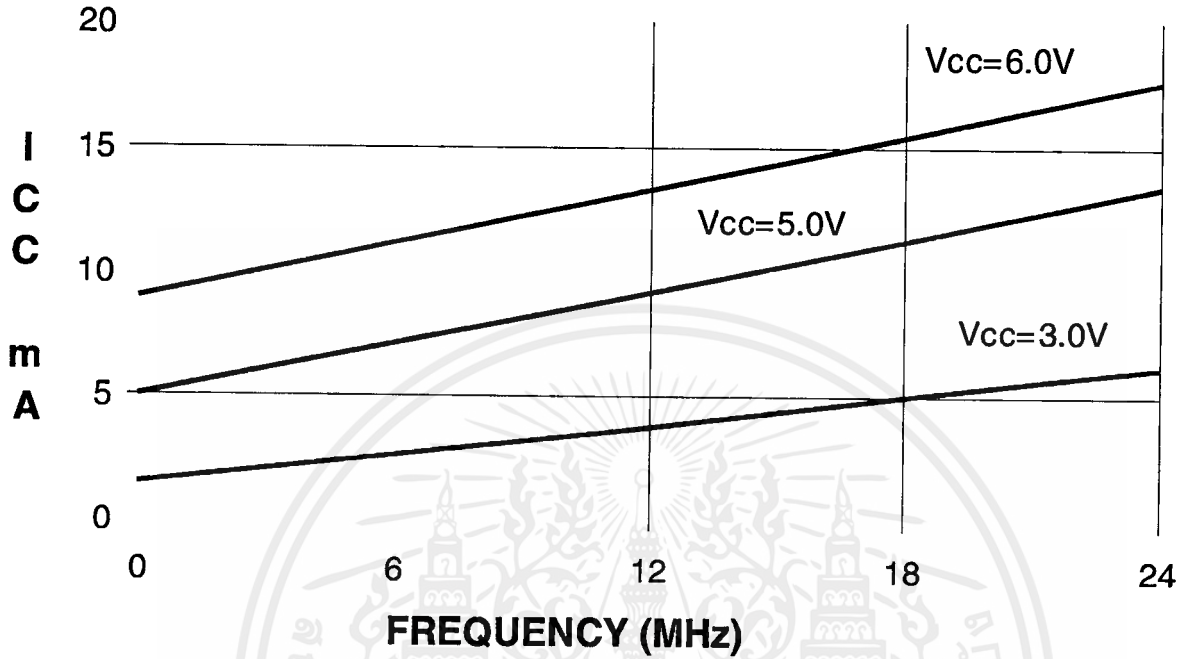
Note: 1. AC Inputs during testing are driven at $V_{CC} - 0.5 \text{ V}$ for a logic 1 and 0.45 V for a logic 0. Timing measurements are made at V_{IH} min. for a logic 1 and V_{IL} max. for a logic 0.

Float Waveforms ⁽¹⁾

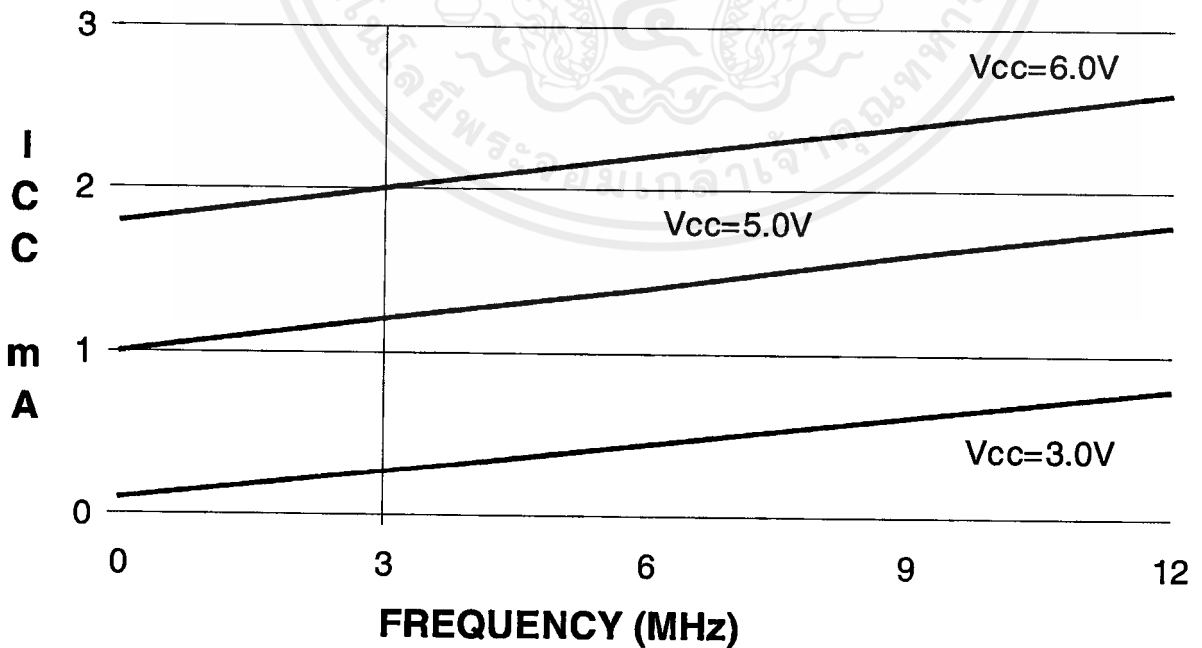


Note: 1. For timing purposes, a port pin is no longer floating when a 100 mV change from load voltage occurs. A port pin begins to float when a 100 mV change from the loaded V_{OH}/V_{OL} level occurs.

AT89C2051
TYPICAL ICC - ACTIVE (85°C)

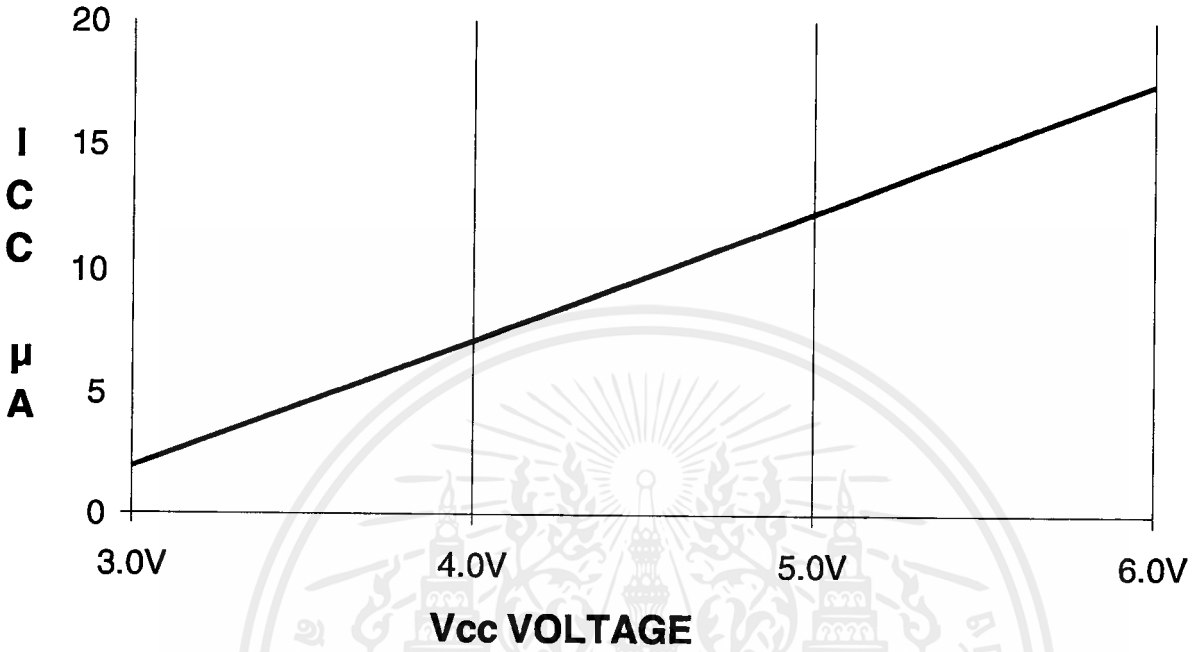


AT89C2051
TYPICAL ICC - IDLE (85°C)



AT89C2051

TYPICAL ICC vs. VOLTAGE- POWER DOWN (85°C)



1. XTALi tied to GND for I_{CC} (power down).
2. P.1.0 and P.1.1 = V_{CC} or GND.
3. Lock bits programmed.

AT89C2051

Ordering Information

Lead Count (Pins)	Power Supply	Ordering Code	Package	Operation Range
12	2.7 V to 6.0 V	AT89C2051-12PC	20P3	Commercial (0°C to 70°C)
		AT89C2051-12SC	20S	
		AT89C2051-12PI	20P3	Industrial (-40°C to 85°C)
		AT89C2051-12SI	20S	
24	4.0 V to 6.0 V	AT89C2051-24PC	20P3	Commercial (0°C to 70°C)
		AT89C2051-24SC	20S	
		AT89C2051-24PI	20P3	Industrial (-40°C to 85°C)
		AT89C2051-24SI	20S	



Package Type

20 Lead, 0.300" Wide, Plastic Dual In-line Package (PDIP)

20 Lead, 0.300" Wide, Plastic Gull Wing Small Outline (SOIC)



DALLAS

SEMICONDUCTOR

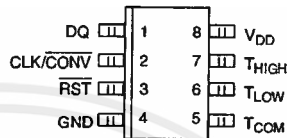
DS1620

Digital Thermometer and Thermostat

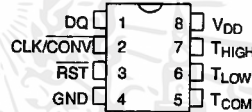
FEATURES

- Requires no external components
- Supply voltage range covers from 2.7V to 5.5V
- Measures temperatures from -55°C to $+125^{\circ}\text{C}$ in 0.5°C increments. Fahrenheit equivalent is -67°F to $+257^{\circ}\text{F}$ in 0.9°F increments
- Temperature is read as a 9-bit value
- Converts temperature to digital word in 1 second (max)
- Thermostatic settings are user-definable and non-volatile
- Data is read from/written via a 3-wire serial interface (CLK, DQ, RST)
- Applications include thermostatic controls, industrial systems, consumer products, thermometers, or any thermally sensitive system
- 8-pin DIP or SOIC (208 mil) packages

PIN ASSIGNMENT



DS1620S 8-PIN SOIC (208 MIL)
See Mech Drawings Section



DS1620 8-PIN PDIP (300 MIL)
See Mech Drawings Section

PIN DESCRIPTION

DQ	- 3-Wire Input/Output
CLK/CONV	- 3-Wire Clock Input and Stand-alone Convert Input
RST	- 3-Wire Reset Input
GND	- Ground
THIGH	- High Temperature Trigger
TLOW	- Low Temperature Trigger
TCOM	- High/Low Combination Trigger
VDD	- Power Supply Voltage (3V - 5V)

DESCRIPTION

The DS1620 Digital Thermometer and Thermostat provides 9-bit temperature readings which indicate the temperature of the device. With three thermal alarm outputs, the DS1620 can also act as a thermostat. THIGH is driven high if the DS1620's temperature is greater than or equal to a user-defined temperature TH. TLOW is driven high if the DS1620's temperature is less than or equal to a user-defined temperature TL. TCOM is driven

high when the temperature exceeds TH and stays high until the temperature falls below that of TL.

User-defined temperature settings are stored in non-volatile memory, so parts can be programmed prior to insertion in a system, as well as used in stand-alone applications without a CPU. Temperature settings and temperature readings are all communicated to/from the DS1620 over a simple 3-wire interface.

OPERATION—MEASURING TEMPERATURE

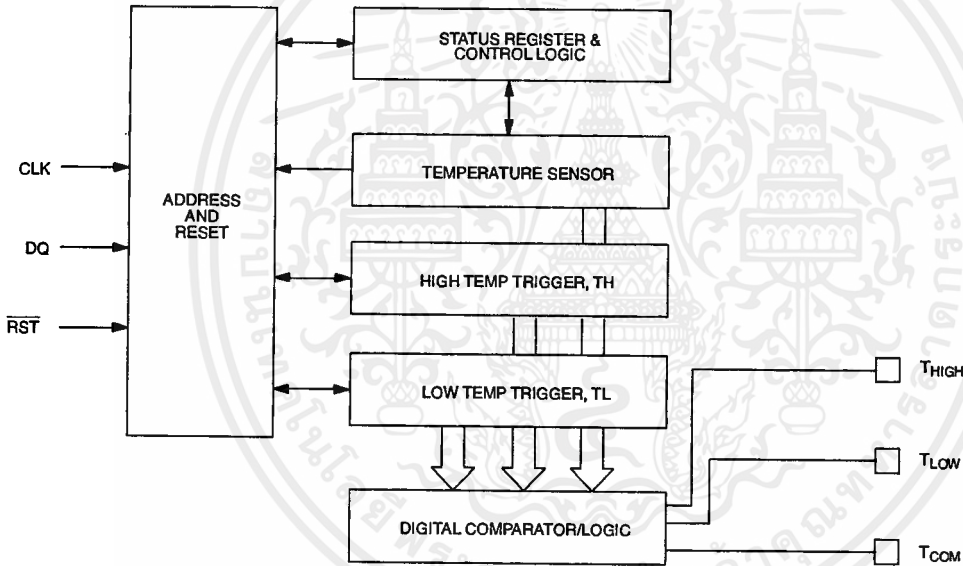
A block diagram of the DS1620 is shown in Figure 1. The DS1620 measures temperatures through the use of an on-board proprietary temperature measurement technique. A block diagram of the temperature measurement circuitry is shown in Figure 2.

The DS1620 measures temperature by counting the number of clock cycles that an oscillator with a low temperature coefficient goes through during a gate period determined by a high temperature coefficient oscillator. The counter is preset with a base count that corresponds to -55°C . If the counter reaches zero before the gate period is over, the temperature register, which is also preset to the -55°C value, is incremented, indicating that the temperature is higher than -55°C .

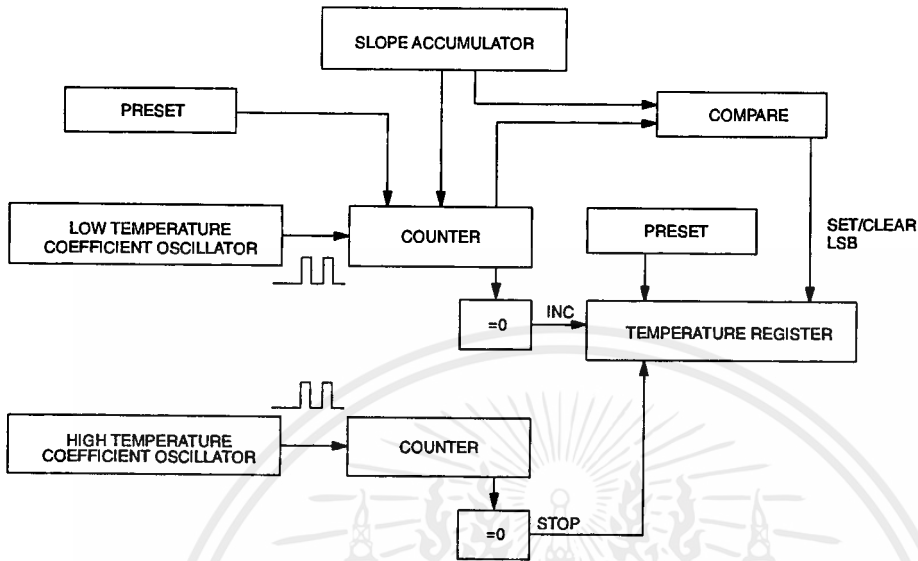
At the same time, the counter is then preset with a value determined by the slope accumulator circuitry. This circuitry is needed to compensate for the parabolic behavior of the oscillators over temperature. The counter is then clocked again until it reaches zero. If the gate period is still not finished, then this process repeats.

The slope accumulator is used to compensate for the nonlinear behavior of the oscillators over temperature, yielding a high resolution temperature measurement. This is done by changing the number of counts necessary for the counter to go through for each incremental degree in temperature. To obtain the desired resolution, therefore, both the value of the counter and the number of counts per degree C (the value of the slope accumulator) at a given temperature must be known.

DS1620 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM Figure 1



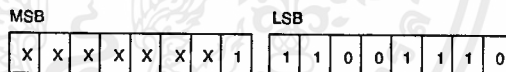
TEMPERATURE MEASURING CIRCUITRY Figure 2



This calculation is done inside the DS1620 to provide 0.5°C resolution. The temperature reading is provided in a 9-bit, two's complement reading by issuing a READ TEMPERATURE command. Table 1 describes the exact relationship of output data to measured temperature. The data is transmitted serially through the 3-wire serial interface, LSB first. The DS1620 can measure temperature over the range of -55°C to +125°C in 0.5°C increments. For Fahrenheit usage, a lookup table or conversion factor must be used.

DS1620 as either a 9-bit word (taking $\overline{\text{RST}}$ low after the 9th (MSB) bit), or as two transfers of 8-bit words, with the most significant 7 bits being ignored or set to zero, as illustrated in Table 1. After the MSB, the DS1620 will output 0s.

Note that temperature is represented in the DS1620 in terms of a 1/2°C LSB, yielding the following 9-bit format:



T = -25°C

TEMPERATURE/DATA RELATIONSHIPS

Table 1

TEMP	DIGITAL OUTPUT (Binary)	DIGITAL OUTPUT (Hex)
+125°C	0 11111010	00FA
+25°C	0 00110010	0032h
+1/2°C	0 00000001	0001h
+0°C	0 00000000	0000h
-1/2°C	1 11111111	01FFh
-25°C	1 11001110	01CEh
-55°C	1 10010010	0192h

Since data is transmitted over the 3-wire bus LSB first, temperature data can be written to/read from the

Higher resolutions may be obtained by reading the temperature, and truncating the 0.5°C bit (the LSB) from the read value. This value is TEMP_READ. The value left in the counter may then be read by issuing a READ COUNTER command. This value is the count remaining (COUNT_REMAIN) after the gate period has ceased. By loading the value of the slope accumulator into the count register (using the READ SLOPE command), this value may then be read, yielding the number of counts per degree C (COUNT_PER_C) at that temperature. The actual temperature may be then be calculated by the user using the following:

$$\text{TEMPERATURE} = \text{TEMP_READ} - 0.25 + \frac{(\text{COUNT_PER_C} - \text{COUNT_REMAIN})}{\text{COUNT_PER_C}}$$

DETAILED PIN DESCRIPTION Table 2

PIN	SYMBOL	DESCRIPTION
1	DQ	Data Input/Output pin for 3-wire communication port.
2	CLK/CONV	Clock Input pin for 3-wire communication port. When the DS1620 is used in a stand-alone application with no 3-wire port, this pin can be used as a convert pin. Temperature conversion will begin on the falling edge of CONV.
3	RST	Reset Input pin for 3-wire communication port.
4	GND	Ground pin.
5	T _{COM}	High/Low Combination Trigger. Goes high when temperature exceeds TH; will reset to low when temperature falls below TL.
6	T _{LOW}	Low Temperature Trigger. Goes high when temperature falls below TL.
7	T _{HIGH}	High Temperature Trigger. Goes high when temperature exceeds TH.
8	V _{DD}	Supply Voltage. 2.7V – 5.5V input power pin.

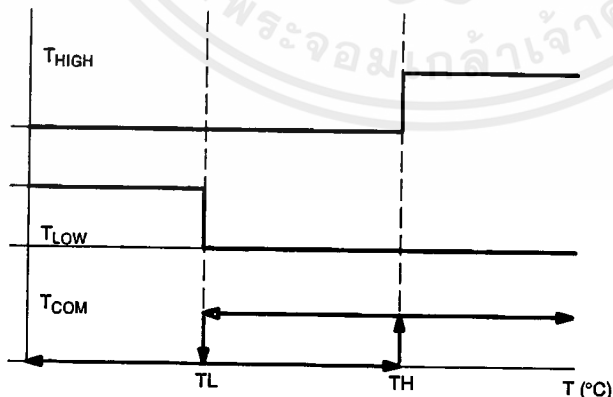
OPERATION-THERMOSTAT CONTROLS

Three thermally triggered outputs, T_{HIGH}, T_{LOW}, and T_{COM}, are provided to allow the DS1620 to be used as a thermostat, as shown in Figure 3. When the DS1620's temperature meets or exceeds the value stored in the high temperature trip register, the output T_{HIGH} becomes active (high) and remains active until the DS1620's measured temperature becomes less than the stored value in the high temperature register, TH. The T_{HIGH} output can be used to indicate that a high temperature tolerance boundary has been met or exceeded, or as part of a closed loop system can be used to activate a cooling system and to deactivate it when the system temperature returns to tolerance.

The T_{LOW} output functions similarly to the T_{HIGH} output. When the DS1620's measured temperature equals or

falls below the value stored in the low temperature register, the T_{LOW} output becomes active. T_{LOW} remains active until the DS1620's temperature becomes greater than the value stored in the low temperature register, TL. The T_{LOW} output can be used to indicate that a low temperature tolerance boundary has been met or exceeded, or as part of a closed loop system, can be used to activate a heating system and to deactivate it when the system temperature returns to tolerance.

The T_{COM} output goes high when the measured temperature meets or exceeds TH, and will stay high until the temperature equals or falls below TL. In this way, any amount of hysteresis can be obtained.

THERMOSTAT OUTPUT OPERATION Figure 3

OPERATION AND CONTROL

The DS1620 must have temperature settings resident in the TH and TL registers for thermostatic operation. A configuration/status register is also used to determine the method of operation that the DS1620 will use in a particular application, as well as indicating the status of the temperature conversion operation. The configuration register is defined as follows:

CONFIGURATION/STATUS REGISTER

DONE	THF	TLF	NVB	1	0	CPU	1SHOT
------	-----	-----	-----	---	---	-----	-------

where

- DONE** = Conversion Done bit. 1=conversion complete, 0=conversion in progress.
- THF** = Temperature High Flag. This bit will be set to 1 when the temperature is greater than or equal to the value of TH. It will remain 1 until reset by writing 0 into this location or by removing power from the device. This feature provides a method of determining if the DS1620 has ever been subjected to temperatures above TH while power has been applied.
- TLF** = Temperature Low Flag. This bit will be set to 1 when the temperature is less than or equal to the value of TL. It will remain 1 until reset by writing 0 into this location or by removing power from the device. This feature provides a method of determining if the DS1620 has ever been subjected to temperatures below TL while power has been applied.
- NVB** = Nonvolatile Memory Busy Flag. 1=write to an E² memory cell in progress. 0=nonvolatile memory is not busy. A copy to E² may take up to 10 ms.
- CPU** = CPU use bit. If CPU=0, the CLK/ $\overline{\text{CONV}}$ pin acts as a conversion start control, when $\overline{\text{RST}}$ is low. If CPU is 1, the DS1620 will be used with a CPU communicating to it over the 3-wire port, and the operation of the CLK/ $\overline{\text{CONV}}$ pin is as a normal clock in concert with DQ and $\overline{\text{RST}}$. This bit is stored in nonvolatile E² memory, capable of at least 50,000 writes. The DS1620 is shipped with CPU=0.
- 1SHOT** = One-Shot Mode. If 1SHOT is 1, the DS1620 will perform one temperature

conversion upon reception of the Start Convert T protocol. If 1SHOT is 0, the DS1620 will continuously perform temperature conversion. This bit is stored in nonvolatile E² memory, capable of at least 50,000 writes. The DS1620 is shipped with 1SHOT=0.

For typical thermostat operation, the DS1620 will operate in continuous mode. However, for applications where only one reading is needed at certain times, and to conserve power, the one-shot mode may be used. Note that the thermostat outputs (T_{HIGH} , T_{LOW} , T_{COM}) will remain in the state they were in after the last valid temperature conversion cycle when operating in one-shot mode.

OPERATION IN STAND-ALONE MODE

In applications where the DS1620 is used as a simple thermostat, no CPU is required. Since the temperature limits are nonvolatile, the DS1620 can be programmed prior to insertion in the system. In order to facilitate operation without a CPU, the CLK/ $\overline{\text{CONV}}$ pin (pin 2) can be used to initiate conversions. Note that the CPU bit must be set to 0 in the configuration register to use this mode of operation. Whether CPU=0 or 1, the 3-wire port is active. Setting CPU=1 disables the stand-alone mode.

To use the CLK/ $\overline{\text{CONV}}$ pin to initiate conversions, $\overline{\text{RST}}$ must be low and CLK/ $\overline{\text{CONV}}$ must be high. If CLK/ $\overline{\text{CONV}}$ is driven low and then brought high in less than 10 ms, one temperature conversion will be performed and then the DS1620 will return to an idle state. If CLK/ $\overline{\text{CONV}}$ is driven low and remains low, continuous conversions will take place until CLK/ $\overline{\text{CONV}}$ is brought high again. With the CPU bit set to 0, the CLK/ $\overline{\text{CONV}}$ will override the 1-shot bit if it is equal to 1. This means that even if the part is set for one-shot mode, driving CLK/ $\overline{\text{CONV}}$ low will initiate conversions.

3-WIRE COMMUNICATIONS

The 3-wire bus is comprised of three signals. These are the $\overline{\text{RST}}$ (reset) signal, the CLK (clock) signal, and the DQ (data) signal. All data transfers are initiated by driving the $\overline{\text{RST}}$ input high. Driving the $\overline{\text{RST}}$ input low terminates communication. (See Figures 4 and 5.) A clock cycle is a sequence of a falling edge followed by a rising edge. For data inputs, the data must be valid during the rising edge of a clock cycle. Data bits are output on the

falling edge of the clock, and remain valid through the rising edge.

When reading data from the DS1620, the DQ pin goes to a high impedance state while the clock is high. Taking $\overline{\text{RST}}$ low will terminate any communication and cause the DQ pin to go to a high impedance state.

Data over the 3-wire interface is communicated LSB first. The command set for the 3-wire interface as shown in Table 3 is as follows.

Read Temperature [AAh]

This command reads the contents of the register which contains the last temperature conversion result. The next nine clock cycles will output the contents of this register.

Write TH [01h]

This command writes to the TH (HIGH TEMPERATURE) register. After issuing this command, the next nine clock cycles clock in the 9-bit temperature limit which will set the threshold for operation of the T_{HIGH} output.

Write TL [02h]

This command writes to the TL (LOW TEMPERATURE) register. After issuing this command, the next nine clock cycles clock in the 9-bit temperature limit which will set the threshold for operation of the T_{LOW} output.

Read TH [A1h]

This command reads the value of the TH (HIGH TEMPERATURE) register. After issuing this command, the next nine clock cycles clock out the 9-bit temperature limit which sets the threshold for operation of the T_{HIGH} output.

Read TL [A2h]

This command reads the value of the TL (LOW TEMPERATURE) register. After issuing this command, the

next nine clock cycles clock out the 9-bit temperature limit which sets the threshold for operation of the T_{LOW} output.

Read Counter [A0h]

This command reads the value of the counter byte. The next nine clock cycles will output the contents of this register.

Read Slope [A9h]

This command reads the value of the slope counter byte from the DS1620. The next nine clock cycles will output the contents of this register.

Start Convert T [EEh]

This command begins a temperature conversion. No further data is required. In one-shot mode, the temperature conversion will be performed and then the DS1620 will remain idle. In continuous mode, this command will initiate continuous conversions.

Stop Convert T [22h]

This command stops temperature conversion. No further data is required. This command may be used to halt a DS1620 in continuous conversion mode. After issuing this command, the current temperature measurement will be completed, and then the DS1620 will remain idle until a Start Convert T is issued to resume continuous operation.

Write Config [0Ch]

This command writes to the configuration register. After issuing this command, the next eight clock cycles clock in the value of the configuration register.

Read Config [ACh]

This command reads the value in the configuration register. After issuing this command, the next eight clock cycles output the value of the configuration register.

DS1620 COMMAND SET Table 3

INSTRUCTION	DESCRIPTION	PROTOCOL	3-WIRE BUS DATA AFTER ISSUING PROTOCOL	NOTES
TEMPERATURE CONVERSION COMMANDS				
Read Temperature	Reads last converted temperature value from temperature register.	AAh	<read data>	
Read Counter	Reads value of count remaining from counter.	A0h	<read data>	
Read Slope	Reads value of the slope accumulator.	A9h	<read data>	
Start Convert T	Initiates temperature conversion.	EEh	Idle	1
Stop Convert T	Halts temperature conversion.	22h	Idle	1
THERMOSTAT COMMANDS				
Write TH	Writes high temperature limit value into TH register.	01h	<write data>	2
Write TL	Writes low temperature limit value into TL register.	02h	<write data>	2
Read TH	Reads stored value of high temperature limit from TH register.	A1h	<read data>	2
Read TL	Reads stored value of low temperature limit from TL register.	A2h	<read data>	2
Write Config	Writes configuration data to configuration register.	0Ch	<write data>	2
Read Config	Reads configuration data from configuration register.	ACh	<read data>	2

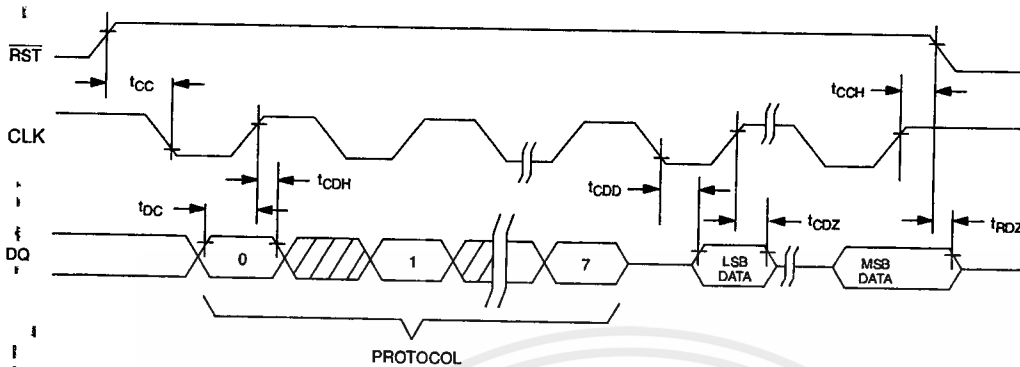
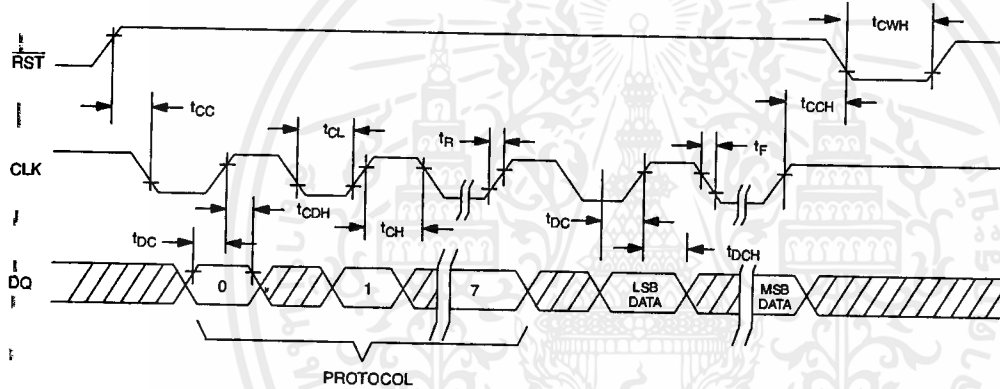
NOTES:

1. In continuous conversion mode, a Stop Convert T command will halt continuous conversion. To restart, the Start Convert T command must be issued. In one-shot mode, a Start Convert T command must be issued for every temperature reading desired.
2. Writing to the E² typically requires 10 ms at room temperature. After issuing a write command, no further writes should be requested for at least 10 ms.

FUNCTION EXAMPLE

Example: CPU sets up DS1620 for continuous conversion and thermostatic function.

CPU MODE	DS1620 MODE (3-WIRE)	DATA (LSB FIRST)	COMMENTS
TX	RX	0Ch	CPU issues Write Config command
TX	RX	00h	CPU sets DS1620 up for continuous conversion
TX	RX	Toggle \overline{RST}	CPU issues Reset to DS1620
TX	RX	01h	CPU issues Write TH command
TX	RX	0050h	CPU sends data for TH limit of +40°C
TX	RX	Toggle \overline{RST}	CPU issues Reset to DS1620
TX	RX	02h	CPU issues Write TL command
TX	RX	0014h	CPU sends data for TL limit of +10°C
TX	RX	Toggle \overline{RST}	CPU issues Reset to DS1620
TX	RX	A1h	CPU issues Read TH command
RX	TX	0050h	DS1620 sends back stored value of TH for CPU to verify
TX	RX	Toggle \overline{RST}	CPU issues Reset to DS1620
TX	RX	A2h	CPU issues Read TL command
RX	TX	0014h	DS1620 sends back stored value of TL for CPU to verify
TX	RX	Toggle \overline{RST}	CPU issues Reset to DS1620
TX	RX	EEh	CPU issues Start Convert T command
TX	RX	Toggle \overline{RST}	CPU issues Reset to DS1620

READ DATA TRANSFER Figure 4**WRITE DATA TRANSFER Figure 5**

NOTE: t_{CL} , t_{CH} , t_R , and t_F apply to both read and write data transfer.

RELATED APPLICATION NOTES

The following Application Notes can be applied to the DS1620. These notes can be obtained from the Dallas Semiconductor "Application Note Book", via our website at <http://www.dalsemi.com/>, or through our faxback service at (972) 371-4441.

Application Note 67: "Applying and Using the DS1620 in Temperature Control Applications"

Application Note 85: "Interfacing the DS1620 to the Motorola SPI Bus"

Application Note 105: "High Resolution Temperature Measurement with Dallas Direct-to-Digital Temperature Sensors"

Sample Ds1620 subroutines that can be used in conjunction with AN105 can be downloaded from the website or our Anonymous FTP Site.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS*

Voltage on Any Pin Relative to Ground	-0.5V to +7.0V
Operating Temperature	-55°C to +125°C
Storage Temperature	-55°C to +125°C
Soldering Temperature	260°C for 10 seconds

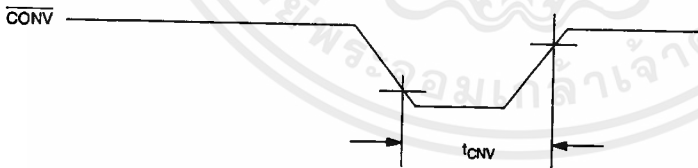
* This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operation sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods of time may affect reliability.

RECOMMENDED DC OPERATING CONDITIONS

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Supply	V_{DD}	2.7		5.5	V	1
Logic 1	V_{IH}	2.0		$V_{CC}+0.3$	V	1
Logic 0	V_{IL}	-0.3		+0.6	V	1

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS(-55°C to +125°C; $V_{DD}=2.7V$ to 5.5V)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITION	MIN	MAX	UNITS	NOTES
Thermometer Error	T_{ERR}	0°C to +70°C -55°C to +0°C and 70°C to 125°C		$\pm 1/2$	°C	10, 11 See Typical Curve
Logic 0 Output	V_{OL}			0.4	V	3
Logic 1 Output	V_{OH}		2.4		V	2
Input Resistance	R_I	RST to GND DQ, CLK to V_{DD}	1 1		MΩ MΩ	
Active Supply Current	I_{CC}	0°C to +70°C		1	mA	4, 5
Standby Supply Current	I_{STBY}	0°C to +70°C		1	μA	4, 5

SINGLE CONVERT TIMING DIAGRAM (STAND-ALONE MODE)

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS(-55°C to +125°C; $V_{DD}=2.7V$ to 5.5V)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Temperature Conversion Time	T_{TC}		400	1000	ms	
Data to CLK Setup	t_{DC}	35			ns	6
CLK to Data Hold	t_{CDH}	40			ns	6
CLK to Data Delay	t_{CDD}			100	ns	6, 7, 8
CLK Low Time	t_{CL}	285			ns	6
CLK High Time	t_{CH}	285			ns	6
CLK Frequency	f_{CLK}	DC		1.75	MHz	6
CLK Rise and Fall	t_R, t_F			500	ns	
\overline{RST} to CLK Setup	t_{CC}	100			ns	6
CLK to \overline{RST} Hold	t_{CCH}	40			ns	6
\overline{RST} Inactive Time	t_{CWH}	125			ns	6, 9
CLK High to I/O High-Z	t_{CDZ}			50	ns	6
\overline{RST} Low to I/O High-Z	t_{RDZ}			50	ns	6
Convert Pulse Width	t_{CNV}	250 ns		500 ms		
NV Write Cycle Time	t_{WR}		10	50	ms	12

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS(-55°C to +125°C; $V_{DD}=2.7V$ to 5.5V)

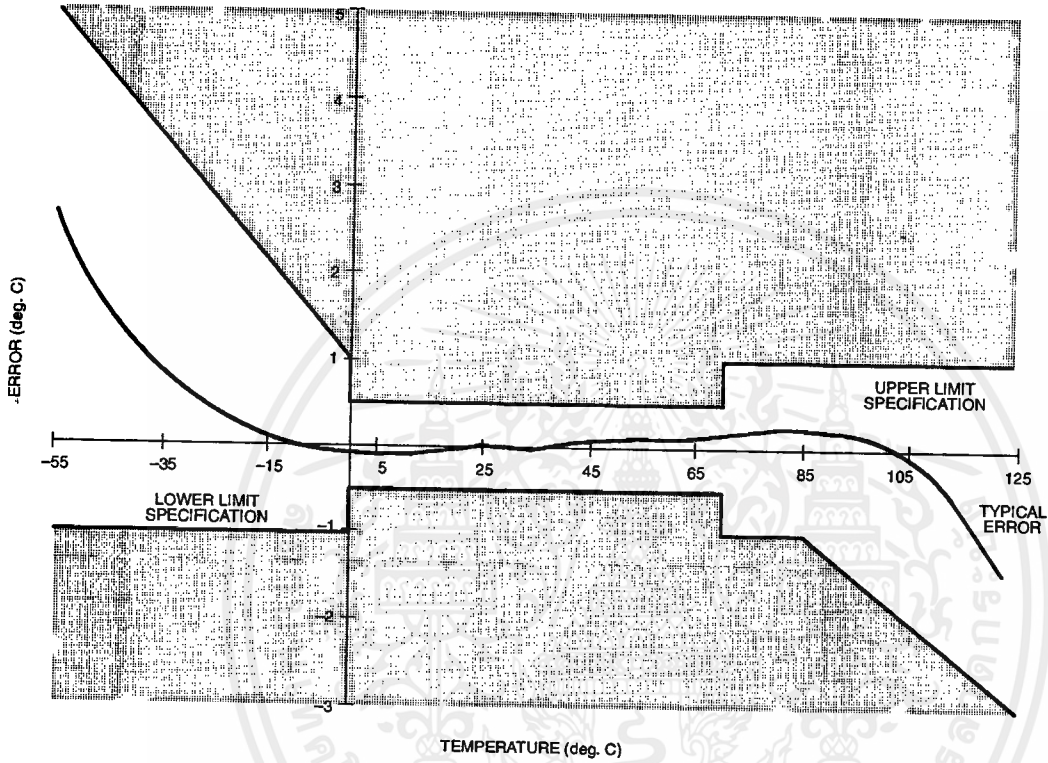
PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Input Capacitance	C_I		5		pF	
I/O Capacitance	$C_{I/O}$		10		pF	

NOTES:

- All voltages are referenced to ground.
- Logic one voltages are specified at a source current of 1 mA.
- Logic zero voltages are specified at a sink current of 4 mA.
- I_{CC} specified with DQ pin open and CLK pin at V_{DD} .
- I_{CC} specified with V_{CC} at 5.0V and $\overline{RST}=GND$.
- Measured at $V_{IH} = 2.0V$ or $V_{IL} = 0.8V$.
- Measured at $V_{OH} = 2.4V$ or $V_{OL} = 0.4V$.
- Load capacitance = 50 pF.
- t_{CWH} must be 10 ms minimum following any write command that involves the E² memory.
- See typical curve for specification limits outside 0°C to 70°C range.
- Thermometer error reflects temperature accuracy as tested during calibration.
- Writing to the nonvolatile memory should only take place in the 0°C to 70°C temperature range.
- Valid for design revisions D1 and above. The supply range for Rev. C2 and below is 4.5V ≤ 5.5V.

TYPICAL PERFORMANCE CURVE

DS1620 DIGITAL THERMOMETER AND THERMOSTAT
TEMPERATURE READING ERROR



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



1. ผศ.สมยศ จุณณะปิยะ,การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51,พ.ศ.2537
2. วารสารเคมีคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์,ตรวจวัดอุณหภูมิกับการส่งข้อมูลอนุกรมแบบ ซิงโครนัส,ฉบับที่171 เดือนพฤษภาคม,พ.ศ. 2540
3. <http://www.atmel.com/>
4. <http://www.intel.com/>
5. <http://www.dallas.com/>
6. <http://www.mxim.com/>

